

股票简称：士兰微

股票代码：600460



杭州士兰微电子股份有限公司

Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd.

（住所：浙江省杭州市黄姑山路 4 号）

公开发行公司债券募集说明书



保荐机构（主承销商）



东方证券股份有限公司
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED

（住所：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 22-29 层）

募集说明书签署日期：2011 年 6 月 7 日

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡认购、购买或以其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的债券持有人会议规则、受托管理协议、担保安排等对本期债券各项权利和义务的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和保荐机构（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、发行人债券评级为AA；债券上市前，发行人最近一期末净资产为170,179.62万元；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11,534.77万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本期债券的发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准。公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。因此，投资者将可能面临流动性风险。

四、本期债券评级机构鹏元资信评估有限公司评定本公司的主体长期信用等级为AA级，评定本期债券的信用等级为AA级。虽然公司目前资信状况良好，但在本期债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

五、本公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

六、本期债券由杭州士兰控股有限公司提供担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。杭州士兰控股有限公司最近一年末经审计的总资产账

面值为22,459.20万元，净资产账面值为22,159.45万元。截至2011年3月31日，士兰控股对外担保余额累计为2.61亿元（均系为士兰微及士兰微下属子公司借款提供的股权质押担保），对外担保占担保人2011年3月31日账面净资产的比重为113.84%；若考虑公司本次6亿元的公司债券全额发行，士兰控股对外担保占其2011年3月31日账面净资产的比重将为375.56%。同时在本期债券存续期内，担保人的经营状况、资产状况及支付能力还可能发生负面变化，甚至丧失履行其为本期债券承担的无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。此外，尽管担保人目前持有发行人204,939,073股股份的市场价值远大于其账面净资产值，但担保人作为发行人的控股股东，其主要从事实业投资，无其他经营性业务，营业利润主要来自对发行人的长期股权投资收益，发行人的经营风险会直接对担保人产生影响。若发行人的经营情况发生不利变化，则担保人的盈利能力也可能会受到不利影响，进而可能会影响担保人承担担保责任的能力。

七、为支持下属公司的发展，公司按照国家相关法律法规以及公司章程的规定，为下属公司提供担保。截至2011年3月31日，公司累计对外担保金额（均为对子公司担保）为17,300万元，占发行人最近一期经审计的净资产的比例为11.61%。如果被担保子公司出现经营风险，可能会影响到公司的财务状况。

八、本期债券评级机构鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间内进行跟踪评级，并将于每年本公司年报公布后一个月内在上海证券交易所网站披露跟踪评级结果与跟踪评级报告。

九、凡认购、购买或以其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的债券持有人会议规则、受托管理协议、担保安排等对本期债券各项权利和义务的约定。

目录

目录	5
释义	7
第一节 发行概况	11
一、本次发行的基本情况	11
二、本期债券发行的有关机构	15
三、认购人承诺	18
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系	18
第二节 风险因素	19
一、本期债券的投资风险	19
二、发行人的相关风险	21
第三节 发行人的资信状况	27
一、本期债券的信用评级情况	27
二、信用评级报告的主要事项	27
三、发行人的资信情况	29
第四节 担保事项	31
一、担保人基本情况	31
二、担保函的主要内容	32
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排	34
第五节 偿债计划及其他保障措施	36
一、偿债计划	36
二、偿债应急保障方案	39
三、偿债保障措施	40
四、发行人违约责任	43
第六节 债券持有人会议	44
一、债券持有人行使权利的形式	44
二、债券持有人会议规则的主要内容	44
第七节 债券受托管理人	52
一、债券受托管理人	52
二、《债券受托管理协议》主要内容	53
第八节 发行人基本情况	58

一、发行人设立、上市及股本变更情况	58
二、发行人股本总额及前十大股东持股情况	61
三、发行人的组织结构	62
四、发行人控股股东及实际控制人基本情况	67
五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况	73
六、公司所从事的主要业务及主要产品用途	77
七、公司所处行业的情况	79
八、前次募集资金使用情况	105
第九节 财务会计信息	108
一、最近三年及一期的财务会计资料	108
二、最近三年及一期的主要财务指标	119
三、管理层分析与讨论	120
四、本次发行公司债券对发行人资产负债结构的影响	157
第十节 募集资金运用	159
一、公司债券募集资金数额	159
二、本次募集资金运用计划	159
三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响	160
第十一节 其他重要事项	162
一、最近一期末对外担保情况	162
二、发行人未决诉讼或仲裁事项	162
第十二节 董事及有关中介机构声明	163
第十三节 备查文件	170

释义

在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通词语		
发行人、公司、本公司、士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司，上海证券交易所上市公司，证券代码：600460
士兰控股、担保人、保证人	指	杭州士兰控股有限公司，发行人的控股股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
《公司章程》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司章程》
本期债券	指	杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年公司债券
本次发行	指	本次公开发行公司债券的行为
《募集说明书》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》
《募集说明书摘要》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》
董事会	指	杭州士兰微电子股份有限公司董事会
股东大会	指	杭州士兰微电子股份有限公司股东大会
《债券受托管理协议》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年公司债券债券持有人会议规则》
新质押式回购	指	将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。其中，质押债券取得资金的交易方为“融资方”；作为其对手的交易方为“融券方”
保荐机构、主承销商、东方证券	指	东方证券股份有限公司
承销团	指	由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称
评级机构/鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司，本期债券的评级机构
发行人律师、律师	指	国浩律师集团（杭州）事务所
会计师	指	天健会计师事务所有限公司
士兰电子	指	杭州士兰电子有限公司，发行人前身
欣源投资	指	杭州欣源投资有限公司，士兰控股前身
士兰集成	指	杭州士兰集成电路有限公司
士兰明芯	指	杭州士兰明芯科技有限公司
深兰微	指	深圳市深兰微电子有限公司

士腾科技	指	杭州士腾科技有限公司
士兰光电	指	杭州士兰光电技术有限公司
士港科技	指	士港科技有限公司
士兰美国	指	士兰微电子美国股份有限公司
士兰 B.V.I	指	Silan Electronics,Ltd.
博脉科技	指	杭州博脉科技有限公司
士景电子	指	杭州士景电子有限公司
美卡乐	指	杭州美卡乐光电有限公司
上海士虹	指	上海士虹微电子科技有限公司
成都士兰	指	成都士兰半导体制造有限公司
士康科技	指	士康科技有限公司
友旺电子	指	杭州友旺电子有限公司
友旺科技	指	杭州友旺科技有限公司
士鹏科技	指	杭州士鹏科技有限公司
天水华天	指	天水华天科技股份有限公司
士兰创投	指	杭州士兰创业投资有限公司
士兰咨询	指	杭州士兰投资咨询有限公司
澳之品	指	杭州澳之品贸易有限公司
君赢电子	指	苏州君赢电子科技有限公司
玛斯特	指	玛斯特杭州酒文化推广有限公司
财通证券	指	浙江财通证券经纪有限责任公司
锅炉集团	指	杭州锅炉集团股份有限公司
杭州解百	指	杭州解百集团股份有限公司
CSIA	指	中国半导体行业协会 (China Semiconductor Industry Association)
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司，是中国规模较大、专业能力较强的现代化咨询顾问企业
产业联盟	指	国家半导体照明工程研发及产业联盟。2004 年 10 月，在国家半导体照明工程协调领导小组办公室的支持与指导下，国家半导体照明工程研发及产业联盟由从事半导体照明相关行业的企业、研发机构、投资机构（即产、学、研、资），特别是承担国家半导体照明工程项目并有一定的规模和行业影响力的单位为主，按照“自愿、平等、合作”的原则发起成立。
元	指	如无特别说明，为人民币元
最近三年一期、报告期	指	2008 年、2009 年、2010 年、2011 年 1-3 月
陈向东等七人	指	陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华
二、专业词语		
集成电路、芯片	指	集成电路（Integrated Circuit，简称 IC，俗称芯片）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
模拟集成电路	指	模拟集成电路是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集

		成在一起，用来处理模拟信号的集成电路。
数字集成电路	指	数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。
集成电路设计	指	将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程，也是一个把产品从抽象的过程一步步具体化、直至最终物理实现的过程。
晶圆	指	单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸等规格，近来发展出 12 英寸甚至更大规格。晶圆越大，同一圆片上可生产的芯片就越多，可降低成本，但要求材料技术和生产技术更高。
线宽	指	是指 IC 生产工艺可达到的最小导线宽度，是 IC 工艺先进水平的主要指标，主要有 4(微米) μm /1 μm /0.6 μm /0.35 μm /90nm 等。线宽越小，集成度越高，在同一面积上可集成更多电路单元。
CMOS	指	互补金属氧化物半导体（Complementary Metal Oxide Semiconductor），是一种集成电路加工工艺技术，具有高集成、低成本、低能耗和高性能等特征。
BiCMOS	指	BiCMOS（Bipolar CMOS）是 CMOS 和双极器件同时集成在同一块芯片上的技术，其基本思想是以 CMOS 器件为主要单元电路，而在要求驱动大电容负载之处加入双极器件或电路。因此 BiCMOS 电路既具有 CMOS 电路高集成度、低功耗的优点，又获得了双极电路高速、强电流驱动能力的优势。
BCD 工艺	指	是一种先进的单片集成工艺技术，能够在同一芯片上制作双极管 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件，称为 BCD 工艺。该工艺综合了双极器件高跨导、强负载驱动能力和 CMOS 集成度高、低功耗的优点，并集成了可在开关模式下工作的 DMOS 功率器件，功耗极低。与标准 CMOS 工艺向更小线宽、更快速度的发展方向不同，BCD 工艺将朝着高压、高功率、高密度三个方向分化发展。
LED	指	Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光。
外延片	指	外延是半导体器件加工过程中的一种工艺，指的是采用高温化学汽相淀积的方法，在一种单晶片的表面生长一层同质或异质单晶。新生长的单晶层一般称为外延层，半导体器件往往做在外延层上。经过外延加工的圆片一般称为外延片。
MOCVD	指	Metal-Organic Chemical Vapor Deposition，即金属有机物化学气相淀积，是利用金属有机化合物作为源物质的一种化学气相淀积工艺。目前为制备氮化镓发光二极管和激光器外延片的主流方法。世界上最大的两家 MOCVD 设备生产商为德国的 AIXTRON 公司和美国的 VEECO 公司，而日本的 MOCVD 设备仅限于其本土市场。

MOCVD 外延片	指	本文特指在 LED 芯片工艺中，用于完成 MOCVD 工艺的圆片。士兰明芯目前高亮度蓝、绿光 LED 芯片采用蓝宝石 (Al_2O_3) 衬底上生长氮化镓 (GaN) 外延层的工艺技术方案。
mcd	指	LED 的亮度单位，指单色光源的光，在给定方向上的单位立体角内发出的发光强度。国际单位为 candela (坎德拉) 简写 cd，mcd 为千分之一 cd。

敬请注意，本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 发行人基本情况

公司名称：杭州士兰微电子股份有限公司
英文名称：Hangzhou Silan Microelectronics CO.,LTD.
法定代表人：陈向东
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：士兰微
股票代码：600460
注册资本：43,408 万元
注册地址：浙江省杭州市黄姑山路 4 号
办公地址：浙江省杭州市黄姑山路 4 号
邮政编码：310012
联系电话：0571-88210880
传真：0571-88210763
互联网网址：www.silan.com.cn
电子邮箱：silan@silan.com.cn
经营范围：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务

(二) 核准情况及核准规模

2011 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》，并于 2011 年 4 月 27 日经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2011 年 4 月 12 日、2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

经中国证监会于 2011 年 5 月 31 日签发的“证监许可[2011]835 号”文核准，

公司获准向社会公开发行面值总额不超过 6 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款。

（三）本期债券的主要条款

发行主体：杭州士兰微电子股份有限公司。

债券名称：杭州士兰微电子股份有限公司 2011 年公司债券。

债券期限：5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

发行总额：不超过 6 亿元（含 6 亿元）。

债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海证券交易所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。

本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的 10%和 90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下；如果网下协议发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。

发行对象：本期债券面向全市场发行（含个人投资者）。

（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

利率上调选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基

点为 0.01%。本公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

债券利率或其确定方式：本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定，在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

起息日：本期债券的起息日为 2011 年 6 月 9 日。

付息日：在本期债券的计息期间内，每年 6 月 9 日日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息。

到期日：本期债券到期日为债券发行首日后 5 年，若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后 3 年。

计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 8 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2011 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 8 日，未回售部分债券的计息期限自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 8 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2011 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 8 日。

还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则至 2016 年 6 月 9 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2014 年 6 月 9 日兑付，未回售部分债券的本金至 2016 年 6 月 9 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

担保情况：杭州士兰控股有限公司为本期债券的还本付息提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

债券受托管理人：本期债券的受托管理人为东方证券股份有限公司。

承销方式：本期债券由保荐机构（主承销商）东方证券组建承销团，以余额包销的方式承销。

拟上市交易场所：上海证券交易所。

新质押式回购：本公司主体长期信用等级和本期债券信用等级皆为 AA 级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

发行费用概算：本次债券发行费用概算不超过本期债券发行总额的 2%。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还借款、调整债务结构和用于补充公司流动资金。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资者承担。

（四）本期债券发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2011 年 6 月 7 日。

发行首日：2011 年 6 月 9 日。

预计发行期限：2011 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 13 日，共 3 个工作日。

网上申购日：2011 年 6 月 9 日。

网下发行期限：2011 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 13 日。

2、本期债券上市安排

本次发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

二、本期债券发行的有关机构

（一）发行人

名称：杭州士兰微电子股份有限公司

法定代表人：陈向东

住所：浙江省杭州市黄姑山路 4 号

办公地址：浙江省杭州市黄姑山路 4 号

联系电话：0571-88210880

传真：0571-88210763

联系人：陈越、马良

（二）保荐机构（主承销商）

名称：东方证券股份有限公司

法定代表人：潘鑫军

住所：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 22-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

联系电话：021-63325888

传真：021-63326910

项目主办人：胡刘斌 陈晖

项目组人员：汪佳佳、何登极、刘传运、方慧敏

（三）分销商

名称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：赵大建

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层 608

联系电话：010-59355499

传真：010-66553691

联系人：潘辉

（四）分销商

名称：财通证券有限责任公司

法定代表人：沈继宁

住 所：杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室

办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室

联系电话：021-68886225

传真：021-68886005

联系人：袁丁

（五）发行人律师

名称：国浩律师集团（杭州）事务所

负责人：吕秉虹

住所：浙江杭州杨公堤 15 号国浩律师楼

联系电话：0571-87965972

传真：0571-85775888

经办律师：徐旭青、金春燕

（六）会计师事务所

名称：天健会计师事务所有限公司

法定代表人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层

联系电话：0571-88216735

传真：0571-88216880

经办注册会计师：程志刚、郑俭、倪国君

（七）担保人

名称：杭州士兰控股有限公司

法定代表人：陈向东

住所：杭州滨江区创业路1号9幢416室

联系电话：0571-87174979

传真：0571-87174996

联系人：杨曙光

（八）资信评级机构

名称：鹏元资信评估有限公司

法定代表人：刘思源

住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

联系电话：021-51035670

传真：021-51035670-8015

评级人员：杨文鹏 臧晓娜

（九）债券受托管理人

名称：东方证券股份有限公司

法定代表人：潘鑫军

住所：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29层

联系电话：021-63325888

传真：021-63326910

联系人：刘丽、樊林爽

（十）保荐机构（主承销商）收款银行

账户名称：东方证券股份有限公司

开户银行：兴业银行上海分行营业部

银行账户：216200100100170756

联系电话：021-63325888

传真：021-63326910

联系人：刘丽、樊林爽

（十一）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

法定代表人：张育军

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68807813

（十二）公司债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

法定代表人：王迪彬

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话：021-38874800

传真：021-58754185

三、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。

第二节 风险因素

投资者在评价和投资本期债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本期债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准。公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。因此，投资者将可能面临流动性风险。

（三）偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

（四）本期债券安排所特有的风险

本公司拟依靠自身良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系保障本期债券的按期偿付。为保障本期债券持有人的合法权益，本公司同时安排了杭州士兰控股有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。但是，在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，

进而影响本期债券投资者的利益。

（五）资信风险

本公司目前资产质量和流动性良好，盈利能力和现金获取能力较强，能够按时偿付债务本息，且公司在近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如果因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，亦将可能使本期债券投资者受到不利影响。

（六）本期债券担保风险

本期债券由杭州士兰控股有限公司提供担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。士兰控股最近一年未经审计的总资产账面值为 22,459.20 万元，净资产账面值为 22,159.45 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，士兰控股对外担保余额累计为 26,100.00 万元（均系为士兰微及士兰微下属子公司借款提供的股权质押担保），对外担保占担保人 2011 年 3 月 31 日账面净资产的比重为 113.84%；若考虑公司本次 6 亿元的公司债券全额发行，士兰控股对外担保占其 2011 年 3 月 31 日账面净资产的比重将为 375.56%。在本期债券存续期内，担保人的经营状况、资产状况及支付能力还可能发生负面变化，甚至丧失履行其为本期债券承担的无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。此外，尽管担保人目前持有发行人 204,939,073 股股份的市场价值远大于其账面净资产值，但担保人作为发行人的控股股东，其主要从事实业投资，无其他经营性业务，营业利润主要来自对发行人的长期股权投资收益，发行人的经营风险会直接对担保人产生影响。若发行人的经营情况发生不利变化，则担保人的盈利能力也可能会受到不利影响，进而可能会影响担保人承担担保责任的能力。

（七）评级风险

本期债券评级机构鹏元资信评估有限公司评定本公司的主体长期信用等级为 AA 级，评定本期债券的信用等级为 AA 级。虽然公司目前资信状况良好，但在本期债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

二、发行人的相关风险

（一）财务风险

1、偿债风险

本公司长期以来经营稳健、财务结构稳定、无不良信用记录，同时也非常注意负债期限结构管理和资金管理。截至 2011 年 3 月 31 日，本公司合并财务报表口径的资产负债率为 35.60%，流动比率为 1.58，速动比率为 1.16；2011 年 1-3 月的利息保障倍数为 6.67 倍，负债水平合理。

本期债券发行后，募集资金将用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金，预计公司的短期负债占比将有所降低，流动比率和速动比率进一步提升，从而降低公司的财务风险。但若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，且公司的经营管理出现异常波动，公司将可能无法按期足额偿付相关债务的本金或利息。

2、利率波动的风险

报告期内，本公司债务融资方式主要采用向银行借款的间接融资方式。发行人 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-3 月的利息净支出分别为 5,311.59 万元、3,622.38 万元、2,973.63 万元和 646.33 万元。近年来，人民币贷款基准利率水平变动幅度较大，影响了发行人债务融资的成本。中国人民银行未来可能根据宏观经济形势变化继续调整基准利率水平，并可能导致发行人利息支出情况产生较大波动，从而对经营业绩产生一定影响。2010 年 10 月 20 日至 2011 年 4 月 6 日，中国人民银行连续四次上调金融机构人民币存贷款基准利率，若未来中国人民银行根据宏观经济环境继续提高人民币贷款基准利率，将可能进一步增加公司的利息支出，从而影响公司的经营业绩。

3、负债结构风险

截至 2011 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 35.60%（合并报表口径，母公司报表口径为 21.64%）；流动负债占总负债的比率为 93.20%（合并报表口径，母公司报表口径为 95.00%）。公司资产负债中流动负债比重偏大，主要原因系公司现有的债务融资主要来自于短期贷款和自发性负债，负债结构较不平衡。较高的流动负债比重使得公司面临一定的短期偿债压力，可能会导致负债结构风险增加。

4、应收账款发生坏账的风险

随着公司生产经营和销售规模的不断扩大，公司在报告期内应收账款的余额相应增加。按合并报表口径，公司 2008 年末、2009 年末、2010 年末和 2011 年 3 月 31 日的应收账款余额分别为 19,394.97 万元、26,743.92 万元、31,958.48 万元和 30,865.83 万元。

从客户结构来看，公司客户结构合理，主要客户均为实力雄厚、偿付能力较强且与公司多年保持良好合作关系的客户，公司不存在对重大客户的依赖。在公司各期期末应收账款余额中，前 5 名客户的账面余额合计数占应收账款余额的比例，2008 年末为 25.26%、2009 年末为 19.76%、2010 年末为 21.92%。合理的客户结构，能够有效分散因重大客户偿还能力发生波动而引发无法收回应收账款的风险。从账龄情况来看，报告期内应收账款的账龄在一年以内的应收账款余额占比均高达 93%以上，公司销售回款情况较好。从各期实际核销的应收账款情况来看，2008-2010 年各期实际核销的应收账款分别为 59.56 万元、181.9 万元、88.96 万元，占当期期末应收账款余额的比例分别为 0.29%、0.64%、0.26%，公司应收账款在报告期内未发生重大的坏账情况。

尽管公司客户结构合理、销售回款情况较好，报告期内也未发生重大的坏账情况，但因公司应收账款金额较大，仍不排除部分应收款项不能及时收回而形成坏账的可能。

5、母公司经营活动产生的现金流量净额下降的风险

2008-2010 年和 2011 年 1-3 月，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 3,781.79 万元、12,788.07 万元、30,388.19 万元和 5,095.59 万元；同期母公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,205.07 万元、2,211.25 万元、-520.32 万元和 3,026.99 万元。公司合并报表经营活动现金流量状况良好。母公司报告期内经营性活动现金流量净额呈现一定的波动，其中 2008 年经营性现金流量较低主要系出口退税款延缓至 2009 年到账；2010 年经营性现金流入较高，但公司出于压缩负债规模、节约财务费用的考虑，在当年经营现金流入较为充沛的情况下主动减少应付票据的开立和结算业务，应付票据余额从 2010 年年初的 11,550.00 万元降至 4,000.00 万元，从而导致 2010 年经营活动产生的现金流量净额偏低。由于公司定位为设计与制造一体化的芯片制造商，母公司主要从事集成电路与分

立器件芯片业务的设计与销售，前三年经营性活动产生的现金流量净额较小主要系研发费用较大，计入经营性现金流量支出所致。

随着公司完成对产品结构的调整，未来毛利较高电路和分立器件新品将逐步上量，母公司利润水平将得到进一步提升，未来母公司经营性现金流量亦将稳步增长。但是，若母公司经营活动产生的现金流继续为负，可能会降低公司财务结构的稳健程度，从而对本期债券本息的偿付产生一定的影响。

6、担保风险

为支持下属公司的发展，公司按照国家相关法律法规以及公司章程的规定，为下属公司提供担保。截至 2011 年 3 月 31 日，公司累计担保金额（均为对子公司担保）为 17,300 万元，占发行人最近一期经审计的净资产的比例为 11.61%。如果被担保子公司出现经营风险，可能会影响到公司的财务状况。

（二）经营风险

1、宏观经济波动风险

当前全球经济尚未完全走出金融危机的阴影，欧洲一些国家接连发生了主权国家债务危机，美国还在继续实施二次量化宽松的货币政策。受到外部经济的影响，我国也面临着流动性过剩的问题，通货膨胀的压力进一步加大。公司主要产品为集成电路、分立器件和 LED，属于电子元器件行业，尽管近年来国家相继出台了若干政策支持、鼓励集成电路和 LED 产业的发展，但不排除因宏观经济的波动给公司生产经营带来的风险。

2、市场竞争风险

公司所属集成电路行业的规模经济特征明显，而我国集成电路企业普遍产能偏低、规模偏小。因此，国内众多集成电路生产企业在努力提高技术水平的同时，纷纷制定产能扩张计划，规划新建生产线，以提高产能，扩大生产规模。在经济复苏后，我国集成电路企业将形成新的产业格局，企业规模将得到提升。同时，随着国际集成电路制造商纷纷在中国投资建厂，国际集成电路制造业向中国转移，我国集成电路行业内竞争将进一步加剧。

在 LED 产业领域，我国大陆地区 LED 产业起步较晚，在经历了器件、芯片封装和外延片进口之后，目前已基本实现了自主生产外延片和芯片的能力。在地域竞争格局上，我国已初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大

连等北方地区四大区域。在产业链竞争格局上，每一区域内，目前已基本形成了包括 LED 外延片生产、LED 芯片制造、芯片封装以及 LED 产品应用在内的较为完整的产业链。但由于我国大型 LED 企业较少、下游技术壁垒相对较低，因而整体产能集中度不高，下游封装和应用领域企业数量较多，外延片和芯片生产企业较为薄弱。从行业发展趋势来看，近年来，主要芯片生产企业均实施大规模产能扩张计划。产能扩张后，芯片生产企业竞争格局或将发生变化。因而未来竞争格局主要体现在技术、质量、品牌、规模、市场、成本控制等方面。

发行人主要从事集成电路、分立器件和LED芯片的设计、制造业务。尽管 2006-2009 年我国集成电路市场销售额增长率持续下滑，但发行人经过适当的产业结构调整，整体盈利能力大幅提高，行业排名位居全国前列。在中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告》（2009 年版）公布的“2008 年中国十大集成电路设计企业”名单中，发行人集成电路、半导体器件产品销售额位居国内第四位；“2010 中国半导体市场年会”期间，中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院联合揭晓了 2009 年度中国十大集成电路企业，其中在集成电路设计企业中，公司 2009 年销售额排名第三^[1]。公司目前已成为国内分立器件芯片品种最多、产量最大的企业之一。在LED领域，子公司士兰明芯自成立以来利用母公司从事集成电路产业的优势，把集成电路技术和LED技术结合起来用于显示屏高端LED的生产，在LED彩屏芯片市场的占有率超过 50%^[2]。但是，随着新的竞争者的不断加入，行业内竞争越来越激烈，这将给公司带来一定的经营压力。

3、成本上升的风险

在当前通货膨胀的环境下，原材料价格持续上升，人工成本、资金成本不断提高。公司近几年实施有效的成本控制措施，投入产出效率稳步提高。公司在 2011 年将继续采取更有针对性的措施实施对成本的控制，在加快创新、加快产出，提高投入产出效率上加大力度，但公司生产经营仍面临较大的成本上升压力和风险。

4、设备维护风险

^[1] 数据来源：苏州市集成电路行业协会之“协会新闻”之《协会-第 29 期简报》，网址：<http://www.sicia.cn/letter-show.asp?id=640>

^[2] 数据来源：《中国电子报》20100507 期之“第 5 版:中国 LED 行业年度评选暨深圳光电周特刊”之《中国 LED 行业年度评选（2009）获奖项目及企业》，
网址：<http://epaper.cena.com.cn/shtml/zgdzb/20100507/26038.shtml>

公司 2010 年非公开发行股份募集资金项目属高新技术项目，关键生产设备 MOCVD 和部分工艺设备目前仍需从国外进口。尽管国内已在政府的指导支持下，大力加强、联合攻关研制生产 MOCVD 和其它先进的工艺及测试设备，公司也加强与设备供应商建立紧密的长期合作关系，但公司仍面临生产设备的质量以及未来设备的维护对生产经营产生较大影响的风险。

5、资本支出实现预期收益风险

经过前几年产品结构的调整，公司已完成了从中低端量大面广的电路产品向中高端的 SoC 芯片、以高压、高功率、高频工艺开发的模拟集成电路、以特殊工艺开发的半导体分立器件以及高亮度 LED 蓝绿光芯片为主要产品的转型过程，报告期内整体盈利能力逐步提高。随着公司度过产品、技术研发阶段和量产初期产品、技术尚不完善的艰难时期，本公司及下属子公司利用自筹资金加大了投资力度。2011 年，公司的资本支出计划有：士兰微电子高清解码芯片开发项目、士兰集成芯片生产线扩产项目、士兰明芯高亮度 LED 芯片生产线技改项目和成都士兰一期厂房和配套基础设施建设。由于公司具有研发设计企业的特征，研发项目产生效益具有一定的不确定性；生产线扩产、技改项目以及成都士兰一期基础设施建设周期较长，若市场环境发生变化以及技术向西部转移、市场推广进度缓慢，资本支出实现的效益有可能会与项目预期产生差异，进而对公司现金流产生影响。

（三）管理风险

发行人目前正处于发展的关键时期，如本次公司债券发行成功，资产规模将大幅增加，这对发行人的经营管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。虽然公司已形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批经验丰富的业务骨干，但在快速发展过程中若发行人的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应发行人规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

（四）政策风险

1、行业政策变动的风险

国家对集成电路、LED 行业出台了一系列法律法规和规章制度，构成了公司正常持续运营的外部政策、法律环境，对公司的业务开展、生产经营、资本投

资等方面都具有重要影响。如果国家相关行业政策发生变化，可能会对公司的生产经营造成相应影响。

2、税收优惠政策变化的风险

本公司及下属子公司均根据国家相关法律法规的规定执行税收政策。目前，本公司享受如下税收优惠政策如下：根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2008〕250号文、浙科发高〔2008〕314号文和浙科发高〔2008〕336号文，本公司和控股子公司士兰集成、士兰明芯均被认定为高新技术企业，认定有效期三年，2008年至2010年企业所得税按15%的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高〔2009〕289号文，本公司控股子公司士兰光电被认定为高新技术企业，认定有效期三年，2009年至2011年企业所得税按15%的税率计缴。

根据国务院国发〔2007〕39号文，控股子公司深兰微注册登记于深圳经济特区，本期企业所得税按25%的税率计缴。

国家税收政策的变化，也可能对公司及下属公司已享受的税收优惠政策产生影响，进而对公司的经营业绩产生影响。

第三节 发行人的资信状况

一、本期债券的信用评级情况

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

鹏元资信评定发行人的主体长期信用等级为 AA，AA 级别的涵义为受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

鹏元资信评定本期债券信用等级为 AA，本级别的涵义为债券安全性很高，违约风险很低。

（二）有无担保的情况下评级结论的差异

士兰控股为本期公司债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。鹏元资信基于对发行人的运营环境、经营竞争状况、财务实力及本期债券的担保方式等因素的综合评估，评定发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。发行人主体长期信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力，是对公司长期信用等级的评估，可以等同于本期债券无担保情况下的信用等级。因此，本期债券在无担保的情况下信用等级为 AA，在有担保的情况下信用等级为 AA。

（三）评级报告的基本观点和关注

1、基本观点

（1）我国集成电路和半导体分立器件长期保持高速增长，产业分布比较集中，未来市场空间巨大；

（2）我国 LED 产业链初具规模，世博、奥运、亚运带动中国显示屏市场稳定增长，市场未来潜力巨大；

（3）公司集成电路、分立器件和 LED 制造三大业务并行发展，在国内市场具备较强竞争力；

（4）伴随着行业高增长，公司主营业务收入增长较快，盈利能力强；

（5）公司负债水平不高，短期偿债压力不大，债务安全性高。

2、关注

(1) LED 产品利润率水平较高，但随着新竞争者的加入，行业内竞争越来越激烈，将给公司带来一定的经营压力；

(2) 未来公司项目的资金投入水平较高，公司存在一定的资金压力。

(四) 跟踪评级的有关安排

根据相关规定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

定期跟踪评级于每年企业年报公布后的一个月开展一次。届时，杭州士兰微电子股份有限公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，杭州士兰微电子股份有限公司应及时告知鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与杭州士兰微电子股份有限公司有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

如杭州士兰微电子股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至杭州士兰微电子股份有限公司提供评级所需相关资料。

定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对杭州士兰微电子股份有限公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。

鹏元资信评估有限公司将及时在该公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送杭州士兰微电子股份有限公司及相关部门。

三、发行人的资信情况

(一) 公司获得主要贷款银行的授信情况

截至 2011 年 3 月 31 日，公司拥有的银行授信总额为 194,370 万元人民币，其中已使用银行贷款授信额度 52,000 万元、银行承兑汇票授信额度 4,510 万元，未使用授信余额 137,860 万元，具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	银行名称	总授信额	已使用授信额			未使用授信额
			贷款	承兑	合计	
1	华夏高新支行	9,000	4,000	-	4,000	5,000
2	兴业银行杭州分行	10,000	-	-	-	10,000
3	民生银行西湖支行	9,000	-	-	-	9,000
4	中行高新支行	26,200	14,300	3,360	17,660	8,540
5	华夏深圳分行	1,300	700	150	850	450
6	招行风起支行	21,000	1,000	-	1,000	20,000
7	交行东新支行	56,750	16,000	1,000	17,000	39,750
8	建行高新支行	33,120	5,000	-	5,000	28,120
9	农行下沙支行	23,000	7,000	-	7,000	16,000
10	汇丰银行杭州分行	5,000	4,000	-	4,000	1,000
合计		194,370	52,000	4,510	56,510	137,860

(二) 最近三年一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

(三) 最近三年一期发行的债券以及偿还情况

1、债券发行以及偿还情况

截至 2011 年 3 月 31 日，发行人未发行过债券。

2、短期融资券发行及偿还情况

截至 2011 年 3 月 31 日，发行人未发行过短期融资券。

(四) 本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计净资产的比例

本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为 6 亿元，占公司截至 2011 年 3 月 31 日的合并资产负债表中净资产的比例为 35.26%，未超过本公司净资产的 40%。

(五) 最近三年一期公司的主要财务指标

主要财务指标	2011.3.31 /2011 年 1-3 月	2010.12.31 /2010 年度	2009.12.31 /2009 年度	2008.12.31 /2008 年度
流动比率	1.58	1.78	0.98	0.82
速动比率	1.16	1.40	0.65	0.49
资产负债率（合并）	35.60%	34.90%	54.10%	58.40%
资产负债率（母公司）	21.64%	22.20%	44.37%	47.95%
利息保障倍数	6.67	9.99	3.00	1.45
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：以上各财务指标，未特殊说明的，均为合并报表口径。

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息支出
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

第四节 担保事项

根据杭州士兰控股有限公司 2011 年第一次股东会决议，士兰控股为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用及其他应支付的费用。

一、担保人基本情况

(一) 担保人概况

- 1、公司名称：杭州士兰控股有限公司
- 2、注册资本：13,100 万元人民币
- 3、住所：杭州滨江区创业路 1 号 9 幢 416 室
- 4、法定代表人：陈向东
- 5、经营范围：实业投资；货物进出口，技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），计算机技术服务。

(二) 担保人最近一年主要财务数据和指标

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司浙江分所出具的标准无保留意见的审计报告（中瑞岳华浙分审字[2011]第 A0140 号），士兰控股最近一年主要财务数据和指标如下表：

项目	2010 年 12 月 31 日
总资产（万元）	22,459.20
总负债（万元）	299.74
净资产（万元）	22,159.45
资产负债率（%）	1.33
流动比率	16.02
速动比率	16.02
项目	2010 年度
营业收入（万元）	-
利润总额（万元）	462.45
净利润（万元）	469.64
净资产收益率（%）	2.12

上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

净资产收益率=净利润/期末净资产

（三）担保人资信情况

士兰控股目前的资信状况良好。报告期内士兰控股未向银行借款，未申请银行授信额度，银行也未对其进行信用评级。

（四）担保人累计对外担保余额及其占净资产的比重

截至 2011 年 3 月 31 日，士兰控股对外担保余额为 26,100.00 万元，均为对士兰微及士兰微下属子公司借款提供的股权质押担保。对外担保占担保人 2011 年 3 月 31 日账面净资产的比重为 113.84%；若考虑公司本次 6 亿元的公司债券全额发行，士兰控股对外担保占其 2011 年 3 月 31 日账面净资产的比重将为 375.56%。

（五）偿债能力分析

截至2011年3月31日，士兰控股总资产达到23,723.73万元，资产负债率为3.36%，流动比率与速动比率分别为7.41和7.41，各项财务指标良好。截至2011年3月31日，士兰控股持有发行人204,939,073股股份，占发行人股份总数的47.21%。以2011年3月31日公司收盘价计算，该股份市值为41.21亿元（士兰控股投资账面值为1.19亿元），账面增值40.02亿元。士兰控股账面净资产2.29亿元加上其持有的士兰微股票的增值40.02亿元后的净值为42.31亿元，相对于本期的6亿元公司债券，具有较好的偿债能力。但担保人作为发行人的控股股东，其主要从事实业投资，无其他经营性业务，营业利润主要来自对发行人的长期股权投资收益，发行人的经营风险会直接对担保人产生影响。若发行人的经营情况发生不利变化，则担保人的盈利能力也可能会受到不利影响，进而可能会影响担保人承担担保责任的能力。

二、担保函的主要内容

（一）本期债券的种类、数额

本期债券为被担保债券，发行总额不超过人民币 6 亿元。

本期债券的具体发行规模、期限、品种由募集说明书规定。

（二）本期债券的到期日

本期债券到期日为债券发行首日后 5 年，若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后 3 年。

（三）保证的方式

保证人为债券发行人本期债券提供保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

（四）保证责任的承担

如债券发行人不能在《募集说明书》规定的期限内按约定偿付本期债券本金和/或利息，保证人应在收到本期债券持有人或本期债券受托管理人的书面索赔要求后，根据担保函向本期债券持有人履行担保义务。本期债券持有人可分别或联合要求保证人承担保证责任。本期债券受托管理人依照本期债券的受托管理协议的约定代理本期债券持有人要求保证人履行保证责任。保证人保证在接到本期债券持有人或本期债券受托管理人的书面索款通知后向本期债券持有人清偿上述款项。

（五）保证范围

保证人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

（六）发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

担保人为发行人履行本期公司债券项下还本付息义务提供担保，债券受托管理人有权代表债券持有人行使担保项下的权利。

（七）保证的期间

保证人承担保证责任的期间为本期债券存续期及债券到期之日起二年。本期债券持有人、本期债券受托管理人在此期间内未要求保证人承担保证责任的，或其在保证期间主张债权后未在保证债务诉讼时效届满之前向保证人追偿的，保证人免除保证责任。

（八）债券的转让或出质

本期债券持有人依法将本期债券转让或出质给第三人的，保证人按照本担保函的规定继续承担保证责任。

（九）主债权的变更

经中国证券监督管理委员会和本期债券持有人会议核准/批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过保证人同意，保证人继续承担本担保函项下的保证责任。但是在发生前述情形时，本期债券受托管理人应

当书面通知保证人。

（十）加速到期

在本担保函项下的债券到期之前，保证人发生分立、合并等足以影响其履行本期债券的担保责任的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的保证。债券发行人不提供新的保证时，本期债券持有人及本期债券受托管理人有权要求债券发行人、保证人提前兑付债券本息。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

1、债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督

对于担保事项，债券持有人会议依据相关法律法规、《试点办法》和《募集说明书》的规定行使如下职权：

（1）在发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时，决定是否同意相关解决方案，及/或委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息；决定委托受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序；

（2）应发行人提议或发生影响保证人履行担保责任能力的重大变化的情况下，决定变更保证人或者担保方式。

2、债券受托管理人按照《债券受托管理协议》的规定对担保事项作持续监督

（1）受托管理人持续关注保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。

（2）发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的本期公司债券利息和/或本金划入本期公司债券登记托管机构指定的银行账户时，受托管理人应作为全体债券持有人的代理人在发行人发生上述违约行为的次日，按照《担保函》的相关规定，向保证人发出索赔通知，要求保证人履行保证义务，将欠付的本期公司债券到期利息和/或本金划入债券登记托管机构或主承销商指定的银行账户。

（3）发行人不能偿还债务时，受托管理人应要求发行人追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施。

（4）受托管理人应该在发行人公布年度报告起一个月内出具债券受托管理

事务报告年度报告并予以披露。

详细内容请见本募集说明书第六节“债券持有人会议”以及第七节“债券受托管理人”的相关部分。

第五节 偿债计划及其他保障措施

本期债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

一、偿债计划

（一）本息的支付

1、在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2016 年 6 月 9 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2014 年 6 月 9 日兑付，未回售部分债券的本金至 2016 年 6 月 9 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

2、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）偿债资金来源

1、公司稳定的盈利能力为偿还本期债券本息提供保障

公司近三年一期主营业务稳步发展，净利润在报告期内保持稳定。报告期内公司盈利能力情况如下：

单位：万元

合并报表口径				
项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
营业收入	32,400.59	151,882.70	95,986.54	93,309.58
归属于母公司股东权益的净利润	4,211.62	25,585.86	7,662.51	1,355.94
母公司报表口径				
项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
营业收入	18,786.29	83,157.56	58,983.92	53,008.37
净利润	1,278.27	10,011.43	4,862.44	834.29

公司近三年合并报表的平均净利润（归属于母公司股东权益的净利润）为 11,534.77 万元，母公司的平均净利润为 5,236.06 万元。公司的净利润预计足以支付本期债券每年所需支付的利息。

报告期内，发行人的主营业务为集成电路芯片设计、硅芯片制造和 LED 芯片制造。近年来，公司始终围绕该三大主导业务、七条主要产品线不断积累核心技术、不断创新技术和产品、加强对整体产业结构的布局和调整。经过长期的积累和调整，2010 年公司已初步完成了对产品线的调整和布局。从产业发展的方向、技术积累等多方面来看，目前公司的产品线布局基本合理，公司已走出产品、技术研发阶段和量产初期产品、技术尚不完善的艰难时期。公司步入一个较为稳定的发展阶段。

在集成电路芯片设计业务领域，经过前期的积累和调整，2010 年公司电源管理和功率驱动产品线、混合信号及射频产品线、数字音视频产品线、MCU 产品线等均完成了重点新产品的开发计划。新品开发计划的完成可期望其在未来获得较快成长。与此同时，公司于 2009 年 4 季度启动了高清多媒体处理器芯片的预研工作，并于 2010 年年初正式立项开发高清多媒体处理器芯片，预计 2011 年年底前将完成高清多媒体处理器芯片的开发。

在硅芯片制造业务领域，经过 10 年的发展，公司子公司士兰集成的芯片制造规模、质量控制水平已达到一个新的台阶。士兰集成已具备了较强的成本控制能力和较强的工艺技术开发能力，建立了达到国际大厂认可标准的质量管理体系，初步完成了公司 IDM 模式中最为关键的一步跳跃。与此同时，公司着眼于发挥自身在电路、芯片、器件、系统应用等方面积累的资源优势，开拓高附加值的产品。其中，功率模块封装线的建设是公司实施战略布局调整、坚持设计与制造一体化产业化模式的重要举措之一。2010 年，士兰集成完成了对功率模块封装线的第一期投资。该封装生产线建成后，将主要生产高速低功耗 600V 以上多芯片功率模块，其主要应用于家用设备中变频电机的驱动、电器设备的高效低待机功耗电源、LED 照明和节能灯的高效供电驱动等领域，具有良好的市场发展前景。2011 年 3 月，公司申报的“高速低功耗 600v 以上多芯片高压模块”项目已获科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室立项批准。

在 LED 芯片制造业务领域，公司子公司士兰明芯在品牌建设、生产规模的扩充上已走在了国内同行的前列。在生产规模上，2010 年士兰明芯已将蓝绿光 LED 芯片的生产能力提升至 6.5 亿只/月。随着 2010 年公司非公开发行股票募集

资金投资项目的稳步推进，新订购的大型 MOCVD 设备将陆续到厂并调试生产，士兰明芯蓝、绿光 LED 芯片的生产能力将提升至 11 亿只/月以上。在芯片应用领域，公司 LED 芯片主要用于户内外彩屏市场，在国内同行中，公司户内外彩屏芯片的市场占有率最高。未来公司产品将进入照明市场，目前公司白光照明 LED 芯片已开始进行客户认证并将逐步渗透。与此同时，公司致力于提高产品附加值、打造国际一流品牌、提升与国际一流厂商竞争的實力，在产业布局上进行了产业链的延伸，士兰明芯子公司美卡乐的 LED 芯片封装业务取得了较快的发展，关键技术取得了突破；同时公司对产品结构进行了调整，不仅仅局限于芯片状态的产品，而是将 LED 封装成品作为品牌建设的一个重要举措。截至目前该举措已取得了较好的市场表现，2010 年 8 月天安门广场上新竖起的两块巨型 LED 彩色显示屏，其灯管由美卡乐公司封装，芯片均采用了士兰明芯的产品。公司已取得了全球知名的 LED 显示屏厂商美国达科（Daktronics）的认证。公司将继续通过技术的研发、产业链的延伸和高附加值产品的推广，将美卡乐打造成国内质量最好、可以进入全球高端市场的 LED 成品品牌。

综上所述，公司经过近三年的调整，前期投入的各项业务已经趋于成熟，公司将进入一个新的发展阶段，稳定的盈利能力将为偿还本期债券本息提供有力的保障。

2、公司经营活动产生充裕的现金为偿还本期债券本息提供保障

2008-2010 年和 2011 年 1-3 月，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 3,781.79 万元、12,788.07 万元、30,388.19 万元和 5,095.59 万元；同期母公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,205.07 万元、2,211.25 万元、-520.32 万元和 3,026.99 万元。公司合并报表经营活动现金流量状况良好。母公司报告期内经营性活动现金流量净额呈现一定的波动，其中 2008 年经营性现金流量较低主要系出口退税款延缓至 2009 年到账；2010 年经营性现金流入较高，但公司出于压缩负债规模、节约财务费用的考虑，在当年经营现金流入较为充沛的情况下主动减少应付票据的开立和结算业务，应付票据余额从 2010 年年初的 11,550.00 万元降至 4,000.00 万元，从而导致 2010 年经营活动产生的现金流量净额偏低。

公司坚持 IDM 经营模式，芯片设计与制造一体化，其中母公司主要从事集成电路与分立器件芯片业务的设计与销售，前三年经营性活动产生的现金流量净

额较小主要系研发费用较大，计入经营性现金流量支出所致。随着公司完成产业结构的调整，不断加大高附加值产品的开发力度和销售规模，未来毛利较高电路和分立器件新品将逐步上量，公司利润水平将得到进一步提升。稳步增长的盈利能力及良好的回款情况将产生充裕的现金，为偿还本期债券本息提供充分保障。

二、偿债应急保障方案

1、间接与直接融资保障本期债券本息按时偿付

公司经营状况良好，且具有较好的发展前景，在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了长期、良好的合作关系。公司的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有良好的资信水平。截至 2011 年 3 月 31 日，公司共拥有华夏银行、中国银行、招商银行、交通银行、汇丰银行、建设银行、农业银行、民生银行、兴业银行等银行总授信额度 194,370 万元，已使用授信额度 56,510 万元，包括银行借款 52,000 万元和银行承兑汇票 4,510 万元，尚未使用的授信总额为 137,860 万元；母公司银行总授信额度为 81,920 万元，已使用授信额度为 24,360 万元，包括银行借款 20,000 万元和银行承兑汇票 4,360 万元，尚未使用的授信总额为 57,560 万元。因此，畅通的间接融资渠道将进一步保障本期债券本息的按时偿付。

此外，作为 A 股上市公司，本公司经营情况良好，运作规范，盈利能力较强，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行股权融资和债务融资。2010 年公司通过非公开发行股票顺利进行了股权融资。目前，本公司在资本市场信用记录良好。因而必要时，公司可以通过直接融资手段在资本市场筹集资金以满足公司资金需要，这也为公司按期偿还本期债券提供有力支持。

2、流动资产迅速变现可为偿还本期债券本息提供保障

长期以来，本公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2011 年 3 月 31 日，公司合并报表流动资产余额为 138,853.44 万元，其中存货为 37,235.70 万元，占流动资产的比例为 26.82%；应收账款为 30,865.83 万元，占流动资产的比例为 22.23%；母公司财务报表口径下流动资产余额为 62,342.89 万元。若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，公司拥有的变现能力较强的流动资产可迅速变现可为本期债券本息及时偿付提供保障。

三、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

（一）设立偿债准备金

发行人于本期债券到期日前6个月开始设立偿债准备金，并由发行人在进行资产配置时统筹安排其运作方式，按照计划提前准备偿债资金。

发行人资信状况优良，始终保持着畅通的间接融资渠道，并拥有较大数额的未使用银行授信额度和较强的资金调动能力，能够作为偿还本期债券本息的有力保障。发行人在偿债准备金各阶段都将保证有充足的未使用银行授信额度和可随时调用的现金，以充分保障本期债券的资金偿还能力。

发行人作为上市公司，将以透明的信息披露，使偿债准备金受到债券持有人、债券受托管理人、股东和管理层的监督，健全风险监管和预警体系，防范偿债风险。

1、偿债准备金的准备

发行人将于本期债券到期日的前6个月开始，设立偿债准备金，作为本期债券本息的偿付准备。偿债准备金的形态限定为现金、发行人获得的未使用的银行贷款授信额度。

2、偿债准备金的监督

发行人将在年度报告中披露偿债准备金的情况，包括但不限于获得的未使用的银行贷款授信额度和可随时调用的现金数额。债券受托管理人有权对偿债准备金情况进行监督。

3、偿债准备金的进度安排

发行人将于债券到期日的前6个月开始，按相应比例留足偿债准备金。具体安排如下：债券到期日的前6个月，偿债准备金总额占债券总额的20%；债券到期日的前3个月，偿债准备金总额占债券总额的50%；债券到期日的前2个月，偿债准备金总额占债券总额100%；债券到期日的前1个月，偿债准备金总额占债券总额120%。

（二）设立专项偿债账户

发行人将于本期债券到期日和本期债券第3个计息年度付息日的前3个月为支付本期债券的本金设立专项偿债账户，通过该账户还本付息。

1、账户的开立

发行人将开立专项偿债账户。

2、资金来源

专项偿债账户的资金来源为偿债准备金。

3、账户的管理和监督

发行人对该账户进行的管理及运用，应接受债券受托管理人的监督。

4、偿债资金的划入方式及运作计划

在本金支付日前3个月，发行人将陆续把偿债准备金划入偿债专用账户。至本金支付日前第5个工作日，专项偿债账户中应有足以偿付应付债券本金及当期利息的资金。具体安排如下：

距本金支付日剩余时间	3个月	2个月	1个月	15天	5天
专项偿债账户内资金占债券本息总额的最低比例	5%	10%	40%	80%	100%

（三）设立专门的偿付工作小组

在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将设立由财务部和投资管理部共同组成本期债券本息偿付工作小组。工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（四）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（五）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取

一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

本公司将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第七节“债券受托管理人”。

（六）制定《债券持有人会议规则》

本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付作了合理的制度安排。

（七）保证人为本期债券提供保证担保

士兰控股为本期债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。如发行人无法按约定偿付本期债券本息，则士兰控股将按照出具的《担保函》及有关法律法规的规定承担担保责任，保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

（八）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（九）发行人承诺

根据本公司于2011年4月11日召开的第四届董事会第十九次会议及于2011年4月27日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

四、发行人违约责任

本公司保证按照本期债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司和/或担保人进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面年利率上浮 20%。

第六节 债券持有人会议

凡认购、购买或以其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利和义务的约定，受本规则之约束。

本节仅列示了本期债券之《债券持有人会议规则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》全文。《债券持有人会议规则》的全文置备于本公司办公场所。

一、债券持有人行使权利的形式

对于《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项，债券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益；其他事项，债券持有人应依据法律、行政法规和本募集说明书的规定行使权利，维护自身的利益。

债券持有人会议由本期债券全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。

二、债券持有人会议规则的主要内容

（一）总则

1、债券持有人会议由全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。

2、债券持有人通过债券持有人会议行使重大事项决定权、知情权、监督权、偿付请求权、损害赔偿请求权等权利。

3、债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得对发行人的经营情况进行干涉。

4、债券受托管理人及/或发行人应遵守《试点办法》及《债券持有人会议规则》的规定，及时履行召开债券持有人会议的义务，并对债券持有人会议的正常召开负有诚信责任，不得阻碍债券持有人依法行使权利。

5、债券持有人会议须公平对待所有债券持有人，不得增加债券持有人的负担。

6、债券持有人会议依据法律、《试点办法》、本期债券募集说明书的规定行使如下职权：

（1）变更本期债券募集说明书的约定，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期公司债券本息、变更本期公司债券利率；

（2）在发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时，是否同意相关解决方案，及/或委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和保证人偿还债券本息；决定委托受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序；

（3）发行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，是否接受发行人提出的建议，以及本期债券持有人依法享有权利的行使；

（4）应发行人提议或发生影响保证人履行担保责任能力的重大变化的情况下，决定变更保证人或者担保方式；

（5）变更本期债券受托管理人；

（6）决定是否同意发行人与债券受托管理人修改《债券受托管理协议》或达成相关补充协议；

（7）法律、行政法规和部门规章规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

7、债券持有人进行表决时，以其持有的每一张本期公司债券为一表决权。

8、债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

（二）债券持有人会议的召集

1、在本期公司债券存续期内，如发生如下与全体债券持有人利益相关的重大事项之一的，应召开债券持有人会议：

（1）**拟**变更募集说明书的约定；

（2）债券发行人不能按期支付本期公司债券的本息；

（3）变更、解聘债券受托管理人。

（4）债券发行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产的情形；

（5）保证人发生影响履行担保责任能力的重大变化；

(6) 债券发行人书面提议召开债券持有人会议；

(7) 单独和/或合并代表 10%以上有表决权的本期债券张数的持有人书面提议召开债券持有人会议；

(8) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

债券受托管理人在获知上述规定的事项发生之日起 5 个工作日内，债券受托管理人应以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

上述规定的事项发生之日起 5 个工作日内，债券受托管理人未发出召开债券持有人会议通知的，单独和/或合并代表 10%以上有表决权的本期公司债券张数的持有人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

发行人向债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议之日起 5 个工作日内，债券受托管理人未发出召开债券持有人会议通知的，发行人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

2、会议召集人应依法、及时发出召开债券持有人会议的通知，及时组织、召开债券持有人会议。

债券受托管理人发出召开债券持有人会议通知的，受托管理人是债券持有人会议召集人。

单独代表 10%以上有表决权的本期公司债券张数的持有人发出召开债券持有人会议的通知的，该债券持有人为召集人。合并代表 10%以上有表决权的本期公司债券张数的多个持有人发出召开债券持有人会议的通知的，则合并发出会议通知的债券持有人推举的一名债券持有人为召集人。

发行人根据前述条款规定发出召开债券持有人会议通知的，则发行人为召集人。

3、召集人应当为债券持有人会议聘请律师对以下问题出具法律意见：

(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本《债券持有人会议规则》的规定；

(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(4) 应会议召集人要求对其他有关问题出具法律意见。

(三) 债券持有人会议的通知

1、债券持有人会议通知应至少于会议召开前 15 日以公告形式向全体本期债券持有人及有关出席对象发出会议通知。

2、债券持有人会议通知至少应载明以下内容：

- (1) 会议召开的时间、地点和方式；
- (2) 会议拟审议的事项；
- (3) 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
- (4) 代理债券持有人出席会议之代理人的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
- (5) 召集人名称及会务常设联系人姓名、电话。

会议召集人可就公告的会议通知以公告方式发出补充通知，但补充通知应在债券持有人会议召开日 5 日前发出。

债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊及互联网网站上公告。

3、债券持有人会议拟审议事项应属于债券持有人会议职权范围、有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、法规和本《债券持有人会议规则》的有关规定。

4、债券持有人会议拟审议的事项由召集人根据《债券持有人会议规则》的规定决定。单独和/或合并代表 10%以上有表决权的本期公司债券张数的持有人可以向召集人书面建议拟审议事项。

债券持有人会议召开前，发行人、债券受托管理人及单独和/或合并代表 10%以上有表决权的本期公司债券张数的持有人有权提出临时提案，并应于召开日的至少 10 日前且在满足本期债券上市的交易所要求的日期前提出；召集人应当根据《债券持有人会议规则》的要求发出债券持有人会议补充通知，披露提出临时提案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和新增提案的内容。

5、债券持有人会议应在债券发行人住所地或受托管理人住所地所在城市召开，具体地址由会议召集人确定。债券持有人会议应设置会场，以现场会议形式召开。

6、发出债券持有人会议通知后，无正当理由，债券持有人会议不得延期或取消，一旦出现延期或取消的情形，会议召集人应在原定召开日前至少五天公告

并说明原因。

（四）债券持有人会议的出席

1、债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并行使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。债券持有人和/或代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费等费用。

债券持有人和/或代理人出席债券持有人会议应持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。代理人还应提交授权委托书和个人有效身份证件。

召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本期公司债券的债券持有人名册共同对出席会议之债券持有人的资格的合法性进行验证,并登记出席债券持有人会议之债券持有人和/或代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本期公司债券张数。

上述债券持有人名册由发行人承担费用从证券登记结算机构取得并无偿提供给召集人。

2、应单独和/或合并代表 10%以上有表决权的本期公司债券张数的持有人、债券受托管理人的要求，债券发行人应派代表出席本期公司债券持有人会议。

债券发行人代表在债券持有人会议上应对债券持有人、债券受托管理人的询问作出解释和说明。

3、下列机构或人员可以列席本期公司债券持有人会议：

- （1）为债券发行人本期债券发行提供担保的保证人；
- （2）债券发行人的董事、监事和高级管理人员；
- （3）债券受托管理人及其授权代表；
- （4）为本期债券持有人会议出具法律意见书的律师。
- （5）其他经债券持有人会议同意列席的人员。

4、召集人应制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的本期公司债券张数、被代理人姓名（或单位名称）、联系方式等事项。

（五）债券持有人会议的召开

1、会议的召开

- （1）债券受托管理人委派出席债券持有人会议之授权代表担任会议主持人。

如果上述应担任会议主持人之人士未能主持会议，则由出席会议的本期公司债券持有人推举一名出席本次会议的债券持有人担任该次会议的主持人。

（2）每次债券持有人会议之监票人为两人，负责该次会议之计票、监票。会议主持人应主持推举本期债券持有人会议之监票人，监票人由出席会议的本期公司债券持有人担任。

与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

债券持有人会议对拟审议事项进行表决时，应由监票人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。

（3）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。

除因不可抗力特殊原因导致持有人会议中止或不能作出决议外，持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

（4）债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

2、会议的表决

（1）本期公司债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，可以投同意票或反对票或弃权票。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（2）下述本期公司债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期公司债券张数不计入出席本期公司债券持有人会议的出席张数：

（一）债券持有人为持有债券发行人 10%以上股份的债券发行人股东；

（二）上述债券发行人股东及债券发行人的关联方。

3、会议的决议

债券持有人会议决议须经代表本期公司债券半数以上表决权的债券持有人

和/或代理人同意方能形成有效决议。

4、决议的效力

本期公司债券持有人会议决议经表决通过后生效。

任何与本期公司债券有关的债券持有人会议决议不得导致变更债券发行人、债券持有人之间的权利义务关系，但以下两种依照《试点办法》及《募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力的情形除外：

（一）如果该决议是根据公司债券持有人、受托管理人的提议做出的，该决议经公司债券持有人会议表决通过并经债券发行人书面同意后，对债券发行人和债券持有人有约束力；

（二）如果该决议是根据债券发行人的提议做出的，经公司债券持有人会议表决通过后，对债券发行人和公司债券持有人有约束力。

5、决议的公告

本期公司债券持有人会议做出决议后，债券持有人会议决议应及时公告，公告中应列明出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的持有人和代理人所代表表决权的本期公司债券张数及占有表决权的本期公司债券总张数的比例、表决方式、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

该次公司债券持有人会议的召集人负责上述公告事宜。

6、会议的记录

债券持有人会议的主持人应指定专人负责制作债券持有人会议之会议记录。会议记录包括以下内容：

- （1）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （2）会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名；
- （3）本次会议见证律师和监票人的姓名；
- （4）出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表有表决权的本期公司债券张数及占本期公司债券总张数的比例；
- （5）对每一拟审议事项的审议经过、发言要点和表决结果；
- （6）债券持有人的询问意见或建议以及相应的答复或说明；
- （7）法律、行政法规和部门规章规定应载入会议记录的其他内容。

7、其他事项

（1）债券持有人会议会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、出席会议的代理人的授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件、资料由债券受托管理人保管，保管期限至本期公司债券到期日截止之日起五年期限届满之日结束。

（2）债券持有人会议的会议费、公告费、律师费等全部费用由本期债券发行人承担，但参加会议的差旅费用、食宿费用应由会议参加人自行承担。

（3）相关法律、法规和部门规章对公司债券持有人会议规则有明确规定的，从其规定；除非法律、行政法规和部门规章有明确的规定，或经债券持有人会议决议通过并经发行人、债券受托管理人同意外，本《债券持有人会议规则》不得变更。

第七节 债券受托管理人

为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《合同法》以及《试点办法》等有关法律法规和部门规章的规定，本公司聘请东方证券作为本期债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。

凡认购、购买或以其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受《债券受托管理协议》对本期债券各项权利和义务的约定，并由债券受托管理人按《债券受托管理协议》的规定履行其职责。

本节仅列示了本期债券之《债券受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券受托管理协议》全文。《债券受托管理协议》的全文置备于本公司与债券受托管理人的办公场所。

一、债券受托管理人

根据发行人与东方证券于 2011 年 4 月签署的《债券受托管理协议》，东方证券受聘担任本期债券的债券受托管理人。

（一）债券受托管理人的基本情况

名称：东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 22-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：刘丽、樊林爽

联系电话：021-63325888

传真：021-63326910

邮编：200010

（二）债券受托管理人与发行人是否有利害关系

作为发行人 2010 年度非公开发行股票的保荐机构，东方证券尚处于持续督导期之内。此外，东方证券已被发行人聘任为本期债券的保荐机构及主承销商，除此以外东方证券与发行人不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。

二、《债券受托管理协议》主要内容

（一）债券受托管理事项

为维护本期公司债券全体债券持有人的利益，发行人聘请东方证券作为发行人发行的本期公司债券的受托管理人，由受托管理人依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。

根据中国法律、行政法规、《试点办法》的规定、《募集说明书》和《债券受托管理协议》的约定以及债券持有人会议的授权，受托管理人作为本期公司债券全体债券持有人的代理人处理本期公司债券的相关事务，维护债券持有人的利益。

（二）发行人的权利和义务

1、发行人依据法律、法规和《募集说明书》的规定享有各项权利、承担各项义务，按期支付本期公司债券的利息和本金。

2、发行人应当履行《债券持有人会议规则》项下发行人应当履行的各项职责和义务。

3、在本期公司债券存续期限内，发行人应根据《证券法》、《试点办法》、《公司章程》及其他相关法律、法规、规章的规定，履行持续信息披露的义务。

4、在债券持有人会议选聘新受托管理人的情况下，发行人应该配合受托管理人及新受托管理人完成受托管理人工作及档案移交的有关事项，并向新受托管理人履行《债券受托管理协议》项下应当向受托管理人履行的各项义务。

5、发行人应该指定证券事务代表负责与本期公司债券相关的事务。

6、发行人在债券持有人会议公告明确的债权登记日之下一个交易日，负责从证券登记结算机构取得该债权登记日交易结束时持有本期公司债券的债券持有人名册，并将该名册提供给受托管理人，并承担相应费用。

7、如果发行人发生以下任何事件，发行人应及时通知受托管理人：

（1）发行人按照《募集说明书》已经根据发行人与登记托管机构的约定将到期的本期公司债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户；

（2）发行人未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息和/或本金或延期后仍未能足额支付本期债券的利息和/或本金；

（3）发行人预计不能按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期公司

债券的利息和/或本金；

(4) 发行人发生或者预计将发生超过前一会计年度经审计的净资产 10%以上的重大损失；

(5) 发行人发生减资、合并、分立、解散或进入破产程序；

(6) 发行人发生标的金额超过前一会计年度经审计的净资产 10%以上的重大仲裁或诉讼；

(7) 本期公司债券被暂停交易；

(8) 发行人已知为本期公司债券提供担保的保证人发生重大不利变化可能危及其担保能力；

(9) 其他可能影响债券持有人利益的重大事项；

(10) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。

8、发行人应按照《债券受托管理协议》的约定向债券受托管理人支付债券受托管理报酬。

(三) 受托管理人的权利和义务

1、受托管理人有权依据《债券受托管理协议》的规定获得受托管理报酬。

2、受托管理人应持续关注发行人和保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。

3、受托管理人应在本期公司债券发行前取得保证人为本期公司债券出具的《担保函》和其他有关担保的授权文件，并妥善保管。

4、受托管理人应作为本期公司债券全体债券持有人的代理人，为全体债券持有人的利益，勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务及其他相关事务。

5、发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的本期公司债券利息和/或本金划入本期公司债券登记托管机构指定的银行账户时，受托管理人应作为全体债券持有人的代理人在发行人发生上述违约行为的次日，按照《担保函》的相关约定，向保证人发出索赔通知，要求保证人履行保证义务，将欠付的本期公司债券到期利息和/或本金划入债券登记托管机构或主承销商指定的银行账户。

6、发行人不能偿还债务时，受托管理人应要求发行人追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施。

7、发行人不能偿还债务时，受托管理人根据债券持有人会议之决议代表债券持有人受托参与发行人整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

8、受托管理人应按照《试点办法》、《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》的规定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议规则》项下受托管理人的职责和义务。

9、受托管理人负责执行债券持有人会议决议，及时与发行人、保证人及债券持有人沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实，督促发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议决议。

10、受托管理人应当为债券持有人的最大利益行事，不得与债券持有人存在利益冲突，不得利用作为受托管理人而获取的有关信息为自己或任何其他第三方谋取利益。

11、受托管理人应按照中国证监会的有关规定及《债券受托管理协议》的规定向债券持有人出具债券受托管理事务报告。

12、在债券持有人会议作出变更受托管理人的决议之日起 15 个工作日内，受托管理人应该向新受托管理人移交工作及有关文件档案。

13、受托管理人不得将其在《债券受托管理协议》项下的职责和义务委托给第三方履行。

14、受托管理人应制订债券受托管理业务内部操作规则，规定受托管理人行使权利、履行义务的方式、程序。

15、受托管理人应指派专人负责发行人涉及债券持有人权益的行为进行监督。

16、受托管理人应指派专人负责对保证人的担保能力进行持续关注。

17、受托管理人应遵守《债券受托管理协议》、《募集说明书》以及中国证监会规定的受托管理人应当履行的其他义务。

（四）债券受托管理事务报告

1、受托管理事务报告包括年度报告和临时报告。

2、受托管理人应该在发行人公布年度报告起一个月内出具债券受托管理事

务报告年度报告，年度报告应包括下列内容：

- (1) 发行人的经营状况、资产状况；
- (2) 发行人募集资金使用情况；
- (3) 保证人的资信状况以及可能影响保证人履行保证责任的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件；
- (4) 债券持有人会议召开的情况；
- (5) 本期公司债券本息偿付情况；
- (6) 本期公司债券跟踪评级情况；
- (7) 发行人证券事务代表的变动情况；
- (8) 受托管理人认为需要向债券持有人通告的其他情况。

3、以下情况发生，受托管理人应当以公告方式向全体债券持有人出具受托管理事务临时报告：

(1) 发行人未按《募集说明书》的规定及发行人与登记托管机构的约定将到期的本期债券利息和/或本金划入登记托管机构指定的账户时，或保证人未履行保证义务时，受托管理人应在该情形出现之日起的两个工作日内如实报告债券持有人。

(2) 发行人出现《债券持有人会议规则》规定的应当召开债券持有人会议的情形时，受托管理人应当及时书面提示发行人，报告债券持有人，并依法召集债券持有人会议。

(3) 出现对债券持有人利益有重大实质影响的其他情形。

4、在本期公司债券存续期间，受托管理人应将债券受托管理事务报告等持续信息披露文件及时以公告方式告知债券持有人，并在中国证监会指定的网站上公布。相关信息披露费用由发行人承担。

(五) 债券受托管理人的变更

1、下列情况发生应变更受托管理人：

- (1) 受托管理人不能按《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理义务；
- (2) 受托管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
- (3) 受托管理人不再具备任职资格；

(4) 债券持有人会议通过决议变更受托管理人。

2、新的受托管理人，必须符合下列条件：

- (1) 新任受托管理人符合中国证监会的有关规定；
- (2) 新任受托管理人已经披露与发行人的利害关系；
- (3) 新任受托管理人与债券持有人不存在利益冲突。

3、单独和/或合并代表 10%以上有表决权的本期公司债券张数的债券持有人要求变更受托管理人的，受托管理人应召集债券持有人会议审议解除受托管理人的受托管理人职责并聘请新的受托管理人，变更受托管理人的决议须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。发行人和受托管理人应当根据债券持有人会议的决议和《债券受托管理协议》的规定完成与变更受托管理人有关的全部工作。

4、自债券持有人会议作出变更受托管理人决议之日起，原受托管理人在《债券受托管理协议》中的权利和义务终止，《债券受托管理协议》约定的受托管理人的权利和义务由新任受托管理人享有和承担，但新任受托管理人对原任受托管理人的违约行为不承担任何责任。

(六) 债券受托管理的期限和报酬

1、本期债券受托管理的有效期限为本期债券募集发行之日起至本期债券所有相关债权债务完结时止。

2、在本期债券发行完毕后的 20 个工作日内，发行人应当一次性向债券受托管理人支付本期债券受托管理事务报酬 25 万元（即每年 5 万元，本期债券存续期五年共计 25 万元）。

(七) 违约责任

1、如果《债券受托管理协议》任何一方未按本协议的规定履行义务，应当依法承担违约责任。

2、《债券受托管理协议》任何一方违约，守约方有权依据法律、行政法规、《试点办法》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》之规定追究违约方的违约责任。

第八节 发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变更情况

（一）发行人的设立和首次公开发行股票并上市

发行人前身为杭州士兰电子有限公司，成立于 1997 年 9 月 25 日，由陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七位自然人以现金方式共同出资组建，注册资本为 350 万元。

2000 年 4 月 10 日，士兰电子以未分配利润转增注册资本，注册资本增至 1,500 万元。同年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市【2000】21 号文批准，以 2000 年 7 月 31 日为审计基准日，根据经审计的净资产值按 1:1 的比例折为等额股份，士兰电子采取变更设立方式，设立杭州士兰微电子股份有限公司。

2000 年 10 月 28 日，公司完成工商登记手续并领取企业法人营业执照，股本总额为 7,502 万元。发行人成立时，股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	比例
陈向东	13,053,480	17.40%
范伟宏	12,678,380	16.90%
郑少波	12,678,380	16.90%
江忠永	12,678,380	16.90%
罗华兵	12,678,380	16.90%
宋卫权	5,626,500	7.50%
陈国华	5,626,500	7.50%
合计	75,020,000	100.00%

2003 年 2 月 19 日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】12 号文核准，采用向沪市、深市二级市场投资者定价配售方式发行了 2,600 万股人民币普通股（A 股）股票。发行后，公司股本总额增加至 10,102 万元。公司 2,600 万股人民币普通股于 2003 年 3 月 11 日在上海证券交易所系统挂牌上市交易。发行人上市时，股东持股情况如下：

股份性质	持股数量（股）	比例
一、非流通股		
自然人持有的非流通股	75,020,000	74.26%
其中：陈向东	13,053,480	12.92%
范伟宏	12,678,380	12.55%

郑少波	12,678,380	12.55%
江忠永	12,678,380	12.55%
罗华兵	12,678,380	12.55%
宋卫权	5,626,500	5.57%
陈国华	5,626,500	5.57%
二、流通股		
社会公众股	26,000,000	25.74%
合 计	101,020,000	100%

(二) 上市以来，发行人重大股权变动和重大资产重组情况

1、重大股权变动情况

(1) 2004 年转增股本

2004 年 4 月 2 日，公司 2003 年年度股东大会决议，以 2003 年末总股本 10,102 万股为基数，以资本公积金向全体股东按 10:10 的比例转增股本，共计转增 10,102 万股。本次转增后，公司总股本由 101,020,000 股增至 202,040,000 股。

(2) 2005 年股权转让

2004 年 1 月 8 日，公司发起人股东陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人签署了《关于设立杭州欣源投资有限公司协议书》，以其持有的士兰微 64.34% 股权（转增后的股数为 13,000 万股）及现金 100 万元出资设立杭州欣源投资有限公司。2004 年 11 月 5 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字【2004】76 号文批准，豁免陈向东等七人以所持士兰微股权出资设立杭州欣源投资有限公司而应履行的要约收购义务。

2004 年 12 月 31 日，陈向东等七人将其持有的 13,000 万股未上市流通自然人股过户给杭州欣源投资有限公司，股份性质变更为境内未上市流通法人股，公司股份总数未发生变化。

2005 年 4 月 8 日，士兰微完成股权的工商变更登记。此次股权变动后，杭州欣源投资有限公司持有士兰微 13,000 万股，占股份总数的 64.34%，成为士兰微的控股股东。2005 年 12 月 19 日，杭州欣源投资有限公司更名为“杭州士兰控股有限公司”。

(3) 2005 年股权分置改革

2005 年 10 月 24 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，公司流通股股东每持有 10 股流通股获得原非流通股股东支付的 3.6

股对价股份。股权分置改革工作完成后，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

（4）2006 年转增股本、股票分红

2006 年 4 月 18 日，2005 年年度股东大会决议，以 2005 年年末总股本 20,204 万股为基数，向全体股东每 10 股派送股票股利 2.2 股（每股面值 1 元），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.8 股。实施后，公司总股本由 20,204 万股增加到 40,408 万股。

（5）2007 年股权激励

2006 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了实施股票期权激励计划的方案，士兰控股按照股权分置改革时的承诺，对公司经营团队和科技人员实施股权激励。2007 年 1 月，士兰控股将 9,610,729 股公司股份过户给公司经营团队和科技人员。本次过户完成后，士兰控股还持有公司股份 217,949,921 股（占公司总股本的 53.94%）。

（6）2008 年股权激励

2008 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了继续实施股票期权激励计划的方案，士兰控股按照股权分置改革时的承诺，对公司经营团队和科技人员继续实施股权激励。2008 年 7 月，士兰控股将 2,321,454 股公司股份过户给公司经营团队和科技人员。本次过户完成后，士兰控股还持有公司股份 215,628,467 股（占公司总股本的 53.36%）。

（7）2010 年非公开发行 A 股

公司于 2009 年 12 月 31 日、2010 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议，并于 2010 年 1 月 28 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行人民币普通股（A 股）股票的相关议案。2010 年 8 月 11 日，中国证监会发行审核委员会无条件通过了公司本次发行申请。2010 年 8 月 25 日，公司收到中国证监会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1153 号），核准士兰微非公开发行不超过 6,000 万股新股。2010 年 9 月 8 日，发行人以 20 元/股向 8 家投资者非公开发行 3,000 万股 A 股，发行人股本总额由 40,408 万元增加到 43,408 万元。

2、最近三年一期重大资产重组情况

最近三年一期，发行人没有发生过重大资产重组。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至 2011 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：

股份性质	股份数（万股）	股权比例
一、有限售条件股份	3,000	6.91%
1、国家持股		
2、国有法人持股		
3、其他内资持股	3,000	6.91%
其中：境内非国有法人持股	2,700	6.22%
境内自然人持股	300	0.69%
4、外资持股		
其中：境外法人持股		
境外自然人持股		
二、无限售条件流通股份	40,408	93.09%
1、人民币普通股	40,408	93.09%
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
三、股份总数	43,408	100.00%

（二）发行人前十大股东持股情况

1、截至 2011 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

股份数量单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	杭州士兰控股有限公司	204,939,073	47.21%		34,800,000
2	华宝信托有限责任公司	9,900,000	2.28%	9,900,000	
3	陈向东	5,903,806	1.36%		
4	范伟宏	5,278,410	1.22%		
5	郑少波	5,209,300	1.20%		
6	中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	4,859,933	1.12%		
7	江忠永	4,150,000	0.96%		
8	上海万融投资发展有限公司	4,000,000	0.92%	4,000,000	4,000,000
9	太平人寿保险有限公司-投连-银保	3,805,303	0.88%		
10	中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	3,700,000	0.85%		

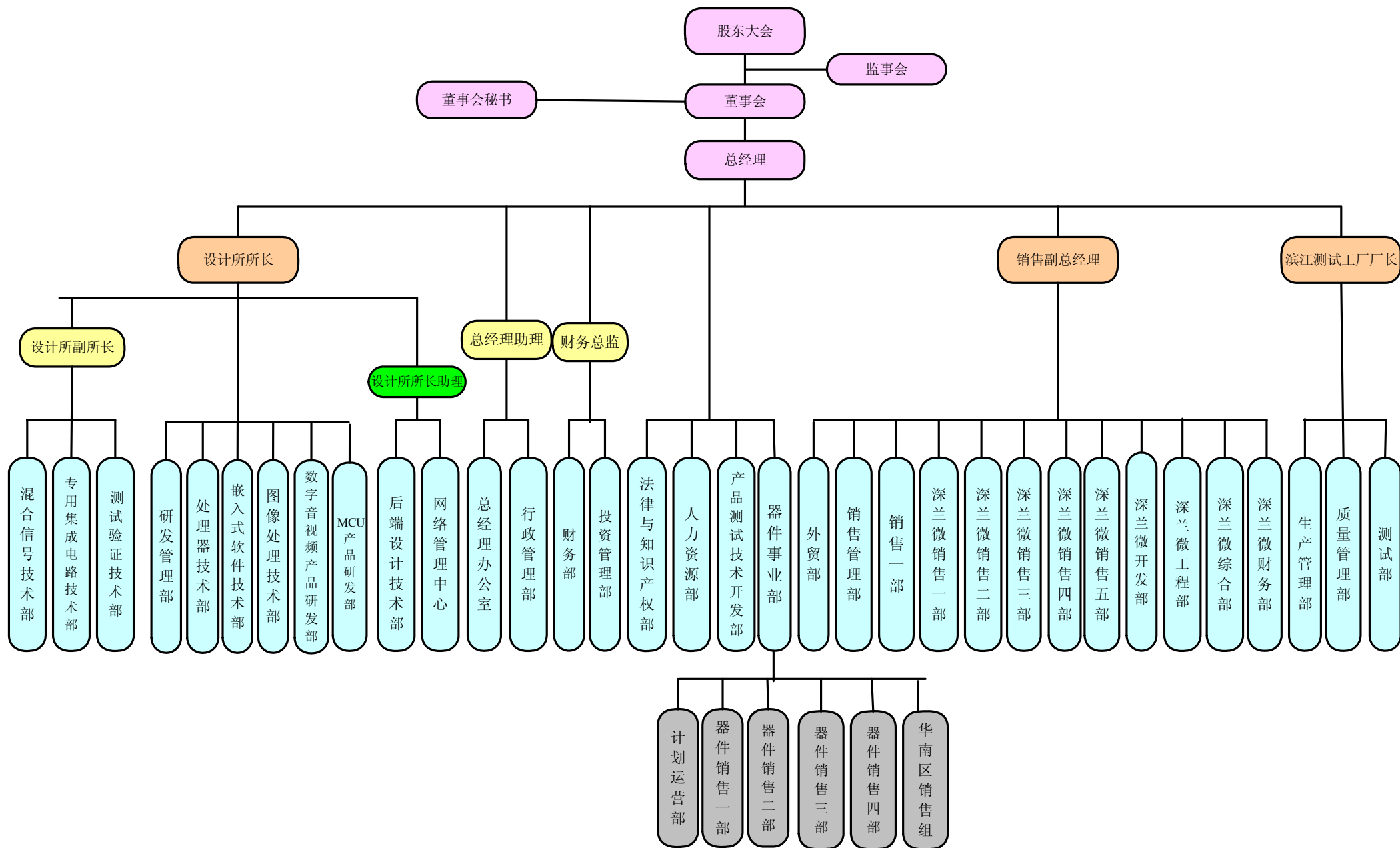
2、截至 2011 年 3 月 31 日，公司前十名无限售条件股东持股情况：

序号	股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量 (股)	持股比例
1	杭州士兰控股有限公司	204,939,073	47.21%
2	陈向东	5,903,806	1.36%
3	范伟宏	5,278,410	1.22%
4	郑少波	5,209,300	1.20%
5	中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	4,859,933	1.12%
6	江忠永	4,150,000	0.96%
7	太平人寿保险有限公司-投连-银保	3,805,303	0.88%
8	中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	3,700,000	0.85%
9	罗华兵	3,555,710	0.82%
10	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	3,199,844	0.74%

三、发行人的组织结构

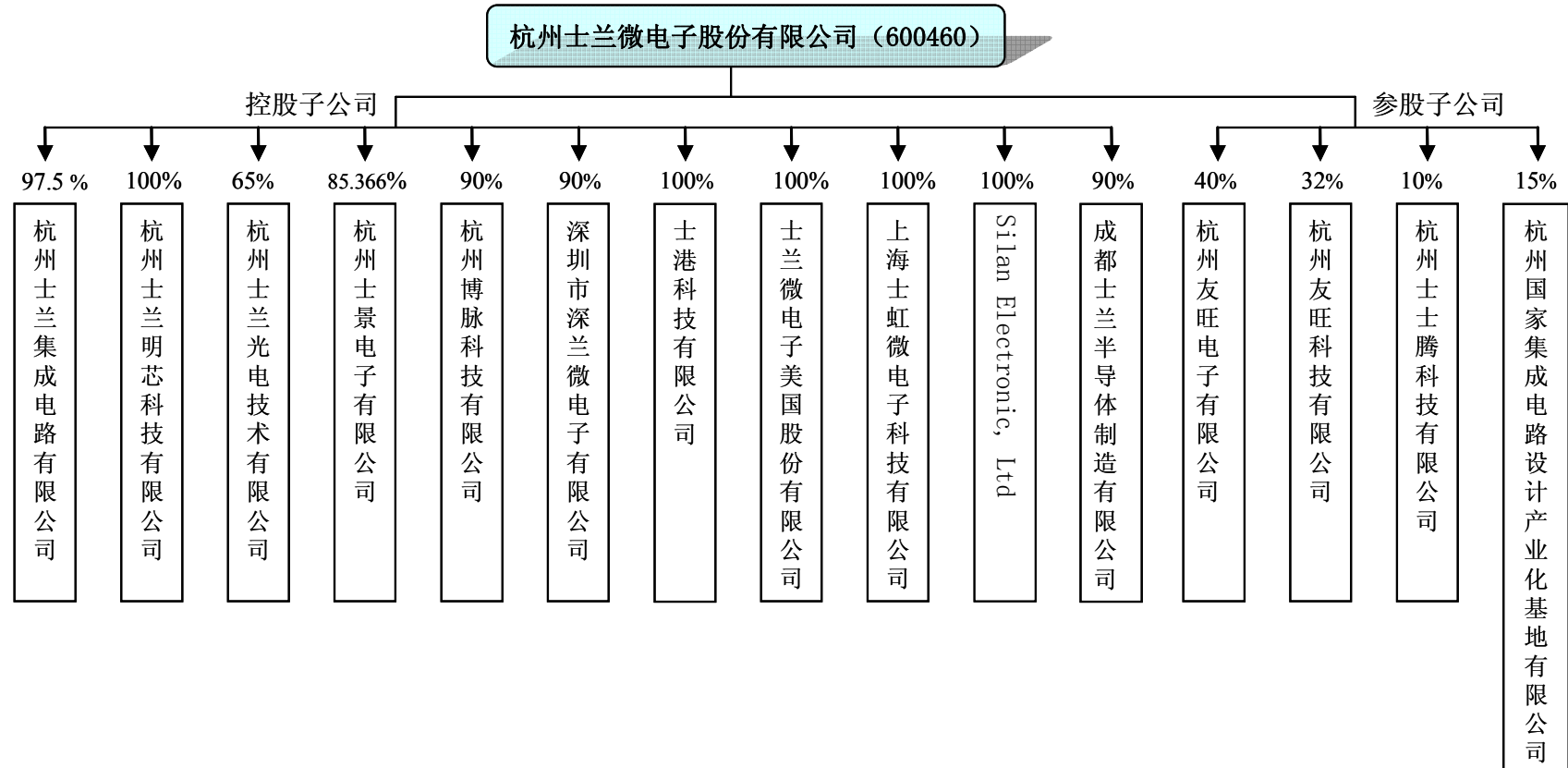
(一) 发行人的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：



（二）发行人的重要权益投资情况

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司的重要权益投资情况如下：



序号	公司名称	注册资本(万元)	股权比例	经营范围
1	杭州士兰集成电路有限公司	40,000	97.50% ^[1]	集成电路、半导体、分立器件的制造和销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务
2	杭州士兰明芯科技有限公司	50,000	100.00%	设计、制造发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备；销售自产产品；货物进出口；其它无需报经审批的一切合法项目
3	杭州士兰光电技术有限公司	2,000	65.00% ^[2]	设计、开发、生产光电模块、光电器件等相关产品及提供相关服务；销售自产产品
4	杭州士景电子有限公司	1,000	85.366% ^[3]	技术开发、技术服务、成果转让：微电子设计、生产、批发、零售：微电子产品，计算机软件
5	杭州博脉科技有限公司	500	90.00% ^[4]	设计、开发：电子产品以及与其相关的软件；生产、组装：多功能遥控器；批发、零售：多功能遥控器、电子产品及相关的软、硬件；服务：提供计算机系统方案；其他无需报经审批的一切合法项目
6	深圳市深兰微电子有限公司	300	90.00% ^[5]	电子产品购销及其他国内商业、物资供销业
7	士港科技有限公司	美元 300	100.00% ^[6]	电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务
8	士兰微电子美国股份有限公司	美元 200	100.00% ^[7]	电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、销售，经营进出口业务
9	上海士虹微电子科技有限公司	1,000	100.00%	微电子、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计；微电子产品销售
10	Silan Electronics,Ltd.	美元 800	100.00% ^[8]	——
11	成都士兰半导体制造有限公司	20,000.00	90.00% ^[9]	集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售；货物进出口。
12	杭州友旺电子有限公司	美元 300	40.00%	半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务

13	杭州友旺科技有限公司	美元 437.5	32.00%	光电器件、半导体元器件的研究、开发；光电器件、半导体元器件的生产
14	杭州士腾科技有限公司	1,000	10.00% ^[10]	技术开发、技术服务：与微控制器、分级处理器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件；生产：微处理器；批发、零售：微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件；货物进出口；含下属分支机构经营范围；其他无需报经批准的一切合法项目
15	杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	1,000	15.00%	国家集成电路设计杭州产业化基地的规划、服务及相关技术平台和配套设施的建设、经营，与集成电路设计相关的技术开发、技术服务、技术咨询，人才非学历培训，中小集成电路设计企业培育孵化；其他无需报经审核的一切合法项目

注：[1]友旺电子的股权比例为 1.875%，士兰明芯的股权比例为 0.625%；

[2]Silan Electronics,Ltd 的股权比例为 15%，Unidux Electronics,Ltd 的股权比例为 10%，杭州玄同电子有限公司的股权比例为 10%；

[3]自然人张伟峰的股权比例为 14.634%；

[4]自然人江强、黄景江的股权比例分别为 8.8%和 1.2%；

[5]士兰集成的股权比例为 10%；

[6]士港科技系发行人于 2004 年 4 月 21 日经商务部商合批【2004】155 号《商务部关于同意设立士港科技有限公司的复函》同意，投资 10 万美元在香港设立的有限责任公司；2005 年 10 月 24 日，经商务部【2005】商合港澳企证字第 HM0275 号《批准证书》批准，发行人对士港科技的投资从 10 万美元追加至 100 万美元；2006 年 4 月 4 日，经商务部【2006】商合境外投资证字第 000333 号《批准证书》批准，发行人对士港科技的投资从 100 万美元追加至 300 万美元。截至 2011 年 3 月 31 日，发行人实际已向该公司出资 200 万美元；

[7]士兰美国系发行人于 2005 年 10 月 17 日经商务部【2005】商合境外企证字第 000622 号《批准证书》批准，投资 200 万美元在美国加利福尼亚州设立的股份有限公司。截至本募集说明书签署之日，发行人实际已向该公司出资 200 万美元；

[8]士兰 B.V.I 系发行人于 2006 年 3 月 15 日经商务部【2006】商合境外投资证字第 00237 号《批准证书》批准，投资 300 万美元在英属维尔京群岛设立的股份有限公司；2008 年 1 月 31 日经商务部【2008】商合境外投资证字第 000232 号《批准证书》批准，发行人向士兰 B.V.I 的投资增加至 800 万美元。截至本募集说明书签署之日，发行人实际已向该公司出资 465 万美元；

[9]士兰明芯持有的股权比例为 10%。成都士兰注册于 2010 年 11 月 18 日，注册资本为 2 亿元人民币，截至 2011 年 3 月 31 日，实收资本为 6,000.00 万元。

[10]自然人李文杰、刘建江、陈浩、杨海峰的股权比例分别为 8%、4.5%、2%和 2%，士兰控股的股权比例为 73.50%。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

发行人的控股股东为杭州士兰控股有限公司，实际控制人为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人。自 2008 年以来，发行人的控股股东和实际控制人没有发生变化。

除发行人的控股股东和实际控制人外，不存在其他持有发行人 5%以上股份的股东。

（一）发行人控股股东基本情况

1、士兰控股的基本信息

公司名称：	杭州士兰控股有限公司
成立时间：	2004 年 12 月 14 日
注册资本：	13,100 万元人民币
法定代表人：	陈向东
经营范围：	实业投资；货物进出口，技术进出口；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），计算机技术服务
注册地址：	杭州滨江区创业路 1 号 9 幢 416 室
办公地址：	杭州市杭大路 15 号嘉华国际 1116 号

士兰控股的前身为杭州欣源投资有限公司，成立于 2004 年 12 月 14 日。2004 年 1 月 8 日，公司发起人陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人签署《关于设立杭州欣源投资有限公司协议书》，以其持有士兰微 64.34%的股权（转增后的股数为 13,000 万股）及现金 100 万元出资设立杭州欣源投资有限公司。欣源投资成立后，陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人分别持有其 17.40%、16.90%、16.90%、16.90%、16.90%、7.50%、7.50%的股权。

2005 年 12 月 19 日，杭州欣源投资有限公司更名为“杭州士兰控股有限公司”。

2、截至 2011 年 3 月 31 日，除发行人外，士兰控股的主要控股子公司和参股公司情况如下：

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	杭州士兰创业投资有限公司	3,000	85.00% ^[1]	创业投资
2	杭州士兰投资咨询有限公司	500	80.00% ^[2]	投资咨询、管理咨询、实业投资

3	杭州澳之品贸易有限公司	300	80.00% ^[3]	批发、零售：预包装食品，日用品，工艺美术品；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目
4	杭州士鹏科技有限公司	200	47.60% ^[4]	技术开发、技术咨询、销售：电子产品、计算机软件
5	杭州国家软件产业基地有限公司	2,000	10.00% ^[5]	软件产业基地的规划、建设、管理及配套服务，信息交流（除证券和期货信息），市场拓展和品牌宣传（除广告）；企业管理和经营咨询，中小企业培育孵化，对软件企业的投资
6	浙江产权交易所有限公司	2,200	9.09% ^[6]	依法组织产权交易，开展相关咨询服务
7	苏州君赢电子科技有限公司	500	32% ^[7]	集成电路的设计；软件，半导体产品的开发；销售：电子产品及配件，计算机软件，半导体产品及配件、原料，化工产品及原料，机械，五金交电，通讯器材，金属材料，建材；从事上述产品的进出口业务；投资咨询
8	杭州士腾科技有限公司	1,000	73.50% ^[8]	技术开发、技术服务：与微控制器、分级处理器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件；生产：微处理器；批发、零售：微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件；货物进出口；含下属分支机构经营范围；其他无需报经批准的一切合法项目
9	玛斯特杭州酒文化推广有限公司	\$ 160	80% ^[9]	酒文化推广，酒文化艺术包装设计、制作、咨询；艺术品交易，文化沙龙；展览展示；企业文化、管理咨询；商务信息咨询，市场调研、营销策划；批发及进出口：预包装食品；工艺美术品（不含文物）；日用品。

注：[1]杭州科艺投资管理有限公司的股权比例为 15%；

[2]自然人陈永红的股权比例为 20%；

[3]自然人江宇芬的股权比例为 20%；

[4]杭州波导软件有限公司的股权比例为 35.70%；苏州君耀光电有限公司的股权比例为 10%；金峥的股权比例为 6.70%；

[5]杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司的股权比例为 40%；恒生电子股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、中控科技集团有限公司、中程科技有限公司、杭州自动化技术研究院有限公司的股权比例皆为 10%；

[6]华立集团股份有限公司、通联创业投资股份有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省商业集团有限公司、浙江国大集团有限公司、万丰奥特控股集团有限公司、精功集团有限公司、浙江华日实业投资有限公司、浙江欧能电力集团股份有限公司、浙江省综合资产经营有限公司的股权比例皆为 9.09%，尾差为四舍五入所致。

[7]杭州士鹏科技有限公司持有 50%，苏州君耀光电有限公司的股权比例为 10%，自然人金峥的股权比例为 6%，自然人胡丛珏的股权比例为 2%。

[8]根据士兰微与士兰控股于 2010 年 12 月 28 日签订的《股权转让协议》，士兰微以 8,312,850.00 元将所持有的杭州士腾科技有限公司 73.50%股权转让给士兰控股公司，转让后杭州士兰微电子股份有限公司的股权比例为 10%，自然人李文杰、刘建江、陈浩、杨海峰的股权比例分别为 8%、4.5%、2%和 2%。

[9]自然人高歌辉的股权比例为 20%。

3、最近一年主要财务数据

2010 年 12 月 31 日，士兰控股总资产为 22,459.20 万元，净资产为 22,159.45 万元，2010 年实现净利润 469.64 万元。以上财务数据摘自士兰控股 2010 年经中瑞岳华会计师事务所有限公司浙江分所出具的标准无保留意见的审计报告（中瑞岳华浙分审字[2011]第 A0140 号）。

（二）发行人实际控制人基本情况

1、发行人实际控制人基本情况

发行人实际控制人为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人。截至 2011 年 3 月 31 日，实际控制人基本情况如下：

实际控制人	国籍	其他国家或地区居留权	直接持股总数（股）	直接持股比例
陈向东	中国	无	5,903,806	1.36%
范伟宏	中国	无	5,278,410	1.22%
郑少波	中国	无	5,209,300	1.20%
江忠永	中国	无	4,150,000	0.96%
罗华兵	中国	无	3,555,710	0.82%
宋卫权	中国	无	2,305,000	0.53%
陈国华	中国	无	1,600,952	0.37%

2、实际控制人简要背景

实际控制人均在公司担任董事和/或高级管理人员或监事职务，实际控制人简要背景详见本募集说明书“第八节发行人基本情况”之“五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员简介”。

3、发行人实际控制人的认定依据

陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人为发行人的共同实际控制人，其认定的事实及理由主要如下：

（1）陈向东等七人自发行人设立至今均直接持有公司股份和/或间接支配公司股份的表决权

陈向东等七人为发行人的创始人，自发行人设立至今，陈向东等七人共同直接持有和/或间接支配公司股份表决权总数的 50%以上，且每人均直接持有和/或间接支配公司股份的表决权。

自发行人设立至今，发行人虽历经首次公开发行股票并上市、陈向东等七人设立杭州欣源投资有限公司（后更名为“杭州士兰控股有限公司”，以下简称“欣源投资”）并通过欣源投资间接控制发行人、股权分置改革、非公开发行股票等股本结构变更事宜，发行人的控股权始终由陈向东等七人共同控制，未发生变化。

（2）陈向东等七人以共同设立欣源投资的方式实现对发行人的共同控制

2004 年 1 月 8 日，陈向东等七人签署《关于设立杭州欣源投资有限公司协议书》，协议约定陈向东等七人以其所持士兰微 64.34%的股份及 100 万元现金出资设立欣源投资。该协议自中国证监会于 2004 年 11 月 5 日以《关于同意豁免陈向东等七人要约收购“士兰微”股票义务的批复》同意豁免要约收购义务之后生效。

欣源投资（士兰控股）自 2004 年 12 月设立至今保持发行人的控股股东地位不变。截至 2011 年 3 月 31 日，士兰控股持有发行人 204,939,073 股股份，占发行人股份总数的 47.21%。陈向东等七人通过士兰控股间接控制及直接持有发行人股份合计为 232,942,251 股，占发行人股份总数的 53.66%。

本保荐机构认为，陈向东等七人以签署《关于设立杭州欣源投资有限公司协议书》并共同投资设立欣源投资的方式将原由七人分散持有的发行人相应股份改由欣源投资合并持有，在发行人股东大会审议相关事项时，陈向东等七人原先各自独立行使的发行人的表决权通过欣源投资共同行使，客观上形成了陈向东等七人对士兰微的共同实际控制。

因此，本保荐机构认为陈向东等七人共同拥有发行人控制权已通过七人共同设立欣源投资的方式予以明确，所签署的协议为合法有效，陈向东等七人将所持

发行人股份投资设立欣源投资已获中国证监会、工商行政主管部门批准，为合法、有效。

(3) 陈向东等七人对发行人的共同控制在最近三年一期及可预期期限内为稳定、有效存在

2004 年 1 月 8 日，陈向东等七人签署《承诺函》承诺：欣源投资（士兰控股）设立后，在陈向东等七人担任士兰微董事、监事、经理期间，陈向东等七人不转让其所持欣源投资的股权。

经本保荐机构核查，陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵担任发行人董事，宋卫权、陈国华担任发行人监事，上述任职情况在最近三年内未发生变化。

发行人 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年第一次临时股东大会重新选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵为公司第四届董事会非独立董事，选举宋卫权、陈国华为公司监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。根据陈向东等七人的承诺，在陈向东等七人担任发行人董事、监事、经理期间，陈向东等七人不转让其所持欣源投资的股权。

经本保荐机构核查，陈向东等七人对欣源投资（士兰控股）自设立至今的持股情况未发生变化，陈向东等七人最近三年一期实际控制发行人超过 50% 的股份。截至 2011 年 3 月 31 日，陈向东等七人通过士兰控股间接控制以及直接持有发行人的股份合计为 232,942,251 股，占发行人股份总数的 53.66%，仍维持对发行人的控股地位。

因此本保荐机构认为，在陈向东等七人遵守承诺且继续担任发行人董事、监事的三年内，其对士兰控股的持股情况不会发生变化，对发行人的共同控制在最近三年内及可预期期限内为稳定及有效存在的。

(4) 发行人最近三年一期公司治理结构健全、运行良好

① 发行人具有健全的组织机构

经本保荐机构核查，发行人已按照《公司法》的相关要求建立了股东大会、董事会和监事会，具有健全的组织机构。目前发行人董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名。监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表。董事会下设专门委员会，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。

② 发行人具有完善的公司治理制度

发行人已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规程》等公司治理制度。本保荐机构认为，发行人具有完善的规章制度。

③发行人最近三年一期公司治理运作规范、良好

经本保荐机构核查，发行人最近三年一期的股东大会、董事会、监事会能依照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作并不断完善，陈向东等七人共同控制并未影响发行人的公司治理规范运作。

综上所述，本保荐机构认为，发行人最近三年一期公司治理结构及治理制度健全，运作良好，陈向东等七人共同控制发行人不影响发行人公司治理规范运作。

（5）经本保荐机构核查，在最近三年一期，陈向东等七人均担任发行人之董事或监事职务，作为发行人之创始人团队以及实际经营决策团队，陈向东等七人对发行人的生产经营能够实施重大影响。

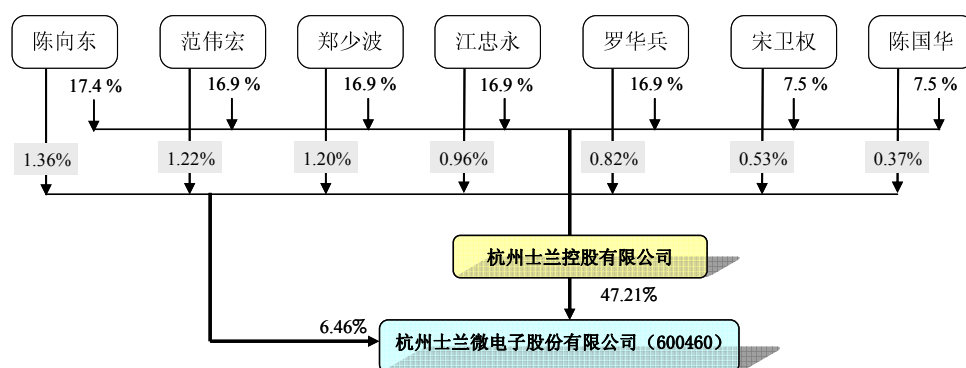
鉴于上述事实及理由，本保荐机构认为：陈向东等七人共同实际控制发行人，且共同实际控制在最近三年一期内及可预期期限内为稳定且有效存在的，陈向东等七人的共同控制关系不影响发行人最近三年一期的公司治理规范运作，符合中国证监会《证券期货法律适用意见第1号》关于认定多人共同拥有控制权的相关条件。

4、发行人实际控制人对其他企业投资情况

截至2011年3月31日，发行人实际控制人除直接持有、通过士兰控股间接控制公司53.66%的股份外，无对其他企业投资的情况。

（三）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2011年3月31日，本公司与公司控股股东和实际控制人之间的股权关系如下：



五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓 名	性别	年龄	职 务	任期起始日期
陈向东	男	49	董事长	2009.11.16~2012.11.15
郑少波	男	46	副董事长、总经理	2009.11.16~2012.11.15
范伟宏	男	49	副董事长	2009.11.16~2012.11.15
江忠永	男	47	董事	2009.11.16~2012.11.15
罗华兵	男	48	董事	2009.11.16~2012.11.15
李志刚	男	47	董事、副总经理	2009.11.16~2012.11.15
钟晓敏	男	48	独立董事	2009.11.16~2012.11.15
汪 炜	男	44	独立董事	2009.11.16~2012.11.15
仇佩亮	男	67	独立董事	2009.11.16~2012.11.15
裴长洪	男	57	独立董事	2009.11.16~2012.11.15
金小刚	男	45	独立董事	2009.11.16~2012.11.15
宋卫权	男	43	监事会主席	2009.11.16~2012.11.15
陈国华	男	48	监事	2009.11.16~2012.11.15
胡铁刚	男	33	职工代表监事	2009.11.16~2012.11.15
陈 越	男	41	财务总监、董事会秘书	2009.11.16~2012.11.15
王海川	男	59	副总经理	2009.11.16~2012.11.15

（二）董事、监事、高级管理人员简介

董事长 陈向东：男，中国国籍，汉族，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科。现任士兰集成、士兰明芯、美卡乐、士兰光电、士腾科技、士景电子董事长，成都士兰、博脉科技、上海士虹执行董事，士兰美国、士兰 B.V.I 董事，士港科技董事；友旺电子、友旺科技副董事长；士兰控股、士鹏科技董事长，士兰创投、士兰咨询执行董事。

副董事长、总经理 郑少波：男，中国国籍，汉族，1965 年 1 月出生，中共

党员，硕士。现任士兰光电、士腾科技、士港科技董事，深兰微执行董事，士兰集成、士兰明芯、士景电子监事；士兰控股董事，士兰创投监事。

副董事长 范伟宏：男，中国国籍，汉族，1962 年 12 月出生，中共党员，大学本科。现任士兰集成董事、总经理，士兰明芯、士兰光电董事；成都士兰总经理；士兰控股董事。

董事 江忠永：男，中国国籍，汉族，1964 年 8 月出生，大学本科。现任士兰明芯、美卡乐董事、总经理，士兰集成董事；成都士兰监事；士兰控股董事。

董事 罗华兵：男，中国国籍，汉族，1963 年 10 月出生，大学本科。现任友旺电子、友旺科技董事、总经理，士兰集成、天水华天监事；士兰控股董事、澳之品执行董事、总经理，玛斯特执行董事、总经理。

董事 李志刚：男，中国国籍，汉族，1964 年 10 月出生，大学本科。现任深兰微、士港科技总经理。

独立董事 钟晓敏：男，中国国籍，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员，博士，教授。浙江财经学院副校长，兼任上海财经大学硕士生导师，中南财经政法大学博士生导师，中国财政学会理事，浙江省预算会计研究会常务理事，浙江省委政策研究室特聘研究员，杭州市决策咨询委员会委员，杭州市人大财经委专家组副组长。现兼任财通证券、锅炉集团独立董事。

独立董事 汪炜：男，中国国籍，汉族，1967 年 8 月出生，博士。浙江大学教授，博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”入选者。浙江大学经济学院副院长，浙江大学金融研究院（浙江省金融研究院）执行院长，“国家 985 创新基地、教育部重点研究基地”浙江大学民营经济研究中心（CRPE）副主任。兼任浙江省证券与上市公司研究会副会长、浙江省经济学会常务理事、台湾财务工程学会高级顾问等职。

独立董事 仇佩亮：男，中国国籍，汉族，1944 年 10 月出生。浙江大学信息学院信息与电子工程学系教授、博士生导师；兼任中国电子学会信息论专业委员会副主任，浙江大学学报工学版编委。

独立董事 裴长洪：男，中国国籍，汉族，1954 年 5 月出生，中共党员，博士。中国社会科学院经济研究所研究员、博士导师、所长。现兼任杭州解百股份有限公司独立董事。

独立董事 金小刚：男，中国国籍，汉族，1966 年 12 月出生，博士后。浙江大学宁波理工学院信息科学与工程分院副院长。

监事会主席 宋卫权：男，中国国籍，汉族，1968 年 12 月出生，大学本科。现任公司设计所所长，公司芯片设计技术负责人；士景电子董事，上海士虹监事；士兰控股监事，士鹏科技董事，君赢电子董事长。

监事 陈国华：男，中国国籍，汉族，1963 年 8 月出生，大学本科。现任深兰微监事；友旺科技副总经理；士兰控股监事。

职工代表监事 胡铁刚：男，中国国籍，汉族，1978 年 10 月出生，大学本科。现任公司设计所混合信号及射频产品线总经理。

财务总监、董事会秘书 陈越：男，中国国籍，汉族，1970 年 1 月出生，硕士。现任士兰光电、士腾科技、博脉科技监事，士兰美国财务负责人。

副总经理 王海川：男，中国国籍，汉族，1952 年 10 月出生，大学专科。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至 2011 年 3 月 31 日，发行人董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓 名	在发行人处的职务	兼职情况
陈向东	董事长	士兰集成、士兰明芯、士兰光电、士腾科技、士景电子、士兰控股、美卡乐、士鹏科技董事长，士兰美国、士兰 BVI、士港科技、天水华天、友旺电子、友旺科技董事，成都士兰、上海士虹、博脉科技、士兰创投、士兰咨询执行董事
郑少波	副董事长、总经理	士兰集成、士兰明芯、士景电子、士兰创投监事，士兰光电、士腾科技、士兰控股董事、士港科技董事、深兰微执行董事
范伟宏	副董事长	士兰集成、士兰明芯、士兰光电董事，士兰控股董事；成都士兰、士兰集成总经理
江忠永	董事	士兰集成、士兰明芯、美卡乐董事，士兰控股董事；士兰明芯、美卡乐总经理、成都士兰监事
罗华兵	董事	友旺电子、友旺科技董事兼总经理，士兰控股董事，士兰集成、天水华天监事，澳之品执行董事兼总经理，玛斯特执行董事、总经理
李志刚	董事、副总经理	深兰微、士港科技总经理
钟晓敏	独立董事	财通证券、锅炉集团独立董事
汪 炜	独立董事	无
仇佩亮	独立董事	无
裴长洪	独立董事	杭州解百独立董事
金小刚	独立董事	无

宋卫权	监事会主席	士景电子董事，上海士虹、士兰控股监事，士鹏科技董事，君赢电子董事长
陈国华	监事	深兰微、士兰控股监事，友旺科技副总经理
胡铁刚	职工代表监事	无
陈越	财务总监、董事会秘书	士兰光电、博脉科技、士腾科技监事，士兰美国财务负责人
王海川	副总经理	无

本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬及持有发行人股份情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬系根据公司的实际经营情况确定，其中董事、监事的报酬由董事会提交股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。2010年公司董监高从公司领取的报酬总额及截至2011年3月31日的持股情况如下：

姓 名	职 务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	2010年从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	持有本公司股票（股）	持股比例
陈向东	董事长	否	70.4	5,903,806	1.36%
郑少波	副董事长、总经理	否	69	5,209,300	1.20%
范伟宏	副董事长	否	66	5,278,410	1.22%
江忠永	董事	否	61.2	4,150,000	0.96%
罗华兵	董事	是	0	3,555,710	0.82%
李志刚	董事、副总经理	否	61.5	424,150	0.10%
钟晓敏	独立董事	否	6.00	0	0
汪炜	独立董事	否	6.00	0	0
仇佩亮	独立董事	否	6.00	0	0
裴长洪	独立董事	否	6.00	0	0
金小刚	独立董事	否	6.00	0	0
宋卫权	监事会主席	否	57.3	2,305,000	0.53%
陈国华	监事	是	0	1,600,952	0.37%
胡铁刚	职工代表监事	否	48.5	60,000	0.01%
陈越	财务总监、董事会秘书	否	83	264,515	0.06%
王海川	副总经理	否	34.8	160,092	0.04%

六、公司所从事的主要业务及主要产品用途

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事集成电路、分立器件及 LED 三大类业务产品的设计、制造与销售业务，属于制造业中的电子元器件制造业。

（二）公司主要产品用途

公司三大类业务产品按七大产品线进行规划、管理和运行：1、电源与功率驱动产品线；2、数字音视频产品线；3、MCU 产品线；4、混合信号与射频产品线；5、安防监控产品线；6、分立器件产品线；7、LED 器件产品线。主要产品用途如下：

主营业务产品	产品线	产品主要用途
集成电路	电源与功率驱动产品线	依托于士兰芯片生产线先进的 BCD 工艺和高压集成电路工艺，发展先进的电源和电机驱动线路架构，发展高效率低待机功耗的绿色节能电源产品、LED 照明驱动电路、直流变频电机驱动电路及模块。
	数字音视频产品线	发展以光盘伺服技术、数字音视频解码技术为核心的 SOC 产品；以高性价比的应用方案开发拓展数字媒体中心在各细分市场的应用。
	MCU 产品线	以四位、八位 MCU 核为基本的线路架构，开发应用于家用电器控制的 MCU 产品。
	混合信号与射频产品线	发展高集成度、高性价比的电动遥控玩具芯片、内置射频、MCU、功率驱动等功能。 依托于士兰芯片生产线的高频 BiCMOS 工艺，发展应用于机顶盒、数字电视的高频调谐器电路。
	安防监控产品线	开发高性价比的多通道、高集成度的 H.264 视频编码电路，为客户提供高性价比的数字视频监控产品解决方案。
分立器件	分立器件产品线	电子产品基础器件。
LED	LED 器件产品线	户内外显示屏、照明等应用领域。

（三）公司主营业务基本情况

1、发行人最近三年一期主营业务收入构成（合并报表口径）

单位：万元

产品（或行业）名称	2011 年 1-3 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
集成电路	13,592.61	42.05%	60,766.38	40.03%	44,371.71	46.32%	46,936.88	50.38%
器件	10,751.86	33.26%	51,317.10	33.81%	30,651.73	32.00%	26,768.58	28.73%
发光二极管	7,897.26	24.43%	39,214.77	25.83%	20,192.32	21.08%	18,277.40	19.62%

其他	81.33	0.25%	501.72	0.33%	568.82	0.59%	1,186.98	1.27%
合计	32,323.06	100.00%	151,799.97	100.00%	95,784.58	100.00%	93,169.84	100.00%

2、发行人最近三年一期主要产品产能、产量、销量情况

母公司士兰微是一家纯芯片设计企业，没有常规意义上的大宗原材料采购，采用轻资产运行模式，其业务开展以委托加工的方式进行，实行以销定产。产品经过设计研发→芯片制造→芯片测试→电路封装→成品测试→销售等流程。其中产品设计研发由士兰微完成；芯片制造委托士兰集成和外部专业的芯片代工厂完成；产品封装委托外部专业的代工厂完成。

（1）集成电路

对于集成电路产品而言，因母公司士兰微为纯芯片设计企业，产品经圆片制造后需进行委托封装成电路方对外销售，其销售情况根据市场需求进行调整，决定是否进行封装。因而，其产量数据为根据委托代工后检测入库的数据。

母公司士兰微集成电路产量、销量情况

集成电路			
期间	产量（颗）	销量（颗）	产销率
2011年1-3月	173,786,800	162,605,600	93.57%
2010年度	669,850,400	662,081,600	98.84%
2009年度	537,181,400	552,614,130	102.87%
2008年度	452,683,000	482,054,000	106.49%

集成电路产品的生产能力主要体现为公司两大制造主体之一的士兰集成的芯片生产能力。报告期内，士兰集成公司电路产品的生产、销售情况如下：

士兰集成公司集成电路产品情况					
年份	产能（片）	产量（片）	销量（片）	产能利用率	产销率
2011年1-3月	80,000	72,157	72,065	90.20%	99.87%
2010年	320,000	307,829	307,797	96.20%	99.99%
2009年	300,000	187,173	188,170	62.39%	100.53%
2008年	280,000	190,894	187,740	68.18%	98.35%

（2）分立器件

对于分立器件产品，公司分立器件产品主要由士兰微设计，子公司士兰集成生产、制造。母公司士兰微从士兰集成采购器件芯片后，一般不再进行生产加工而直接用于销售，因而器件产品的生产情况主要体现于子公司士兰集成的生产能力。

士兰集成公司分立器件产品情况

期间	产能（片）	产量（片）	销量（片）	产能利用率	产销率
2011 年 1-3 月	250,000	246,386	246,392	98.55%	100.00%
2010 年度	983,500	906,432	910,325	92.16%	100.43%
2009 年度	750,000	555,655	570,226	74.09%	102.62%
2008 年度	600,000	476,347	475,756	79.39%	99.88%

（3）LED 产品

发行人 LED 产品的研发、生产和销售由士兰明芯独立进行，报告期内士兰明芯主要生产产品的生产情况如下：

单位：（百万颗）

LED 产品					
期间	产能	产量	销量	产能利用率	产销率
2011 年 1-3 月	2,150	1,691	1,244	78.65%	73.57%
2010 年度	6,550	6,214	6,101	94.87%	98.18%
2009 年度	4,200	3,847	2,825	91.60%	73.43%
2008 年度	3,060	2,492	1,695	81.44%	68.02%

注：士兰明芯近一半的外延片为外购，由于目前外延片供应较为紧张，且新增的自产外延片的产能尚未释放，造成一季度生产产能利用率低于 2010 年的平均水平。产销率低于 2010 年平均水平的主要原因系士兰明芯产品的主要应用领域户内外彩屏市场一季度为市场淡季。

七、公司所处行业的情况

发行人为专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售的高新技术企业，公司所处行业为制造业——电子元器件制造业。

发行人主营产品均属半导体器件，半导体产业的行业特性均适用于发行人的三大主要产品。其中，集成电路与分立器件内部关联度较高；LED 作为新兴领域，其应用领域较传统元器件略有区别。因此，以下根据发行人主要产品应用的两大细分行业——集成电路行业和 LED 行业分别阐述其基本情况：

（一）集成电路行业

1、行业基本情况及整体发展趋势

（1）基本情况

集成电路（Integrated Circuit，又称“IC”）是一种微型电子器件或部件，俗称芯片。其产品的生产经营过程一般包括：产品设计→掩膜制造→芯片制造→芯片测试→电路封装→电路测试→销售产品，按其制造流程可归类为集成电路设计、制造、封装测试三大环节。

其中，芯片制造的过程为：通过采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，使其成为具有所需电路功能的微型结构。

作为信息产业的基础和核心，集成电路行业是国民经济的关键基础行业，在国民经济中占据着十分重要的战略地位。集成电路具有体积小、重量轻、引出线和焊接点少、寿命长、可靠性高、性能好等优点；同时生产成本较低，便于大规模生产。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。

(2) 整体发展趋势

自 2008 年三季度以来，由于受全球金融危机迅速波及实体经济的影响，国内外半导体市场迅速出现大幅下滑，国内集成电路产业受此影响也出现前所未有的大幅下滑。2009 年下半年以来，随着国家拉动内需政策的迅速制定和深入实施，以及国际市场环境的逐步好转，国内集成电路产业呈现显著的回暖势头。2011 年，在全球半导体产业复苏与国内市场继续保持旺盛需求的双重带动下，预计全球、国内集成电路产业均将呈现快速回升的趋势。

2、行业监管体制

我国集成电路行业已基本实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营；政府职能部门进行产业宏观调控；行业协会进行自律规范。目前，我国半导体行业的主管部门是工业和信息化部，行业协会是中国半导体行业协会（CSIA）。

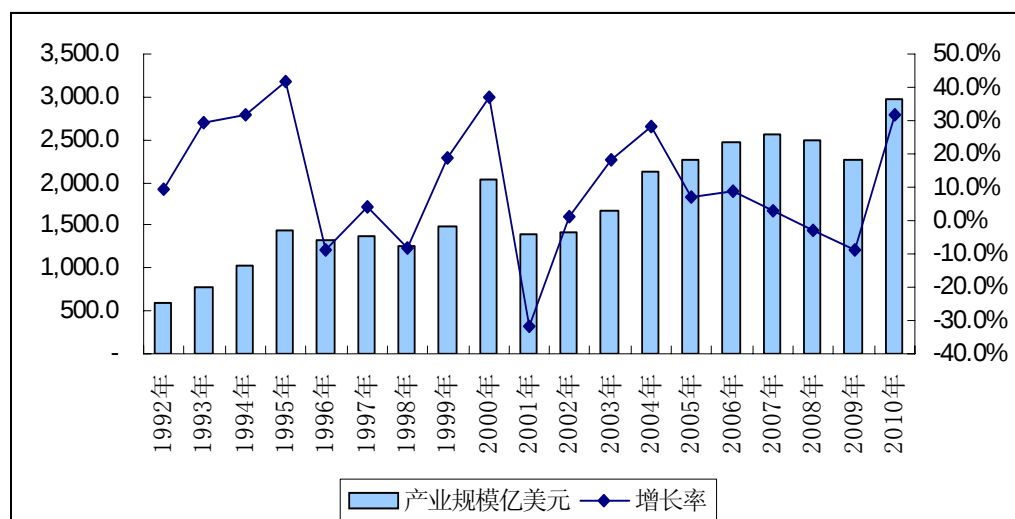
3、行业市场状况

(1) 全球集成电路市场状况

2008 年下半年遭遇了全球性金融危机的冲击，全球集成电路行业增长停滞，陷入衰退。但在各国经济刺激政策相继出台的刺激下，全球半导体市场自 2009 年 3 季度开始回暖。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的统计，2009 年全球半导体产业同比增速由年初的下滑 20%以上迅速回升至全年仅下降 9%，全年产业整体规模为 2,263 亿美元，较 2008 年的 2,486 亿美元减少了 223 亿美元。2010 年，全球半导体市场规模 2,983.2 亿美元，市场增速高达 31.8%，是继 2000 年以

来市场增速最快的一年，在经历了 2009 年的下滑之后，市场大幅反弹，结束了连续多年来的低迷发展态势^[3]。据市场调研机构iSuppli发布的资料显示，其在 2011 年 3 月 30 日汇总的全球半导体市场最新预测中，预计 2011 年的全球半导体市场规模将达到 3,252 亿美元（文章来自电子元件技术网）。

1992—2010 年全球半导体产业销售收入规模及增长率情况^[4]



数据来源：美国半导体产业协会 SIA 2011, 02

(2) 我国集成电路市场状况^[5]

①产业规模

“十一五”以来，我国集成电路产业呈现良好发展势头，迈上一个新的台阶。“十一五”前期，我国集成电路产业延续了自 2000 年以来快速发展的势头，中期受到国际金融危机和集成电路产业硅周期双重影响连续两年下滑，但在国内宏观经济向好和全球集成电路市场复苏的带动下，2010 年我国集成电路产业扭转了下滑局面并实现大幅增长。2005-2009 年，我国集成电路产量从 261.1 亿块提高到 414.4 亿块，年均增速为 12.2%；销售额从 702.1 亿元提高到 1,109.1 亿元，年均增速为 12.1%。2010 年我国集成电路产业出现强劲反弹，全年集成电路产量达到 653 亿块，同比大幅增长 57.6%；销售收入达到 1,440.2 亿元，同比大幅增

^[3] 数据来源：中国半导体行业协会之“国内新闻”之《2010 年中国集成电路市场大幅反弹，市场规模达 7349.5 亿元》；网址：<http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=17691>。

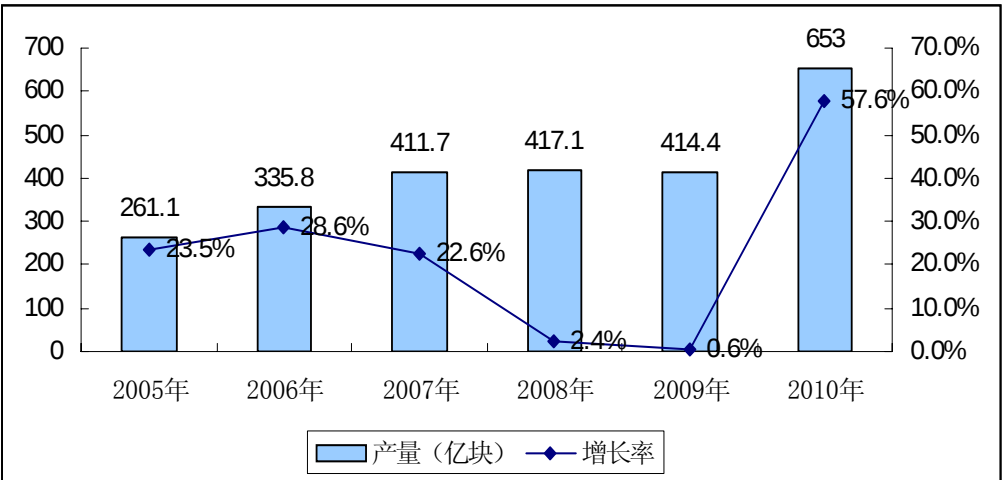
^[4] 数据来源：中国半导体行业协会于 2011 年 3 月在苏州召开的“2011 年市场年会”上协会理事长作的《新形势下中国集成电路产业发展趋势与展望》的报告。

^[5] 本部分内容涉及数据，除特别注明外，均来源于中华人民共和国工业和信息化部网站《电子信息工业“十一五”成就》之“第五部分集成电路产业”，

网址：<http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293877/n13506632/n13519318/13523970.html>

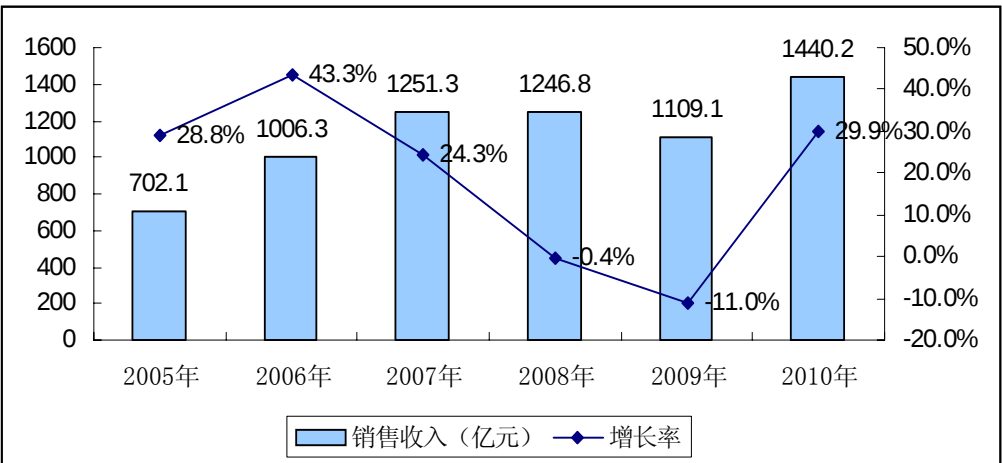
长 29.9%^[6]。

2005-2010 年中国集成电路产量及增长率情况



数据来源：工业和信息化部网站

2005-2010 年中国集成电路产业销售收入及增长率情况

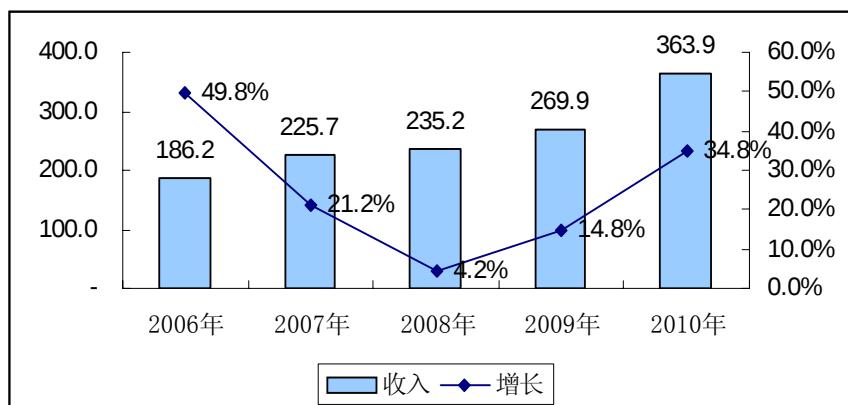


数据来源：工业和信息化部网站

从集成电路产业链来看，集成电路设计业从 2005 年的 124.3 亿元增长到 2010 年的 363.9 亿元，年均复合增长率达 24%，增长最快；芯片制造业从 2005 年的 232.9 亿元增长到 2010 年的 447.1 亿元，年均复合增长率达 14%；封装测试业从 2005 年的 344.9 亿元增长到 2010 年的 629.2 亿元年均复合增长率达 12.8%。

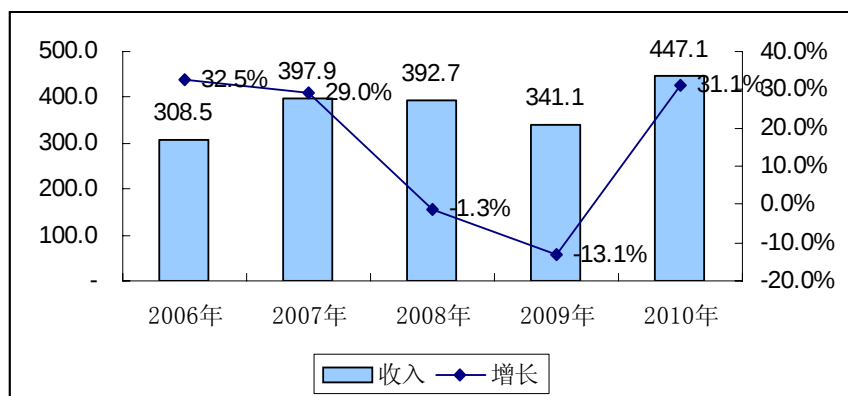
2005-2010 年中国集成电路设计业销售收入及增长

^[6] 2010 年数据来源于中国电子报 20110412 期第 2 版：《全国集成电路行业工作会议特刊》之工业和信息化部电子信息司司长肖华作的《构建芯片与整机大产业链 做大做强集成电路产业》的报告，网址：<http://epaper.cena.com.cn/shtml/zgddb/20110412/33200.shtml>。



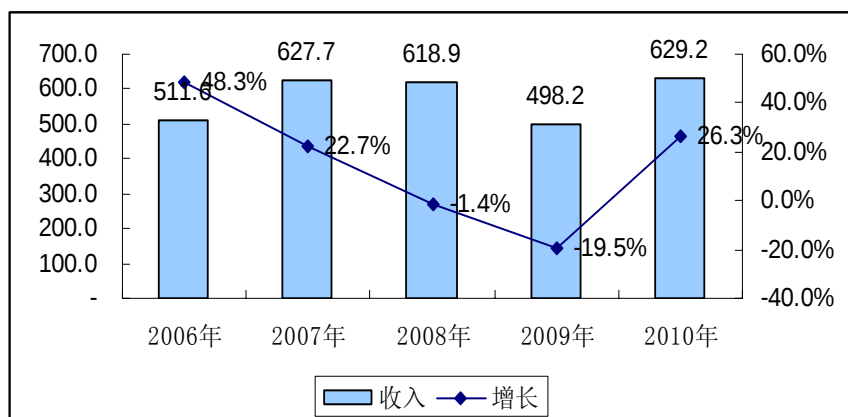
数据来源：工业和信息化部网站

2005-2010 年中国集成电路芯片制造业销售收入及增长



数据来源：工业和信息化部网站

2005-2010 年中国集成电路封装测试业销售收入及增长



数据来源：工业和信息化部网站

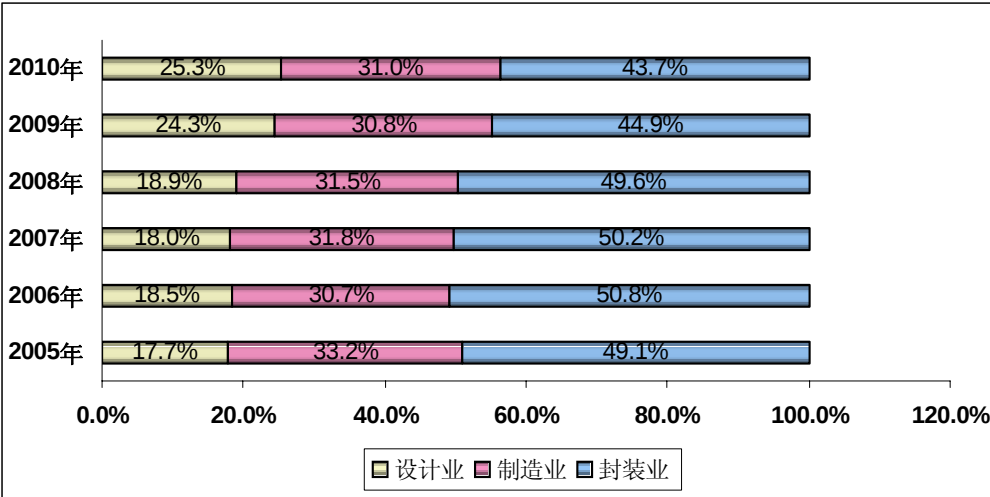
②产业结构

I、产业链结构

产业链结构上，呈现设计业占比逐年上升、封装测试业占比稳步下降、产业

结构进一步优化的整体趋势。2005 年，设计业、芯片制造业、封装测试业三业比重为 17.7%、33.2%、49.1%，发展到 2010 年三业比重为 25.3%、31.0%、43.7%。我国集成电路产业形成了设计、芯片制造和封装测试三业并举、较为协调的格局。半导体设备和材料的研发水平和生产能力不断增强，有利于支撑力集成电路产业的发展。

2005-2010 年中国集成电路各产业链收入占比情况



数据来源：工业和信息化部网站

II、区域结构

目前我国集成电路产业上游的设备与材料业也取得明显进展，形成了一定产业规模。产业集聚效应更加明显，长江三角洲、京津环渤海和泛珠江三角洲 3 个集聚区继续蓬勃发展。从国内集成电路产业集中分布的几大区域的生产情况来看，根据国家统计局的统计，作为国内封装测试企业最为集中的长江三角洲地区，其 2005-2010 年集成电路产量占据全国产量的 56.24%-62.93%。

III、厂商结构

根据赛迪顾问《2009-2010 年中国集成电路产业发展研究年度报告》，2009 年国内集成电路企业排名前 50 名中，IC 设计企业达 18 家，芯片制造企业 11 家，封装测试企业 21 家，反映出 IC 设计业在国内集成电路产业中的地位正迅速上升。其中发行人 2009 年销售收入在 IC 设计企业中排名第三。

③进出口情况

在国内快速发展的电子信息产业的带动下，我国集成电路市场规模从 2005 年的 3,800 亿元，扩大到 2009 年的 5,676.0 亿元，年均增速达 10.6%，已约占全

球市场的三分之一，成为全球最大的集成电路市场。广阔的国内市场需求不仅是我国集成电路产业快速发展的直接驱动力，也对海内外半导体企业产生巨大的吸引力。

集成电路已成为我国第一大宗进口产品。由于国内产业的供给能力不足，我国每年从国外进口大量集成电路产品。2010 年国内集成电路进出口均出现大幅增长，进口额已达 1,569.9 亿美元，进口同比增长 30.9%；出口额 292.5 亿美元，出口同比增长 25.5%。同时，进出口贸易逆差持续增大，逆差规模达到 1,277.4 亿美元。

2008 至 2011 年 1-2 月份集成电路行业进口总体情况

单位：亿块、亿美元

年份	进口量	同比增长	进口额	同比增长
2008 年	1,353.8	9.8%	1,292.6	1.2%
2009 年	1,462.3	8.1%	1,199	-7.2%
2010 年	2,009.6	37.4%	1,569.9	30.9%
2011 年 1-2 月	311.3	23.7%	236.5	18.2%

数据来源：中国海关

2008 至 2011 年 1-2 月份集成电路行业出口总体情况

单位：亿块、亿美元

年份	出口量	同比增长	出口额	同比增长
2008 年	484.8	19.1%	243.2	3.3%
2009 年	566.1	16.8%	233	-4.2%
2010 年	831.5	46.9%	292.5	25.5%
2011 年 1-2 月	130.2	22.3%	45.3	10.6%

数据来源：中国海关

④未来市场预测

I、销售收入预测

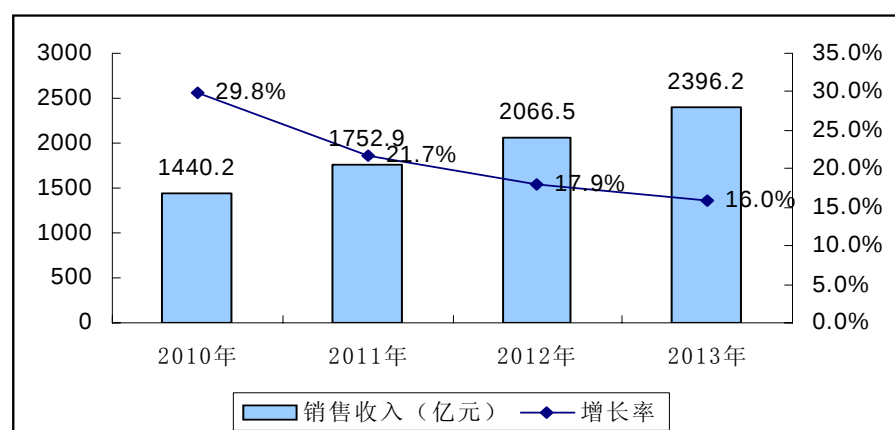
2010 年我国集成电路产业销售收入达到 1,440.15 亿元，同比大幅增长 29.9%。2010 年出现强劲反弹，既得益于全球经济回暖的大环境，也得益于平板电脑、智能手机、平板电视等产品热销的拉动。

随着未来国内外市场的进一步回暖，在国家大力发展战略性新兴产业的大背景下，3G 移动通信、物联网、新型显示、半导体照明、汽车电子等新兴领域正迅速发展成熟。其中孕育的巨大市场机遇将成为“十二五”我国 IC 产业进一步

快速发展的强大动力。我国集成电路产业将步入一波新的增长周期。

根据工信部《2010 年电子信息产业统计公报》预计，2011 年我国的电子信息制造业增加值增长约 15%，这将对我国 IC 产业起到推动作用。我国 IC 产业由于受到新兴消费电子产品市场的强劲带动，战略性新兴产业的拉动，以及英特尔大连工厂、上海华力的投产，中芯国际的扩厂等因素，2011 年我国集成电路产业销售额增幅预计将超过 20%。

2011-2013 年中国集成电路销售收入及增长率预测^[7]



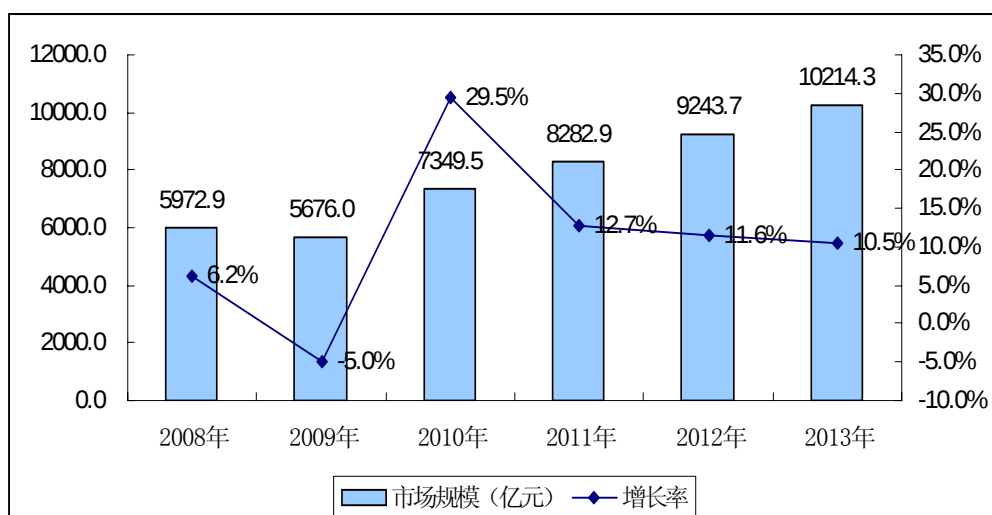
数据来源：中国半导体行业协会

II、设计企业市场规模预测

日前中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长魏少军就我国集成电路设计业 10 年成就、产业特征、发展策略以及“十二五”规划及目标等热点话题，接受了《中国电子报》记者的专访。在提及中国集成电路设计业“十二五”发展目标时，魏少军认为，从产业规模来看，未来我国集成电路设计企业规模将有望比 2010 年再翻一番，达到 1,000 亿元左右，这需要保持每年 15% 的增长率。

2011-2013 年中国集成电路市场规模及增长率预测

^[7]数据来源：中国电子报 20110308 期第 8 版：集成电路之“IC 业步入新增长期”，网址：<http://epaper.cena.com.cn/shtml/zgdzb/20110308/32739.shtml>。



数据来源：中国电子报^[8]

4、行业竞争状况^[9]

(1) 上游行业垄断程度较高

集成电路行业上游行业主要为硅材料行业和集成电路设备制造业。

对于上游材料行业，全球 8 英寸和 12 英寸硅片主要由少数几家硅材料生产商生产，这些大公司具有很高的市场占有率和很强的技术优势。目前国内企业所需的 8 英寸和 12 英寸等大尺寸硅片、光刻胶、特种气体、掩模板等关键材料等基本依赖进口。

集成电路制造设备主要包括光刻机、刻蚀机、离子注入机、CVD 设备、清洗机、晶圆抛光机、封装设备以及检测设备等。高端设备往往只有国外几家制造商有能力生产，国内设备仍停留在比较低端、分离单台产品阶段，仅有少数高端装备进入生产线试用，生产线上的系统成套设备、前工序核心设备及测试设备几乎全部依赖进口。

整体来看，我国集成电路呈现产业链不完善，专用设备、仪器和材料发展滞后等较为不利的竞争格局。

(2) 我国集成电路总体产业规模较小、企业规模偏小

2010 年我国集成电路产业销售收入 1,440.2 亿元，仅占全球市场的 8.6%。我国是全球最大的集成电路市场，但自行设计生产的产品只能满足市场需求的 1/5，

^[8] 中国电子报 20110412 期第 3 版：全国集成电路行业工作会议特刊之“IC 设计业“十二五”有望达到千亿元”，网址：<http://epaper.cena.com.cn/shtml/zgdzb/20110412/33203.shtml>。

^[9] 本部分内容涉及数据，除特别注明外，均来源于中国电子报 20110412 期第 2 版：《全国集成电路行业工作会议特刊》之工信部电子信息司司长肖华作的《构建芯片与整机大产业链 做大做强集成电路产业》的报告。网址：<http://epaper.cena.com.cn/shtml/zgdzb/20110412/33200.shtml>。

CPU、存储器等通用芯片主要依靠进口，国内通信、网络、消费电子等产品中的高档芯片也基本依靠进口。集成电路已连续 7 年成为最大宗的进口商品，2010 年进口额高达 1,569.9 亿美元。

我国集成电路企业以中小型企业为主，最大的芯片制造企业年销售收入 100 多亿元，仅为全球排名第一的制造企业同年销售收入的 1/7；最大的设计企业销售收入仅为美国高通公司的 1/10。企业力量分散，国内 500 多家设计企业总规模不及高通公司收入的一半。

（3）行业内竞争将加剧

集成电路行业规模经济特征明显，而我国集成电路企业普遍产能偏低、规模偏小。因此，国内众多集成电路生产企业在努力提高技术水平的同时，纷纷制定产能扩张计划，规划新建生产线，以提高产能，扩大生产规模。

在金融危机冲击下，全球产业资源进行了新一轮重组，产业集中度更高，无论主流产品市场，还是代工市场，竞争激烈程度进一步提高，产业发展对资金、技术的要求也越来越高。英特尔公司投资 70 亿美元研发 32 纳米工艺，Global Foundry 以 18 亿美元收购新加坡特许半导体，德州仪器 65 亿美元收购美国国家半导体，跨国公司加大了全球资源整合力度。对于资金、技术、人才、销售渠道等资源积累不足的国内企业，面临的挑战更加严峻。

5、集成电路行业替代产品分析

集成电路经过约 50 年的发展，目前绝大多数采用硅单晶衬底制造（少数特殊应用场合采用砷化镓衬底制造）。集成电路中所采用的各种器件的理论已非常成熟，技术加工手段也已非常完善，制造成本也已降低到较低的水平。

根据发行人所掌握的资料及对未来的预测，未来十年内，普通集成电路制造工艺可达到加工线宽在 10nm（纳米）左右（基本上已达到器件物理的理论极限）；未来 20-30 年内，将不会出现在性能、成本上有竞争力的现有集成电路的替代品。

6、影响因素

（1）有利因素

①良好的产业政策

作为电子信息产业的核心，集成电路产业是国家科技发展实力的表现，也是发达国家实现经济增长的重要推动力之一。历年来，我国政府制定了多项产业政

策和相关优惠措施，以促进国内集成电路产业的发展。

②日益增长的市场需求

集成电路作为现代电子整机产品中十分重要的“零部件”，广泛应用于计算机、工业控制设备、家用电器等领域，广泛的应用领域为集成电路产业带来了巨大的市场。经受住 2008 年以来金融危机的冲击后，终端产品市场需求正日益扩大。下游应用领域市场需求的恢复和增长，有利于集成电路行业的快速发展。

③技术替代方面

目前生产的绝大部分的电子整机产品均具有广阔的成长空间。现有硅基集成电路的器件原理和线路结构预计在 30 年内尚不会被其它全新结构和原理的、具有成本优势的产品所替代，因此未来集成电路的成长空间巨大。

（2）不利因素

①国际化竞争日趋激烈

国际大型集成电路跨国企业自 20 世纪 90 年代开始陆续进入中国市场，并以其富有竞争力的人才优势、先进的技术优势、雄厚的资本和灵活的经营方式，在国内集成电路市场占据一定的市场地位。产业国际化趋势日益明显，国内集成电路企业将面临更为严峻的挑战。

②技术积累薄弱

作为信息产业的核心，集成电路行业属于技术密集、资金密集型的行业，行业的进入需要较高的资金投入和拥有较强的核心技术研发能力。我国集成电路产业目前仍缺乏创新能力。技术积累薄弱，技术研发投入意识不够强烈，限制了国内行业的自身发展。

③人才需求缺口较大

集成电路产业具有人才密集的特征。作为快速发展竞争激烈的集成电路行业，尤其重要的是需要一支高素质的经营管理团队和富有技术创新理念的研发队伍。目前，我国集成电路行业人才数量不足和人才质量不高已成为制约国内集成电路产业健康、快速发展的重要瓶颈。

（二）LED 行业

1、行业基本情况及整体发展趋势

（1）基本情况

LED (Light Emitting Diode), 即发光二极管, 属于一种化合物半导体器件, 是目前固态照明技术发展路线上的主要器件, 具有发光效率高、环保、寿命长、体积小等优点。LED 作为新一代光源的最佳选择, 受到各国政府的大力扶植。

LED 产业链内部可分为上、中、下游, 分别为衬底、外延片生长→芯片制备→封装与应用。

(2) 整体发展趋势

我国 LED 的发展, 经历了四个发展阶段: 进口器件销售——进口芯片封装 (1998 年前 100%进口) ——进口外延片制管、封装——自主生产外延片。

自 1999 年起, 中国 LED 芯片企业进入快速发展阶段。受金融危机的影响, 虽然 2008 年中国 LED 市场发展遭遇到一定的阻碍, 其市场增长率较 2007 年出现一定幅度的下滑, 但由于 LED 具有绿色、环保、节能等多方面的优势, 符合国家节能减排的发展方针, 未来发展趋势仍旧向好。此外, LED 在大尺寸背光源、景观照明、汽车车灯、低温照明等新兴应用市场中的快速发展, 将逐步成为推动 LED 市场增长的又一有利因素。

2、行业监管体制

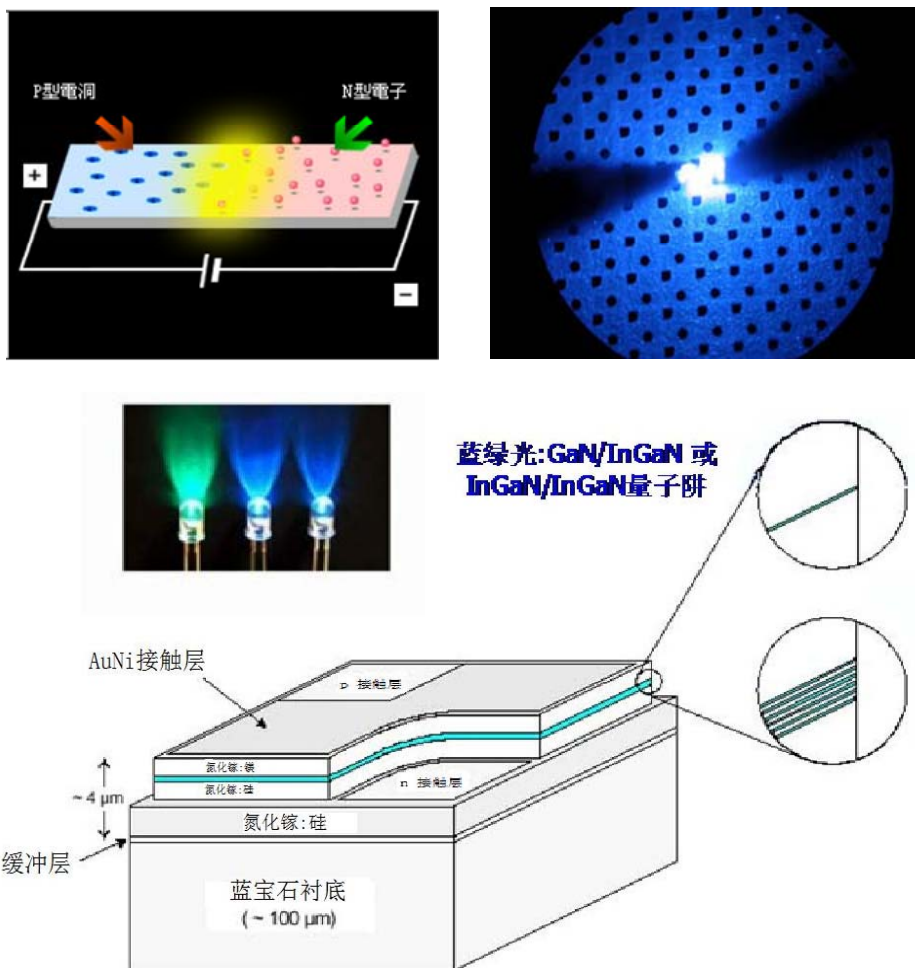
与集成电路行业相同, 我国 LED 行业的主管部门为工业和信息化部, 行业协会为中国光学光电子行业协会 (COEMA)。

3、LED 发光技术及特点

(1) LED 发光原理

发光二极管 (LED) 是一种可以将电能转化为光能的电子器件, 主要由 PN 结芯片、电极和光学系统组成。其发光过程包括三部分: 正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。其发光原理为: LED 晶片由两部分组成, 一部分为 P 型半导体, 在它里面空穴占主导地位; 另一端为 N 型半导体, 在这边主要是电子。当这两种半导体连接起来的时候, 它们之间就形成一个“P-N 结”。电流通过导线作用于该晶片时, 电子就会被推向 P 区, 在 P 区里电子跟空穴复合, 电子和空穴消失的同时产生光子。电子和空穴之间的能量 (带隙) 越大, 产生的光子的能量就越高。光子的能量与光的颜色对应, 在可见光的频谱范围内, 蓝色光、紫色光携带的能量最多, 桔色光、红色光携带的能量最少。由于不同的材料具有不同的带隙, 从而能够发出不同颜色的光。

图示: LED 发光原理和蓝光 LED 芯片



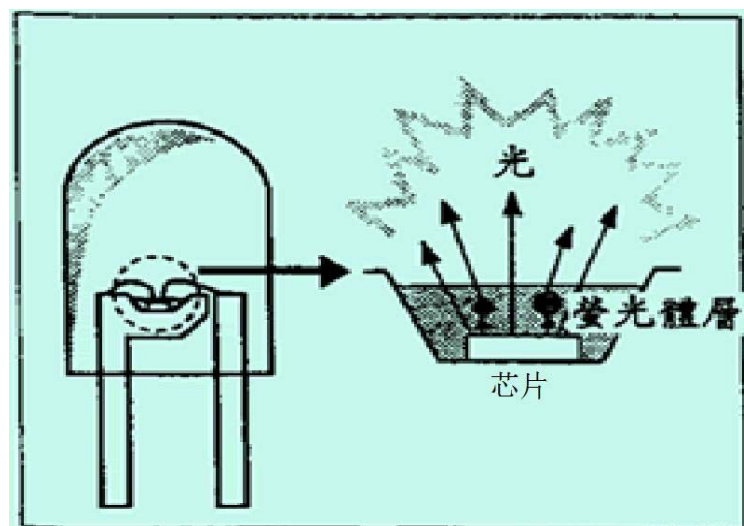
在不同颜色的 LED 产品中，白光 LED 的发光原理较为特殊，目前量产结构的 LED 单芯片只能发出波长范围很窄的单色光，而不能直接发出白光。但有三种原理可实现白光 LED：

①蓝色 LED 芯片和可被蓝光有效激发的发黄光的荧光粉有机结合，组成白光 LED。一部分蓝光被荧光粉吸收，激发荧光粉发射黄光。发射的黄光和剩余的蓝光混合，调控它们的强度比即可得到各种色温的白光；

②将红、绿、蓝三基色 LED 组成一个像素（Pixel）也可得到白光；

③像三基色节能灯那样，发紫外光 LED 芯片和可被紫外光有效激发而发射红、绿、蓝三基色荧光体有机结合组成白光 LED。

目前大量采用的为第一种方案，如下图所示：



荧光体可选用高效的无机荧光体、或有机荧光体、或两者结合。当前的主导方案为蓝色 InGaN LED 芯片和荧光粉的有机结合，实现发白光 LED；其中荧光粉为可被蓝光有效激发的、发黄光的铈能够激活的稀土石榴石荧光粉。该主导方案已在国内外实现产业化。

(2) LED 分类

不同的 LED 技术应用于不同的产品。从大类上来看，按照发光波长可以分为不可见光（850~1550nm）和可见光（450~780nm）两类。可见光中，按发光强度可分为普通亮度 LED、高亮度 LED 和超高亮度 LED，其中发光强度小于 10mcd 为普通亮度，10mcd~100mcd 的为高亮度，达到或超过 100mcd 的称为超高亮度。目前发展的重点是高亮度 LED。

LED 分类、材料构成及其应用领域

LED 分类		材料	应用
可见光 LED (450~780nm)	一般亮度 LED ($<10\text{mcd}$)	GaP、GaAsP、AlGaAs	3G 家电 消费电子
	高亮度 LED ($10\text{mcd}\sim100\text{mcd}$)	AlGaInP (红、橙、黄)	户外全彩看板
		InGaN (蓝、绿)	交通信号灯
			背光源
		白光 LED	车用照明
			背光源 照明
不可见光 LED (850~1550nm)	超高亮度 LED ($\geq 100\text{mcd}$)	白光 LED	照明
	短波长红外光 (850~950nm)	GaAs、AlGaAs	IRDA 模组 遥控器
	长波长红外光	AlGaAs	光通讯光源

	(1300~1550mm)		
--	---------------	--	--

资料来源：东方证券研究所

(3) LED 发光技术的优势

作为一种出现时间最晚的照明技术，LED 的优点不仅体现在发光质量方面，在生产、制造、易用性方面均大大超越白炽灯、荧光灯等传统光源，具有发光效率高、寿命长、电压低、安全性高、环保、牢固和耐震动冲击等优势。同时还具有体积小、重量轻、响应时间更短、色彩丰富可调等特点。

几种照明方式效能对比

品名	寿命 (H)	光效 (lm/w)	起动 特性	频闪	电磁 干扰	环保	抗震 性	易损性
白炽灯	1000	15	快	严重	无	-	差	玻璃材质 易损坏
荧光灯 (T8)	5000	50	慢	重	大	汞污染	差	玻璃材质 易损坏
节能灯 (紧缩型)	6000	80	慢	轻	大	汞污染	差	玻璃材质 易损坏
LED	10000	150	极快	无	小	绿色	好	全固体不 易损坏

资料来源：东方证券研究所

LED 的内在特征决定了其成为代替传统照明的最理想光源。因此，自从 20 世纪 90 年代高亮度蓝光 LED 芯片的基础技术取得突破后，LED 已得到了长足的发展和应用。

(4) LED 发光技术的应用领域

早期 LED 芯片的发光效率很低，且色谱不全（没有蓝光器件）。因此，LED 最初仅用于仪表仪器的状态指示性显示。随着技术的进步，LED 的发光效率得到提升，并在 20 世纪 90 年代初由日本的日亚化学公司发明了高亮度的蓝光 LED 芯片技术，实现了全色谱的 LED 显示，LED 的应用面和量迅速扩大，扩展到交通信号灯，再到景观照明、车用照明和手机键盘及液晶屏的背光源照明。目前，LED 主要应用于以下领域：

- 大、中、小 LED 显示屏：室内外广告牌、体育场记分牌、信息显示屏等。
- 交通信号灯：全国各大、中城市的市内交通信号灯、高速公路、铁路和机场信号灯。
- 光色照明：室外景观照明和室内装饰照明。

- 专用普通照明：便携式照明（手电筒、头灯）、低照度照明（廊灯、门牌灯、庭用灯）、阅读照明（飞机、火车、汽车的阅读灯）、显微镜灯、照相机闪光灯、台灯、路灯。
- 安全照明：矿灯、防爆灯、应急灯、安全指标灯。
- 特种照明：军用照明灯（无红外辐射）、医用手术灯（无热辐射）、医用治疗灯、农作物和花卉专用照明灯。
- 液晶屏（LCD）的背光源：小尺寸的手机液晶屏已 100%使用 LED 作为背光源，笔记本电脑、桌面电脑的液晶显示器、平板液晶电视等产品也在开始向 LED 背光源过渡（目前大部分仍采用 CCFL-冷阴极荧光管）。

由于 LED 芯片的细微可控性，LED 在小尺寸照明上具有明显的成本和技术优势。随着 LED 技术的不断进步，发光效率不断提高，大尺寸 LED 圆片价格逐步下降，未来 LED 将在笔记本液晶面板背光、更大尺寸的液晶显示器以及普通照明等领域得到全面应用，LED 照明技术发展空间更加广阔。

4、行业市场状况

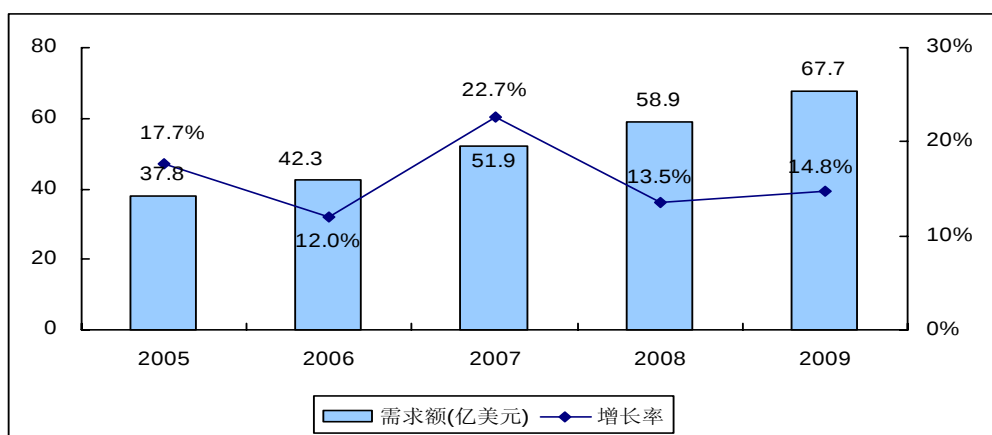
（1）全球 LED 市场

①产业规模

尽管金融危机给行业的发展带来了一定的影响，但在大尺寸背光源渗透率快速提升、照明产品需求逐步扩大等新兴应用领域快速发展的带动下，2009 年全球 LED 市场仍保持了两位数的增长，成为半导体行业中的发展亮点。2009 年，全球 LED 市场规模为 67.7 亿美元，较 2008 年增长 14.8%^[10]。根据市场研究机构拓璞产业研究所的研究，受惠于液晶平板电视 LED 背光应用需求大幅度成长，2010 年全球 LED 产值高达 99.83 亿美元，年增长率为 42%。

2005-2009 年全球 LED 市场规模

^[10]赛迪顾问《2009-2010 年中国 LED 市场研究年度报告》。

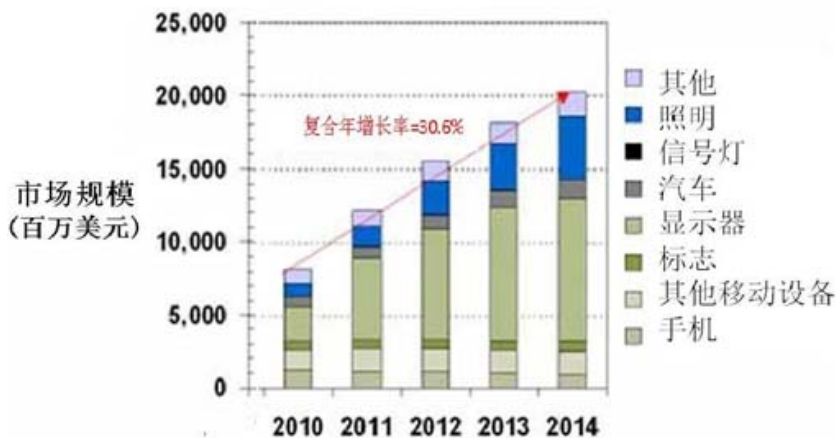


数据来源：赛迪顾问 2010，02

②产业预测

未来高亮度 LED 在各应用领域快速发展的带动下，将继续保持快速增长。2010 年 2 月 23 日，美国市场调研公司 Strategies Unlimited 公司光电子事业部负责人 Bob Steele 在“光战略（Strategies in Light）”会议上发表演讲，并对高亮度（HB: high-brightness）LED 元器件市场做出了预测。

高亮度 LED 市场预测（2010-2014）



Strategies Unlimited:2010年-2014年高亮度LED市场预测

该预测主要针对封装的 LED 市场，Bob Steele 预测：到 2014 年，LED 市场的复合年均增长率（CAGR）将增至 30.6%，达到 202 亿美元。未来五年，背光领域市场前景可观，并且越来越多的普通照明领域在整个预测中表现出强劲的增长趋势。

市场研究机构拓璞产业研究所也认为，在手机中小尺寸背光、TV 中大尺寸背光、普通照明应用等 3 大应用需求驱动下，预估 2011 年全球 LED 产业年成长

率将维持 42%高水准，年产值上冲 142.17 亿美元。

（2）我国 LED 产业市场状况

①产业规模

近年来，我国先后启动了绿色照明工程、半导体照明工程，在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863 计划新材料领域中先后支持半导体照明技术的研发和产业化项目，具备了较好的研发基础，初步形成了完整的产业链。最近三年，我国 LED 产业整体发展趋势良好，产业规模逐年增加。

2008-2010 年我国半导体照明产业产值情况表^[11]

单位：亿元

名称	2008 年	2009 年		2010 年	
	产值	产值	增长	产值	增长
芯片产值	19	23	21%	50	117%
封装产值	185	204	10%	250	23%
应用产品产值	450	600	33%	900	50%
总产值	654	827	26%	1,200	45%

数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟

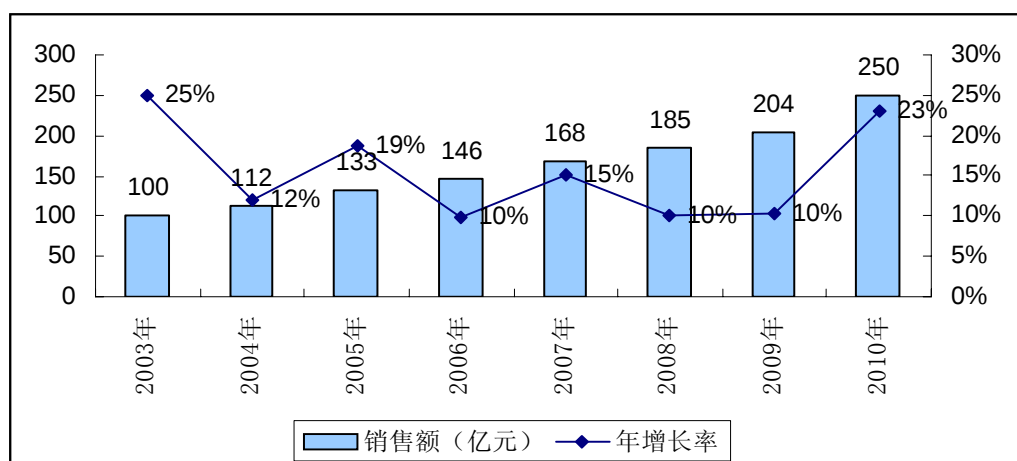
2010 年度国内 LED 产量、芯片产量及芯片国产率

种类	LED 产量（亿只）	芯片产量（亿只）	芯片国产率（%）
	（1）	（2）	（3）=（2）/（1）
GaN LED	600	390	65%
四元 LED	475	270	57%
普亮 LED	260	170	65%
合计	1,335	830	62%

数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟

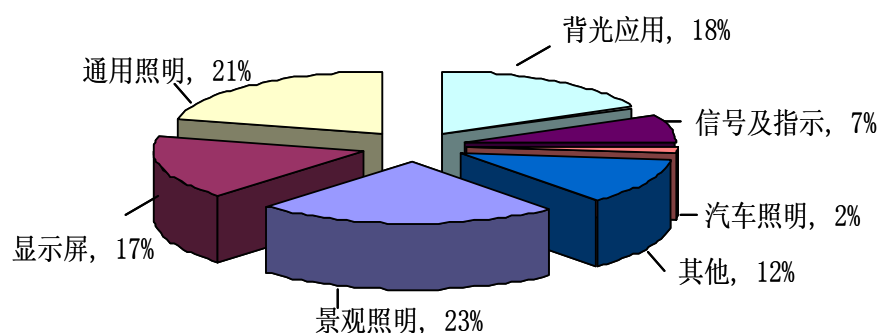
2003-2010 年我国 LED 封装市场规模及增长率变化

^[11]数据来源：中国半导体照明网之《联盟发布 2010 年中国半导体照明产业数据》，网址：<http://www.china-led.net/info/2011127/2011127180144.shtml> 和《联盟发布 2009 年中国半导体照明产业数据》，网址：<http://www.china-led.net/info/201022/201022164415.shtml>。



数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟

2010 年我国半导体照明应用领域分布



数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟

2010 年是我国半导体照明产业快速发展的一年，也是产业规模迅速扩大和产业环境明显改善的一年。2010 年，我国半导体照明完全摆脱了金融危机的影响，在国内产业政策和国际市场需求的拉动下，我国成为全球半导体照明产业发展最快的区域，其中外延芯片和照明应用产品的发展最为突出。我国半导体照明开始进入一个快速发展的周期，预计未来 3-5 年内，我国半导体照明产业规模和产业格局将发生较大的改变，在国际半导体照明产业体系的地位和影响也将大大增强。

②市场发展预测

2010 年，我国 LED 产业取得了突飞猛进的发展。伴随着国家产业政策的逐步明朗、国家扶持力度的逐步加大，未来将大大促进我国 LED 照明产业的健康有序发展。

2010 年 4 月，国家半导体照明工程研发及产业联盟预测：I、未来几年，国内芯片市场平均增长率将保持 30%左右，2010 年市场将达到 35 亿元，2012

年有望达到 60 亿元右。2010 年芯片产值已达 50 亿元，预计未来国内芯片产能和企业经营状况将处于一个快速提升阶段。II、封装器件领域，预计 2012 年前，我国 LED 封装市场的年均增长率将保持在 25% 左右，2012 年有望达到 400 亿元左右。III、预计 2010 年到 2015 年，半导体照明应用年均复合增长率预计可达到 40%，2015 年产业规模达到 5000 亿元以上。白光照明应用，将以户外照明和公共区域照明为突破口，逐步形成市场规模，成为半导体照明产业发展的主要推动力。

预计 2011-2012 年，半导体照明仍将保持较高的发展速度，未来两年将成为中国半导体照明产业结构和格局调整完善的关键时期。整个行业将进入一个机遇与挑战并存的全新阶段，巨大的产业发展机遇将伴随着更为激烈的市场竞争和格局调整，行业洗牌、企业整合将在所难免。

5、行业竞争状况

(1) 全球 LED 产业竞争格局

目前，全球 LED 产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的产业分布与竞争格局。美国科锐（Cree）、日亚化学（Nichia）、丰田合成（Toyoda Gosei）以及 Philips Lumileds 和欧司朗（Osram）五大厂商在上游拥有强大的技术实力和产能，基本垄断了高端产品市场，五家公司合计市场占有率超过 50%。而这五家公司之间也通过交叉授权来进行技术合作与共享，从而保持技术与应用的领先性。

(2) 我国 LED 产业竞争格局

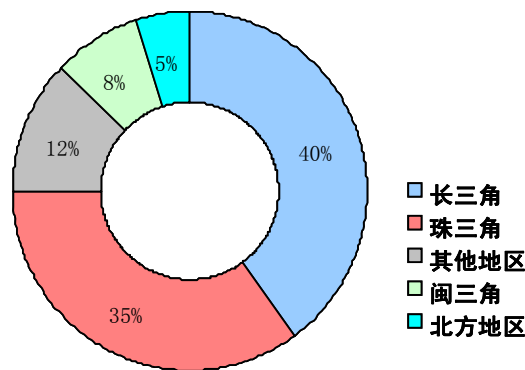
①整体竞争格局

我国大陆地区 LED 产业起步较晚，在经历了器件、芯片封装和外延片进口之后，目前已基本实现了自主生产外延片和芯片。自 1999 年起，大陆地区 LED 芯片企业进入快速发展阶段，并加大了对高亮度四元系芯片和 GaN 芯片的投资。随着三安光电、士兰明芯、武汉华灿、德豪润达等一批高亮度芯片生产企业产能的释放，国内高亮度芯片产量保持了高速增长。

②地域竞争格局

目前，我国已初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域。

大陆地区 LED 产业主要区域分布图



来源：国家半导体照明研发及产业联盟（CSA）

从地域角度看，位于沿海、沿江地区的企业产业化程度较高，在产品的生产和销售方面具有竞争优势；环渤海地区的 LED 企业依托众多高校和科研机构，具有技术研发的优势；此外，长三角、珠三角等地具有国家产业投资扶持的优势，竞争力较强。

总体而言，珠三角和长三角是国内 LED 产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国 80% 左右的相关企业，也是国内 LED 产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。与国际应用市场便捷的联系为 LED 产业的发展创造了良好的服务及市场环境，产业集群效应正在逐步显现，与 LED 有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户。

③产业链竞争格局

在每一区域内，目前已基本形成了包括 LED 外延片生产、LED 芯片制造、芯片封装以及 LED 产品应用在内的较为完整的产业链。但由于我国大型 LED 企业较少、下游技术壁垒相对较低，因而整体产能集中度不高，下游封装和应用领域企业数量较多，外延片和芯片生产企业较为薄弱。

总体而言，目前我国外延片、芯片生产企业数量较少、产值较低。从行业发展趋势来看，产业链竞争格局体现在上游外延片及芯片生产的竞争。直接生产外延片及芯片，并从产业链的中上游向下游封装和应用发展，有利于企业降低成本、提高行业地位、增强品牌效应。

8、影响因素

（1）有利因素

①产业政策支持，发展前景广阔

LED 具备节能、减排和环保的独特优势，国家连续出台鼓励产业发展政策。2009 年，国家先后出台《电子信息产业调整和振兴规划》和《半导体照明节能产业发展意见》等政策，在落实扩大内需措施中明确提出，支持 LED 节能照明产品的推广，研究出台半导体照明推广应用的鼓励政策。同时提出“到 2015 年，半导体照明节能产业产值年均增长率在 30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到 20%左右，液晶背光源达到 50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到 70%以上”等目标。在国家产业政策的支持下，我国 LED 产业发展面临前所未有的政策机遇、超乎预期的技术升级空间和巨大的市场潜力，产业发展前景广阔。

②技术发展迅速，差距逐步缩小

尽管目前国内 LED 产业基础比较薄弱，工艺水平较低，但我国大陆地区一些企业通过聘请海外技术人员，在技术上不断取得突破，许多企业已经取得自主知识产权。我国大陆地区优质企业的技术水平已经与我国台湾地区大厂的技术水平相差不大，与国际大厂的整体差距也在不断缩小。

③产业集群效应初步形成

我国 LED 产业正进入自主创新、实现跨越式发展的重要时期。虽然各企业的竞争优势不尽相同，但整体来看，产业集群效应已初步形成。目前已初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链。

④市场容量巨大

从 LED 产品的应用领域来看，现阶段应用市场主要集中在建筑照明、户内外彩色显示屏、小尺寸液晶背光、城市景观照明以及各种成本不敏感的特种照明（如隧道、汽车尾灯）等。未来几年，户内外彩色显示屏将继续保持其应用领域最大的需求额外，大尺寸的液晶屏 LED 背光源（包括笔记本电脑、液晶平板电视、液晶显示器等）将呈现较快增长。随着 LED 大规模进入普通照明领域，未来市场潜力巨大。

（2）不利因素

①企业规模偏小，上游产品制造基础薄弱

LED 产业链的上游具有技术和资本密集的特点，下游的进入门槛相对较低。

从产业链上看，我国在 LED 衬底、外延、芯片环节比较薄弱，高端产品仍然以国外厂商为主。国内 LED 生产企业普遍存在规模小、技术实力弱、产品档次低的问题。

②核心专利缺乏，限制产业国际化战略发展

我国 LED 技术起步较晚，在 LED 专利方面处于比较被动的局面。国内核心专利缺乏，特别在关系到产业长远发展的蓝光核心专利及白光核心专利缺乏，国内产业的长期发展受到一定限制。随着国内企业的发展壮大，当规模扩大到一定程度，实施“走出去”的发展战略时，专利问题将成为隐患。目前对于国内企业而言，扩大产销规模、提升品牌影响、提高产品质量与技术水平是其首要任务，提高未来取得国际大厂专利授权时的议价能力，或逐步通过研发突破核心专利也是重要议题。

③国际竞争加剧

随着市场的转型，客户更加注重产品品质和维护服务，对产品的要求也日益提高。因此，“粗放型”的市场模式不再满足用户需求。国外一批享有较高知名度的企业已寻机进入中国国内市场，其成熟的产品和多年的经验，已经形成了较强的品牌优势，这对原本就竞争相当激烈的国内 LED 市场将带来较大的冲击。

（三）发行人的竞争优势和面临的挑战

1、发行人的竞争优势

（1）体系优势

集成电路行业的经营模式主要可分为两大类：一类是芯片设计完成后委托专业的芯片制造工厂完成芯片制造，另一类是在自己的芯片工厂完成制造。后一种运行模式一般称为 IDM（Integrated Design & Manufacture，设计与制造一体）模式。

发行人最典型的优势是采用 IDM 的经营模式。公司自集成电路芯片生产线建线之后，一直坚持采用 IDM 的经营模式，基本上不对外承接芯片代工业务，已成为中国国内少有的芯片设计与制造一体化的企业之一。公司近年来持续进行产业结构调整 and 战略规划布局，坚持进行对中高端 SoC 芯片、以高压、高功率、高频工艺开发的模拟集成电路、以特殊工艺开发的半导体分立器件以及高亮度 LED 蓝绿光芯片等主要产品的研发，推出的许多基于 BCD 工艺的电源管理产品

已达到国内领先、国际先进水平。

经过多年的探索和积累，IDM 模式已成为公司在半导体领域具有的核心竞争力之一，并形成了项目进度控制、与市场接口、各技术小组间的配合等项目管理、产品设计过程中的测试、验证环节控制等完善的管理体系。

(2) 技术优势

发行人长期专注于半导体集成电路的设计研发、集成电路、分立器件芯片制造、LED 的研发与制造领域。截至 2011 年 3 月 31 日，发行人拥有技术研发队伍 354 人，取得发明专利 11 项，实用新型专利 27 项，外观设计专利 2 项，多项技术达到国内领先、国际先进水平。2011 年 3 月，国家科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室批复，公司申报的“高速低功耗 600v 以上多芯片高压模块”项目已获立项批准。

目前发行人已进行研发并拥有核心技术积累的主要领域包括：

①数字音视频技术：士兰微在数字音视频技术领域已掌握了多项核心技术：I、光盘伺服技术，该技术为国内独家掌握，可批量生产 CD/DVD 伺服芯片；II、H.264 数字视频编码技术，公司已开发成功基于 H.264 技术的多通道数字视频监控压缩芯片并推向客户；III、高清数字视频 SoC 芯片的完整工艺流程，并已实施高清视频解码芯片的开发，该芯片将会用于高清媒体播放器、高清蓝光光盘播放器等领域。

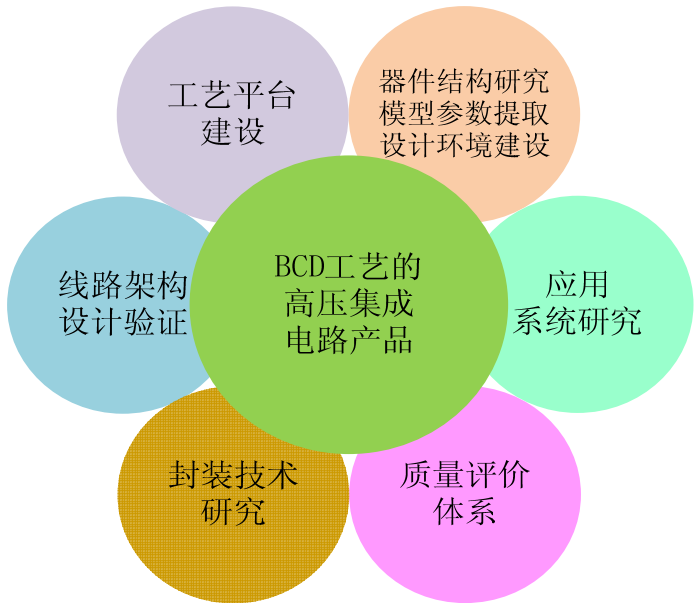
②高压高功率的电源管理及功率驱动产品平台：高压高功率的电源管理电路和电机驱动电路是公司目前重点发展的技术和产品之一。发行人经过多年的努力，已经掌握了此类电路的设计原理、线路架构和测试评价方法，并已经成为中国大陆第一家推出满足“能源之星”Level 5 标准、待机功耗小于 30mW 的原边采样 AC-DC 变换电路的企业，该电路可广泛应用于新一代的手机充电器、家用电气电源系统中；此外，士兰微也率先在国内推出了满足能源之星 EPS2.0 标准的待机功耗小于 150mW 的 AC-DC 变换电路，可广泛应用于机顶盒、DVD 播放机的电源系统中。

③特种分立器件技术：基于士兰集成的芯片生产线，公司开发的特种半导体分立器件技术含量较高，较多产品处于国内领先的位置。如平面结构的高压 MOSFET，公司已推出了四代芯片，技术能力基本上已经达到国外同类产品的水

平，生产规模位居国内第一；其它的分立器件如快恢复二极管、高精度的稳压管、ESD 放电保护器件、肖特基二极管、平面结构低压 MOSFET 等，在分立器件封装厂家均占有较高的市场份额。此外，公司的分立器件芯片已被许多国际知名厂商所接受，芯片整体质量也已接近国外产品的先进水平。

④BiCMOS/BCD 工艺平台：基于 IDM 的经营模式，士兰微与士兰集成共同开发出 BiCMOS/高压 BCD 工艺平台，该技术平台在我国大陆地区和台湾地区均具有其先进性。高压集成电路工艺和产品平台的研发活动涉及多方面的技术投入，只有系统地进行多方面的研究工作，才能建立不断进步的高压集成电路研发体系。发行人通过对下图所示六个方面持之以恒的投入，已建立了国内领先水平的高压集成电路工艺平台。

BiCMOS/高压 BCD 工艺平台投入研发结构图



⑤LED 高亮度蓝、绿光芯片以及外延生长技术：士兰明芯依托于完善的研发体系和强大的技术研发能力，已攻克了芯片的 ESD 防护问题、图形化衬底、金属淀积质量、MOCVD 外延参数均匀性等问题，形成了公司的核心技术。发行人自主研发的“高亮度氮化镓基蓝、绿光外延生长技术”、“图形化衬底技术”和“高亮度 ITO 蓝、绿光芯片”、“垂直结构 LED 蓝、绿光芯片”和“LED 芯片衬底剥离技术”等工艺技术，与国际主流技术相吻合，形成了公司的核心技术。

(3) 质量优势

通过持续地工艺研发和改进，公司集成电路、分立器件和 LED 芯片的质量

已达到国际先进水平。户内外大型 LED 彩屏是对 LED 芯片质量、参数要求最高的应用领域之一，更加关注发光亮度、波长的一致性。公司经过多年的发展，高亮度蓝绿光 LED 芯片各项参数指标已具有很高的稳定性、一致性和可靠性，产品质量远高于国内同行，达到世界一流水平。在国庆 60 周年庆典上，国产芯片生产企业中，仅士兰明芯的产品与国际一流厂商日亚化学同时应用，也充分显示了公司产品的高品质性。

（4）品牌优势

公司依靠长期积累的稳定生产工艺及经验丰富的设计、生产队伍，通过技术改造、产品结构调整，不断提升集成电路、分立器件和 LED 的品牌优势。功率器件、LED 芯片等主导产品受到用户的一致好评，部分客户厂商指定采用士兰微和士兰明芯品牌的产品，目前已与国内外多家大型企业建立了良好的合作关系。随着公司 2010 年完成对产品线的调整和布局，不断加大高附加值产品的研发、生产力度以及大力发展功率模块和 LED 器件成品，公司品牌战略将在未来的竞争中将体现出更为强劲的优势。

（5）规模效应优势

公司三大业务在生产体系上具有较强的规模效应优势。公司最初从事集成电路设计、制造业务，随后进入 LED 领域。LED 芯片生产所需的动力保障条件与现代集成电路生产的动力条件完全一致，与公司集成电路的生产具有共用效应。士兰明芯在 LED 芯片生产中需要的超纯水、高纯度的氮气、氢气、氧气等能源，由士兰集成的基础设施供应，并通过管道输送至士兰明芯的芯片车间。依托于公司集成电路健全的生产体系和良好的工艺平台，公司集成电路、分立器件和 LED 芯片的生产具有较强的规模效应优势。

（6）人才优势

公司技术研发坚持自力更生的技术发展路线，培育了“以我为主”的技术发展体系。依靠自身的研发体系，公司已基本掌握了 BCD 工艺、器件和电路设计、高亮度 LED 芯片的核心技术。在多年的发展过程中，士兰明芯积聚了一支优秀的管理和技术团队，主要核心管理、技术人员均为长期从事集成电路、分立器件和高亮度 LED 产品研发、生产、管理业务的优秀人才，在半导体行业的多个领域内拥有深厚的理论与实践经验，具有较强的人才优势。

2、公司面临的挑战

(1) 继续不断改进工艺，提升技术水平

尽管公司经过多年的发展，在 LED 领域已积累了多项国内领先的核心技术，但相比科锐、日亚化学等国际一流厂商，士兰明芯仍存在一定的技术劣势，工艺技术仍需不断改进。

(2) 扩大规模，提高参与国际竞争的水平

虽然公司集成电路、分立器件以及 LED 等主要产品的部分技术领先于国内竞争对手，在经营模式、产品研发、工艺技术和产品性能上达到国际先进水平；但与国际一流竞争对手相比，公司规模仍旧偏小，抵御市场风险的能力相对较弱。

(3) 充分利用资本市场优势多方面筹集资金，确保公司财务安全

目前，发行人集成电路、分立器件以及 LED 的研发、生产正处于发展的重要阶段。融资渠道上主要依靠银行短期借款间接融资。随着发行人产品市场份额进一步扩大，对资金的需求日益增加，缺乏持续的资金支持束缚了公司更快、更好地发展。公司本次发行公司债券，有利于优化公司债务结构，改善公司资金状况，为投资者带来良好回报。

八、前次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2010〕1153 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 6,000 万股。2010 年 9 月 8 日，公司以 20 元/股向 8 家投资者非公开发行 3,000 万股 A 股，募集资金净额为 57,515.00 万元。截至 2011 年 3 月 31 日，公司该次募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
高亮度 LED 芯片生产线扩产	否	49,986.03	21,949.36	是	建设期，尚未达产
补充流动资金	否	7,528.97	7,528.97	是	完成
合计		57,515.00	29,478.33		

1、高亮度 LED 芯片生产线扩产项目

根据公司 2010 年非公开发行股票预案，该项目募集资金的实施方式为通过公司全资子公司士兰明芯实施。该项目总投资 49,986.03 万元，拟用募集资金投入 49,986.03 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，本公司已从募集资金专户转出对士兰明芯公司增资 30,000.00 万元，该增资经天健会计师事务所有限公司审验，并分别于 2010 年 9 月 17 日、2010 年 12 月 17 日出具天健验（2010）263 号、425 号《验资报告》。士兰明芯已累计使用募集资金 21,949.36 万元。该项目建设期 12 个月，目前处于在建状态，所购 MOCVD 设备尚未释放产能。募集资金具体使用情况如下：

（1）募集资金置换士兰明芯以自筹资金先期投入的 2,519.63 万元

2010 年 10 月 16 日，士兰微第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,519.63 万元。2010 年 10 月 16 日，公司会计师天健会计师事务所和公司该次非公开发行股票保荐机构东方证券分别出具了《关于杭州士兰微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2010】4045 号）和《关于杭州士兰微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》。2010 年 10 月 19 日，公司已全部完成募集资金置换工作并在上海证券交易所进行了公告。士兰明芯以自筹资金先期投入募集资金投资项目“高亮度 LED 芯片生产线扩产项目” 2,519.63 万元，均系用于购买设备。

（2）士兰明芯公司从募集资金专户投入募投项目资金为 19,429.73 万元，主要系用于购买设备。

（3）闲置募集资金补充流动资金 5,700 万元

经 2010 年 12 月 14 日公司第四届董事会第十四次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 5,700 万元，使用期限不超过六个月。

2010 年 12 月 13 日，公司保荐机构针对上述事项出具了《关于杭州士兰微电子股份有限公司暂时补充流动资金事项的保荐意见》，认为：“1、士兰微将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到募集资金专用账户，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并对公司资金使用效率的提高产生有益影响；2、本次补充流动资金金额

未超过募集资金净额的 10%；3、本次补充流动资金时间计划未超过 6 个月；4、士兰微上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。士兰微本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》中关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意士兰微使用部分闲置募集资金 5,700 万元用于暂时补充公司流动资金。”。

同时，公司独立董事、监事会也发表了同意意见：“本次公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东的利益最大化。同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《杭州士兰微电子股份有限募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。”。

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司已自募集资金专户转入本公司其他银行账户 5,700 万元。

2、补充流动资金

公司该次非公开发行股票募集资金净额为 57,515.00 万元，其中拟使用募集资金 7,528.97 万元补充流动资金。截止 2011 年 3 月 31 日，募集资金已补充流动资金 7,528.97 万元。

第九节 财务会计信息

本公司聘请天健会计师事务所有限公司对公司最近三年的财务报告进行了审计，并已经分别出具了标准无保留意见的审计报告。

非经特别说明，本募集说明书中引用的财务数据均出自经天健会计师事务所有限公司审计的本公司最近三年的财务报告和未经审计的 2011 年第一季度报告。

投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅本公司最近三年经审计的财务报告和 2011 年第一季度报告的相关内容。

由于本公司的芯片制造和 LED 设计、制造、销售等多项业务依托下属子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在本节中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

以下如不作特别说明，表格数据的单位均为人民币万元。

一、最近三年及一期的财务会计资料

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2011.3.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
资 产				
流动资产：				
货币资金	558,610,277.86	667,684,876.95	213,685,895.93	202,139,838.34
交易性金融资产	534,928.59		6,590.00	372,732.03
应收票据	72,627,923.49	87,137,466.97	66,823,131.75	32,307,526.01
应收账款	308,658,280.64	319,584,765.21	267,439,165.23	193,949,704.68
预付账款	63,952,719.50	82,316,285.51	16,525,278.96	7,760,445.99
应收股利	4,000,000.00	8,000,000.00		
应收利息				
其他应收款	7,793,256.48	8,872,267.67	8,517,203.74	26,427,072.58
存货	372,356,983.08	313,908,992.78	291,537,932.30	309,316,184.62
其中：消耗性生物资产				
待摊费用				

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
待处理财产损益				
流动资产合计	1,388,534,369.64	1,487,504,655.09	864,535,197.91	772,273,504.25
非流动资产：				
可供出售金融资产			12,900,426.00	52,174,812.00
持有至到期投资				
投资性房地产				
长期股权投资	165,494,787.88	167,305,797.65	128,618,467.98	91,643,217.61
长期应收款				
固定资产	705,936,405.32	690,999,083.84	681,752,324.78	749,751,568.01
在建工程	297,307,575.41	134,669,811.10	28,379,226.17	7,465,620.93
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	71,718,093.19	69,866,622.61	62,413,490.41	77,462,417.17
开发支出				
商誉	619,947.54	619,947.54	1,307,447.54	1,307,447.54
长期待摊费用				80,512.04
递延所得税资产	12,820,145.92	13,982,816.70	19,543,554.65	10,842,111.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,253,896,955.26	1,077,444,079.44	934,914,937.53	990,727,706.71
资产总计	2,642,431,324.90	2,564,948,734.53	1,799,450,135.44	1,763,001,210.96
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	499,826,712.58	479,000,000.00	576,179,456.80	614,230,674.00
交易性金融负债				1,629,590.00
应付票据	71,000,000.00	34,000,000.00	93,500,000.00	103,000,000.00
应付账款	245,176,855.87	216,391,479.20	168,011,961.21	142,995,700.40
预收账款	1,128,449.56	2,385,355.59	2,186,637.63	4,501,065.18
应付职工薪酬	25,846,598.20	45,759,685.42	32,559,443.13	18,056,054.80
应交税费	-13,101,641.24	12,459,068.77	7,604,850.38	9,135,638.32
应付利息	1,175,783.17	1,258,542.56	911,908.75	1,361,342.88
应付股利				
其他应付款	5,640,583.76	5,795,829.44	1,608,414.90	21,704,645.02
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00		30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	876,693,341.90	837,049,960.98	882,562,672.80	946,614,710.60
非流动负债：				
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				

长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款	15,957,000.00	15,957,000.00	15,957,000.00	15,957,000.00
预计负债				
递延所得税负债	196,119.99	115,880.70	1,905,708.74	8,275,985.07
其他非流动负债	38,102,974.99	32,263,875.00	30,383,350.00	16,034,100.00
非流动负债合计	63,941,776.33	58,022,437.05	90,931,740.09	82,952,766.42
负 债 合 计	940,635,118.23	895,072,398.03	973,494,412.89	1,029,567,477.02
股东权益：				
股本	434,080,000.00	434,080,000.00	404,080,000.00	404,080,000.00
资本公积	634,836,734.34	645,291,238.07	72,497,018.60	58,401,717.65
减：库存股				
盈余公积	70,079,072.81	70,079,072.81	60,067,644.92	55,205,201.92
一般风险准备				
未分配利润	556,907,760.27	514,791,584.05	279,390,491.03	207,627,870.99
外币报表折算差额	-5,601,634.01	-5,515,326.02	-4,734,619.34	-5,385,780.28
归属于母公司所有者权益合计	1,690,301,933.41	1,658,726,568.91	811,300,535.21	719,929,010.28
少数股东权益	11,494,273.26	11,149,767.59	14,655,187.34	13,504,723.66
股东权益合计	1,701,796,206.67	1,669,876,336.50	825,955,722.55	733,433,733.94
负债和股东权益总计	2,642,431,324.90	2,564,948,734.53	1,799,450,135.44	1,763,001,210.96

2、合并利润表

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
一、营业总收入	324,005,947.54	1,518,826,971.05	959,865,394.73	933,095,777.36
其中：营业收入	324,005,947.54	1,518,826,971.05	959,865,394.73	933,095,777.36
二、营业总成本	288,775,488.53	1,271,506,606.20	964,331,527.67	986,491,711.91
其中：营业成本	223,021,409.71	979,955,006.49	689,887,232.19	708,923,951.36
营业税金及附加	1,025,237.98	10,764,561.49	7,082,485.43	6,666,654.47
销售费用	9,783,189.17	35,491,571.72	23,478,071.59	26,256,452.09
管理费用	45,670,276.09	198,435,369.93	150,124,056.23	164,786,789.53
财务费用（收益以“-”号填列）	7,028,070.70	33,324,851.66	39,990,296.51	54,403,881.94
资产减值损失	2,247,304.88	13,535,244.91	53,769,385.72	25,453,982.52
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	534,928.59		141,667.97	-1,778,424.12
投资收益（损失以“-”号填列）	8,643,493.96	21,109,258.80	63,798,347.21	57,962,122.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,756,997.67	4,788,010.37	959,725.89

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,408,881.56	268,429,623.65	59,473,882.24	2,787,763.79
加：营业外收入	4,374,827.04	28,043,783.84	21,805,663.09	26,453,367.14
减：营业外支出	434,301.01	3,062,763.03	2,558,671.79	3,969,776.17
其中：非流动资产处置损失		433,801.08	176,197.70	331,876.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,349,407.59	293,410,644.46	78,720,873.54	25,271,354.76
减：所得税费用	5,888,725.70	36,756,384.36	3,132,944.72	12,669,268.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,460,681.89	256,654,260.10	75,587,928.82	12,602,086.24
其中：归属于母公司所有者的净利润	42,116,176.22	255,858,649.95	76,625,063.04	13,559,429.24
少数股东损益	344,505.67	795,610.15	-1,037,134.22	-957,343.00
六、每股收益				
（一）基本每股收益		0.62	0.19	0.03
（二）稀释每股收益		0.62	0.19	0.03

3、合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	387,100,721.43	1,582,217,919.52	908,382,721.24	1,070,801,846.56
收到的税费返还	11,051,651.87	26,679,655.05	35,584,902.62	11,720,678.02
收到的其他与经营活动有关的现金	13,766,574.52	75,669,689.49	83,003,036.91	37,800,778.50
经营活动现金流入小计	411,918,947.82	1,684,567,264.06	1,026,970,660.77	1,120,323,303.08
购买商品、接受劳务支付的现金	234,179,391.65	987,764,259.89	594,688,478.14	753,993,634.01
支付给职工以及为职工支付的现金	73,421,672.41	205,035,425.95	138,154,621.38	172,658,479.97
支付的各项税费	17,575,573.93	94,926,105.41	65,664,589.24	60,534,604.84
支付的其他与经营活动有关的现金	35,786,383.43	92,959,614.41	100,582,287.85	95,318,714.15
经营活动现金流出小计	360,963,021.42	1,380,685,405.66	899,089,976.61	1,082,505,432.97
经营活动产生的	50,955,926.40	303,881,858.40	127,880,684.16	37,817,870.11

现金流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		13,961,371.64	71,259,330.75	111,184,747.81
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00	90.00	90.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,065.00	2,982,223.49	451,815.19	1,412,647.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,366,919.01		
收到其他与投资活动有关的现金	1,855,058.39	2,595,308.99	3,063,600.44	3,864,035.37
投资活动现金流入小计	5,865,123.39	24,905,823.13	74,774,836.38	116,461,520.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,753,095.99	287,146,895.71	72,594,550.17	55,160,737.19
投资支付的现金		4,749,677.43	1,247,990.00	10,643,861.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		23,090,340.51	204,846.00	56,002.57
投资活动现金流出小计	195,753,095.99	314,986,913.65	74,047,386.17	65,860,600.91
投资活动产生的现金流量净额	-189,887,972.60	-290,081,090.52	727,450.21	50,600,919.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		576,200,000.00	4,867,220.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	241,375,421.61	555,043,263.00	828,679,456.80	767,603,582.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	88,000,000.00	116,000,000.00	48,000,000.00

筹资活动现金流入小计	241,375,421.61	1,219,243,263.00	949,546,676.80	815,603,582.00
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	645,222,719.80	896,730,674.00	819,828,588.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,292,621.67	43,135,701.66	39,517,739.17	50,187,038.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	89,050,000.00	108,901,798.03	19,989,802.38
筹资活动现金流出小计	237,542,621.67	777,408,421.46	1,045,150,211.20	890,005,429.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,832,799.94	441,834,841.54	-95,603,534.40	-74,401,847.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,453.79	-1,757,431.36	-2,403,498.23	-1,301,168.99
五、现金及现金等价物净增加额	-135,010,792.47	453,878,178.06	30,601,101.74	12,715,773.47
加：期初现金及现金等价物余额	619,262,185.34	162,384,007.28	131,782,905.54	119,067,132.07
六、期末现金及现金等价物余额	484,251,392.87	616,262,185.34	162,384,007.28	131,782,905.54

(二) 最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2011.3.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
资 产				
流动资产：				
货币资金	298,444,542.99	279,652,542.39	103,256,694.81	84,748,735.74
交易性金融资产	534,928.59		6,590.00	372,732.03
应收票据	20,747,628.95	35,235,512.56	27,461,051.46	23,164,360.15
应收账款	156,316,802.85	161,749,747.78	140,627,142.50	77,329,434.33
预付款项	6,245,603.98	1,122,050.13	999,057.55	1,378,318.45
应收利息				
应收股利	4,000,000.00	23,000,000.00		23,351,700.00
其他应收款	15,870,349.94	25,153,991.34	146,750,063.32	320,517,117.24
存货	121,269,053.76	106,460,839.82	109,272,420.91	124,226,897.01
一年内到期的非				

流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	623,428,911.06	632,374,684.02	528,373,020.55	655,089,294.95
非流动资产：				
可供出售金融资产			12,900,426.00	52,174,812.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,154,181,767.53	1,155,992,777.30	769,456,570.46	566,659,256.98
投资性房地产				
固定资产	74,877,565.16	76,025,672.94	80,041,535.95	89,317,139.43
在建工程	872,347.30	540,542.85	240,407.54	19,214.04
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	39,161,408.17	36,807,547.70	25,472,866.78	33,079,895.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,796,294.49	14,395,429.17	14,883,289.02	12,757,990.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,281,889,382.65	1,283,761,969.96	902,995,095.75	754,008,307.62
资产总计	1,905,318,293.71	1,916,136,653.98	1,431,368,116.30	1,409,097,602.57
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	160,000,000.00	197,000,000.00	359,679,456.80	411,230,674.00
交易性金融负债				1,629,590.00
应付票据	68,000,000.00	40,000,000.00	115,500,000.00	94,000,000.00
应付账款	109,647,565.66	107,071,244.44	80,950,234.88	60,059,619.09
预收款项	499,423.16	1,221,844.52	852,209.34	3,661,258.50
应付职工薪酬	12,548,005.26	22,115,978.30	17,587,413.44	11,261,538.39
应交税费	207,537.11	-906,276.87	2,347,773.11	2,347,935.04
应付利息	370,333.34	399,712.50	639,718.75	956,775.38
应付股利				
其他应付款	420,816.50	532,049.35	966,210.19	34,776,330.31
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	391,693,681.03	407,434,552.24	578,523,016.51	619,923,720.71
非流动负债：				
长期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				

长期应付款	2,685,681.35	2,685,681.35	2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款	2,551,000.00	2,551,000.00	2,551,000.00	2,551,000.00
预计负债				
递延所得税负债	80,239.29		1,789,828.04	6,228,667.35
其他非流动负债	15,281,100.00	12,767,000.00	9,527,100.00	4,296,600.00
非流动负债合计	20,598,020.64	18,003,681.35	56,553,609.39	55,761,948.70
负债合计	412,291,701.67	425,438,233.59	635,076,625.90	675,685,669.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	434,080,000.00	434,080,000.00	404,080,000.00	404,080,000.00
资本公积	635,612,156.35	646,066,660.08	69,651,608.95	55,396,481.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	70,079,072.81	70,079,072.81	60,067,644.92	55,205,201.92
一般风险准备				
未分配利润	353,255,362.88	340,472,687.50	262,492,236.53	218,730,249.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,493,026,592.04	1,490,698,420.39	796,291,490.40	733,411,933.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,905,318,293.71	1,916,136,653.98	1,431,368,116.30	1,409,097,602.57

2、母公司利润表

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
一、营业收入	187,862,919.92	831,575,610.23	589,839,248.74	530,083,671.90
减：营业成本	157,822,053.17	697,368,505.36	503,014,292.09	453,221,182.76
营业税金及附加	244,774.07	2,758,695.59	1,946,027.59	1,578,247.51
销售费用	3,245,731.65	12,166,130.18	8,981,562.43	9,789,114.65
管理费用	19,347,145.47	85,886,831.69	67,536,786.12	70,374,614.06
财务费用	2,312,379.53	13,964,741.10	11,024,921.44	17,468,732.01
资产减值损失	984,477.64	514,172.45	9,942,134.39	68,672,810.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	534,928.59		141,667.97	-1,778,424.12
投资收益（损失以“－”号填列）	8,643,493.96	74,428,189.39	64,128,336.92	87,346,516.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,972,274.84	5,118,000.08	959,725.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,084,780.94	93,344,723.25	51,663,529.57	-5,452,937.35
加：营业外收入	1,587,255.53	10,754,549.05	3,355,571.46	11,967,103.13
减：营业外支出	201,088.37	1,451,837.71	1,719,982.02	2,071,617.98

其中：非流动资产处置损失		49,771.12	76,083.24	168,557.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,470,948.10	102,647,434.59	53,299,119.01	4,442,547.80
减：所得税费用	1,688,272.72	2,533,155.73	4,674,688.99	-3,900,397.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,782,675.38	100,114,278.86	48,624,430.02	8,342,945.28

3、母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	227,015,522.11	891,585,023.51	573,589,645.04	629,139,990.53
收到的税费返还	11,021,780.75	25,565,687.81	34,477,149.29	10,403,695.49
收到其他与经营活动有关的现金	5,858,632.22	50,061,924.79	44,550,716.21	12,547,711.94
经营活动现金流入小计	243,895,935.08	967,212,636.11	652,617,510.54	652,091,397.96
购买商品、接受劳务支付的现金	171,899,397.20	847,283,132.42	513,885,283.27	578,214,824.22
支付给职工以及为职工支付的现金	24,163,801.65	65,790,975.01	50,414,423.42	64,523,568.71
支付的各项税费	707,259.02	10,133,263.17	11,414,691.96	2,954,169.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,855,584.78	49,208,427.80	54,790,650.03	28,449,498.68
经营活动现金流出小计	213,626,042.65	972,415,798.40	630,505,048.68	674,142,060.95
经营活动产生的现金流量净额	30,269,892.43	-5,203,162.29	22,112,461.86	-22,050,662.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		13,961,371.64	71,259,330.75	111,184,747.81
取得投资收益收到的现金	19,000,000.00	39,000,000.00	23,351,790.00	2,700,090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,065.00	162,412.63	110,825.20	798,138.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,312,850.00		
收到其他与投资活动	11,386,136.98	281,952,201.02	337,465,248.78	55,367,075.05

有关的现金				
投资活动现金流入小计	30,387,201.98	343,388,835.29	432,187,194.73	170,050,051.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,179,782.30	21,537,873.48	2,100,751.58	11,188,365.04
投资支付的现金		354,000,000.00	173,172,877.38	12,402,146.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	600,000.00	146,790,000.00	146,700,000.00	257,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,779,782.30	522,327,873.48	321,973,628.96	280,590,511.19
投资活动产生的现金流量净额	20,607,419.68	-178,939,038.19	110,213,565.77	-110,540,459.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		576,200,000.00		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	217,000,000.00	547,179,456.80	486,230,674.00
收到其他与筹资活动有关的现金		88,000,000.00	111,022,000.00	159,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	881,200,000.00	658,201,456.80	645,230,674.00
偿还债务支付的现金	137,000,000.00	379,679,456.80	598,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,943,139.61	30,368,156.27	27,575,644.20	30,891,367.94
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	89,050,000.00	138,916,798.03	115,989,802.38
筹资活动现金流出小计	140,193,139.61	499,097,613.07	764,492,442.23	526,881,170.32
筹资活动产生的现金流量净额	-40,193,139.61	382,102,386.93	-106,290,985.43	118,349,503.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-618,171.90	-2,461,338.87	-2,761,483.13	-706,683.72
五、现金及现金等价物净增加额	10,066,000.60	195,498,847.58	23,273,559.07	-14,948,302.40
加：期初现金及现金等价物余额	263,465,542.39	67,966,694.81	44,693,135.74	59,641,438.14
六、期末现金及现金等价物余额	273,531,542.99	263,465,542.39	67,966,694.81	44,693,135.74

(三) 最近三年及一期合并报表范围的变化情况

发行人将持股 50%以上的子公司纳入合并报表范围,对合营企业(持股 50%)不纳入合并报表。发行人合并报表范围符合财政部规定及企业会计制度。最近三年及一期,发行人的合并报表范围发生变化情况如下:

1、2008 年度减少合并范围

Op Art Technologise,Inc.系士兰 B.V.I 公司联合自然人在开曼群岛设立的公司,根据士兰 B.V.I 公司与该公司签订的有关协议,士兰 B.V.I 公司原拟出资 370 万美元认购其 125 万优先股,并持有其 65%的股权比例。经发行人 2008 年 2 月 18 日第三届董事会第十三次会议决议同意,士兰 B.V.I 公司对开曼 Op Art 公司的出资额调整为 185 万美元,认购其 62.5 万股优先股,持股比例下降至 30.09%(截至 2008 年 12 月 31 日,士兰 B.V.I 公司已累计出资 185 万美元,其中现金出资 75 万美元,通过收购士兰美国公司持有的对 Op Art 公司 110 万美元的债务作为出资 110 万美元)。发行人于 2008 年 2 月末起失去对该公司的实质控制权,自 2008 年 3 月起,不再将其纳入合并财务报表范围。

2、2009 年度增加合并范围

2009 年度发行人全资子公司士兰明芯与香港亮彩有限公司共同出资设立杭州美卡乐公司,该公司于 2009 年 7 月 2 日办理完毕工商设立登记手续,并取得注册号为 330100400029450 的《企业法人营业执照》,注册资本 1,700 万港币,其中士兰明芯出资 1,190 万港币,占其注册资本的 70%,拥有对美卡乐的实质控制权。自该公司成立之日起,发行人将其纳入合并财务报表范围。

3、2010 年度

(1) 增加合并范围。2010 年度发行人与全资子公司士兰明芯共同出资设立成都士兰公司,成都士兰公司于 2010 年 11 月 18 日办理完毕工商设立登记手续,并取得注册号为 510121000020586 的《企业法人营业执照》。成都士兰注册资本 20,000 万元,实收资本 6,000 万元,发行人出资 5,400 万元,占其实收资本的 90%,士兰明芯出资 600 万元,占其实收资本的 10%。发行人拥有对成都士兰的实质控制权,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 减少合并范围。发行人与士兰控股于 2010 年 12 月 28 日签订《股权转让协议》,发行人以 8,312,850.00 元将所持有的士腾科技 73.50%的股权转让给士兰控股,转让后,发行人对士腾科技的持股比例从 83.5%下降为 10%。发行人于

2010年12月30日收到该项股权转让款8,312,850.00元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2010年12月31日起不再将其纳入合并财务报表范围。

二、最近三年及一期的主要财务指标

(一) 公司最近三年及一期的主要财务指标

1、合并报表财务指标

财务指标	2011年1-3月/末	2010年末/度	2009年末/度	2008年末/度
流动比率	1.58	1.78	0.98	0.82
速动比率	1.16	1.40	0.65	0.49
资产负债率	35.60%	34.90%	54.10%	58.40%
利息保障倍数	6.67	9.99	3.00	1.45
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

2、母公司财务指标

财务指标	2011年1-3月/末	2010年末/度	2009年末/度	2008年末/度
流动比率	1.59	1.55	0.91	1.06
速动比率	1.28	1.29	0.72	0.86
资产负债率	21.64%	22.20%	44.37%	47.95%
利息保障倍数	6.03	9.00	3.00	1.45
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息支出
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

(二) 近三年及一期净资产收益率和每股收益

财务指标	2011年1-3月/末	2010年末/度	2009年末/度	2008年末/度
加权平均净资产收益率	2.51%	23.54%	10.02%	1.63%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	2.26%	20.49%	0.93%	-6.87%
每股收益(元)	基本每股收益	0.10	0.62	0.19
	稀释每股收益	0.10	0.62	0.19
扣除非经常损益后的每股收益(元)	基本每股收益	0.09	0.54	0.02
	稀释每股收益	0.09	0.54	0.02

注：上述财务指标计算公式如下：

1、净资产收益率计算公式

全面摊薄净资产收益率=P/E

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0}$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、每股收益计算公式

基本每股收益可参照如下公式计算：

基本每股收益=P/S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益=P₁/（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

三、管理层分析与讨论

本公司管理层结合公司最近三年及一期的财务报表，对资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析。

（一）以母公司报表口径分析

1、资产负债结构分析

（1）资产分析

项目	2011.3.31		2010.12.31		2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

流动资产：	62,342.89	32.72%	63,237.47	33.00%	52,837.30	36.91%	65,508.93	46.49%
货币资金	29,844.45	15.66%	27,965.25	14.59%	10,325.67	7.21%	8,474.87	6.01%
应收票据	2,074.76	1.09%	3,523.55	1.84%	2,746.11	1.92%	2,316.44	1.64%
应收账款	15,631.68	8.20%	16,174.97	8.44%	14,062.71	9.82%	7,732.94	5.49%
其他应收款	1,587.03	0.83%	2,515.40	1.31%	14,675.01	10.25%	32,051.71	22.75%
存货	12,126.91	6.36%	10,646.08	5.56%	10,927.24	7.63%	12,422.69	8.82%
非流动资产：	128,188.94	67.28%	128,376.20	67.00%	90,299.51	63.09%	75,400.83	53.51%
长期股权投资	115,418.18	60.58%	115,599.28	60.33%	76,945.66	53.76%	56,665.93	40.21%
固定资产	7,487.76	3.93%	7,602.57	3.97%	8,004.15	5.59%	8,931.71	6.34%
在建工程	87.23	0.05%	54.05	0.03%	24.04	0.02%	1.92	0.00%
无形资产	3,916.14	2.06%	3,680.75	1.92%	2,547.29	1.78%	3,307.99	2.35%
资产总计	190,531.83	100.00%	191,613.67	100.00%	143,136.81	100.00%	140,909.76	100.00%

最近三年一期，本公司总资产分别为 140,909.76 万元、143,136.81 万元、191,613.67 万元和 190,531.83 万元。2008 年流动资产较高系其他应收款中包含母公司拆借给子公司士兰集成的借款余额 31,950.00 万元；2009 年子公司拆借款的下降导致流动资产较 2008 年有所下降；2010 年流动资产增长主要系该年度非公开发行股票融资约 5.75 亿元以及公司生产销售规模的扩大导致应收账款、应收票据等相关流动资产相应增长。非流动资产规模的持续增长主要归因于本公司近几年加大投资，项目实施形成母公司账面长期股权投资增长所致。

母公司主要从事集成电路、器件的设计和销售及测试，不从事实体制造，属设计企业，具体的生产制造主要在下属子公司士兰集成和士兰明芯，因此本公司长期股权投资占资产的比例较高，而母公司本身属轻资产公司。

最近三年一期，本公司的货币资金余额分别为 8,474.87 万元、10,325.67 万元、27,965.25 万元和 29,844.45 万元，分别占当期总资产比例为 6.01%、7.21%、14.59%和 15.66%。2010 年底公司货币资金数额较高系 2010 年度本公司非公开发行股票募集资金约 5.75 亿元，其中约 3.75 亿元开在母公司募集资金账户，故当期末货币资金余额 27,965.25 万元，占当期总资产 14.59%，高于以前年度货币资金所占总资产的比重。2009 年末货币资金余额增加主要系母公司销售业绩提升导致经营性现金流量增加所致。

最近三年一期，本公司的应收票据余额分别 2,316.44 万元、2,746.11 万元、3,523.55 万元和 2,074.76 万元，占当期总资产的比例分别为 1.64%、1.92%、1.84%和 1.09%。本公司的应收票据为银行承兑汇票为主，到期后均能按期收回，收款

风险极小。

最近三年一期，本公司的应收账款余额分别 7,732.94 万元、14,062.71 万元、16,174.97 万元和 15,631.68 万元，占当期总资产的比例分别为 5.49%、9.82%、8.44%和 8.20%。发行人应收账款系因销售产品所形成。公司的销售政策为：内销发货后月底统一结算，给客户的收账期为 30-90 天，应收账款的周转天数一般在 60-90 天之间；出口销售主要采用电汇（T/T）、信用证（L/C）结算。总体来看，应收账款的回款情况良好。应收账款期末余额的增加主要是随公司业务发展，销售收入增长，信用余额随之增加。

最近三年一期，公司各期末应收账款账龄在一年以内的比重均在 93%以上，说明公司应收账款的质量较高。同时，截至 2010 年年底，公司已计提了应收账款的坏账准备余额 975.18 万元，占该期末应收账款总额的 5.32%，基本覆盖减值风险。对超过一定期限的应收账款，公司也在积极采取各种办法予以催收和清理。

最近三年一期，本公司的其他应收款余额分别 32,051.71 万元、14,675.01 万元、2,515.40 万元和 1,587.03 万元，占当期总资产的比例分别为 22.75%、10.25%、1.31%和 0.83%。本公司其他应收款主要是应收子公司的款项，如截至 2008 年 12 月 31 日，应收士兰集成的款项为 31,950 万元，占当期其他应收款总额（扣除坏账准备前）的 90.39%，属于内部往来款项，在合并报表时将抵消，不存在收回的风险；截至 2009 年 12 月 31 日，应收子公司士兰集成的款项为 14,903.75 万元，占当期其他应收款余额的比例为 87.77%；应收子公司博脉科技的款项为 763.30 万元，占当期其他应收款余额的比例为 4.50%；截至 2010 年 12 月 31 日，应收子公司士兰集成的款项为 2,005.04 万元，占其他应收款余额的比例为 47.97%。截至 2011 年 3 月 31 日，应收子公司士兰集成的款项为 1,022.69 万元。近三年一期其他应收款余额大幅度下降，主要系子公司业绩提升，对母公司的拆借款依赖减少所致。

截至 2011 年 3 月 31 日，公司其他应收款总额为 3,257.53 万元，已计提了其 他应收款的坏账准备余额约 1,670.50 万元，占该期末其他应收款总额的 51.28%，基本覆盖其他应收款的减值风险。对超过一定期限的其他应收款，公司也在积极采取各种办法予以催收和清理。

最近三年一期，本公司的存货余额分别 12,422.69 万元、10,927.24 万元、

10,646.08 万元和 12,126.91 万元，占当期总资产的比例分别为 8.82%、7.63%、5.56%和 6.36%。本公司的期末存货中主要为集成电路和分立器件。母公司的业务主要为从事集成电路和分立器件的设计和 sales，根据设计的产品类别不同，主要委托子公司士兰集成生产加工，再对外进行委托加工封装后进行销售。最近三年一期，期末存货保持逐渐减少的趋势，系随着近年来集成电路和分立器件芯片业务行情看涨，以及公司生产经营管理水平的提升，销量增加的同时存货周转率加快，导致期末库存量逐渐减少所致。

最近三年一期，本公司长期股权投资余额分别为 56,665.93 万元、76,945.66 万元、115,599.28 万元和 115,418.18 万元，分别占当期总资产的比例为 40.21%、53.76%、60.33%和 60.58%。本公司长期投资主要是系对控股子公司的投资，截至 2011 年 3 月 31 日，本公司长期投资明细余额如下：

被投资单位	2011.3.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31	持股比例	减值准备
士兰集成	39,035.10	39,035.10	39,035.10	29,285.10	97.50%	
士兰明芯	50,903.59	50,903.59	20,903.59	13,804.30	100.00%	
士兰光电	1,300.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	65.00%	
士景电子	1,010.37	1,010.37	1,010.37	1,010.37	85.37%	1,010.37
博脉科技	487.70	487.70	487.70	144.50	90.00%	144.50
士港科技	1,608.87	1,608.87	1,608.87	1,608.87	100.00%	
士兰美国	1,559.36	1,559.36	1,559.36	1,559.36	100.00%	995.27
士兰 B.V.I	3,463.02	3,463.02	3,463.02	3,463.02	100.00%	3,000.69
成都士兰	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	90.00%	
深兰微	270.00	270.00	270.00	270.00	90.00%	
上海士虹	858.20	858.20	858.20	858.20	100.00%	858.20
友旺电子	14,776.41	14,776.41	10,869.43	6,542.79	40.00%	
友旺科技	733.40	733.40	802.40	793.27	32.00%	
杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	150.00	150.00	150.00	150.00	15.00%	
士腾科技	52.29	52.29	436.64	312.50	10.00%	
杭州国家软件产业基地有限公司		0.00	0.00	205.26		
合计	121,608.31	121,608.31	82,954.68	61,507.54		6,009.02

1) 控股子公司投资情况

①杭州士兰集成电路有限公司

士兰集成于 2001 年 1 月 12 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301001400203 的《企业法人营业执照》。士兰集成现有注册资本 40,000 万元，股东为发行人、友旺电子和士兰明芯，其中发行人持股 97.5%。

士兰集成实际从事的主要经营业务为：集成电路、半导体、分立器件的制造和销售。士兰集成的 2010 年度、2009 年度、2008 年度财务报表经天健会计师事务所有限公司审计，并分别出具天健审（2011）1243 号、天健审（2010）493 号、浙天会审（2009）1549 号审计报告。2010 年度、2009 年度、2008 年度，士兰集成分别实现净利润 9,530.03 万元、947.42 万元、-1,138.61 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润 1,540.47 万元。

②杭州士兰明芯科技有限公司

士兰明芯于 2004 年 9 月 24 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301980000002733 的《企业法人营业执照》。士兰明芯现有注册资本 50,000 万元，发行人持股 100%。

士兰明芯实际从事的主要经营业务为：发光半导体器件、化合物半导体器件的设计、制造、销售。士兰明芯的 2010 年度、2009 年度、2008 年度财务报表经天健会计师事务所有限公司审计，并分别出具天健审（2011）1249 号、天健审（2010）492 号、浙天会审（2009）1493 号审计报告。2010 年度、2009 年度、2008 年度，士兰明芯分别实现净利润 11,493.72 万元、2,778.99 万元、3,414.85 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润 1,791.26 万元。

③杭州士兰光电技术有限公司

士兰光电系经杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新（2004）471 号文批准，原由发行人、Microsignal CO.,LTD 和 UNIDUX ELECTRONICS LIMITED 投资设立的中外合资经营企业，于 2004 年 12 月 30 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙杭总字第 200159 号的《企业法人营业执照》。经股权变更后，士兰光电现由发行人、SILAN ELECTRONICS,LTD、UNIDUX ELECTRONICS LIMITED 和杭州玄同电子有限公司共同投资，投资总额 4,000 万元，注册资本 2,000 万元，其中发行人持股 65%。经营期 20 年。

士兰光电实际从事的主要经营业务为：设计、开发、生产、销售光电模块、

光电器件等相关产品。士兰光电的 2010 年度、2009 年度、2008 年度财务报表经天健会计师事务所有限公司审计，并分别出具天健审（2011）1244 号、天健审（2010）615 号、浙天会审（2009）1487 号审计报告。2010 年度、2009 年度、2008 年度，士兰光电分别实现净利润 246.56 万元、-35.66 万元、-469.24 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润 55.23 万元。

④杭州博脉科技有限公司

博脉科技系于 2005 年 1 月 21 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301081100025 的《企业法人营业执照》。博脉科技现有注册资本 500 万元，股东为发行人和自然人黄景江、江强，其中发行人持股 90%。

博脉科技实际从事的主要经营业务为：设计、开发、批发、零售：多功能遥控器。博脉科技的 2010 年度、2009 年度、2008 年度财务报表经天健会计师事务所有限公司审计，并分别出具天健审（2011）1251 号、天健审（2010）616 号、浙天会审（2009）**2143** 号审计报告。2010 年度、2009 年度、2008 年度，博脉科技分别实现净利润 119.07 万元、-135.94 万元、-195.23 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润 26.08 万元。

博脉科技是一家专业从事多功能遥控器方案推广的公司，依托发行人的支持，2010 年博脉科技在生产经营已有转好的迹象。

⑤杭州士景电子有限公司

士景电子于 2006 年 1 月 24 日在杭州工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330108000002657 号的《企业法人营业执照》。士景电子现有注册资本 1,000 万元，股东为发行人和自然人张伟峰，其中发行人持股 85.366%。

士景电子实际从事的主要经营业务为：微电子产品的设计。2010 年度、2009 年度、2008 年度，士景电子分别实现净利润-3.80 万元、-59.11 万元、-492.88 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润-0.20 万元。

2009 年年初发行人将士景电子的技术、产品划入数字音视频产品线。截至本募集说明书签署日，士景电子已处于歇业状态。

⑥深圳市深兰微电子有限公司

深兰微于 2000 年 1 月 11 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4403012039607 的《企业法人营业执照》。深兰微现有注册资本 300 万元，股

东为发行人和杭州士兰集成电路有限公司，其中发行人持股 90%。

深兰微实际从事的主要经营业务为：电子产品的购销。深兰微的 2010 年度、2009 年度、2008 年度财务报表经天健会计师事务所有限公司审计，并分别出具天健审（2011）1248 号、天健审（2010）612 号、浙天会审（2009）1458 号审计报告。2010 年度、2009 年度、2008 年度，深兰微分别实现净利润 29.75 万元、103.85 万元、65.33 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润 23.27 万元。

⑦士港科技有限公司

士港科技有限公司于 2004 年 7 月在香港注册成立，为发行人全资子公司，注册资本 200 万美元。

士港科技实际从事的主要经营业务为：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务。2011 年 1-3 月、2010 年度、2009 年度、2008 年度，士港科技分别实现净利润-15.25 万元、29.19、54.57 万元、155.30 万元。

⑧士兰微电子美国股份有限公司

士兰美国于 2005 年 7 月在美国加州注册成立，为发行人全资子公司，总投资额 200 万美元。

士兰美国实际从事的主要经营业务为：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、销售，经营进出口业务。2011 年 1-3 月、2010 年度、2009 年度、2008 年度，士兰微电子美国股份有限公司分别实现净利润 0 万元、-251.14 万元、-341.00 万元、-171.94 万元。士兰美国是发行人设在美国的研发中心，截至 2009 年年底，发行人对士兰美国的前期投入 200 万美元，除其中 110 万美元转让给士兰 B.V.I 外，其余 90 万美元已基本消耗完毕，目前暂无对士兰美国进一步投资计划。

⑨Silan Electronics,Ltd

Silan Electronics,Ltd.于 2004 年 7 月在英属维尔京群岛注册成立，为发行人全资子公司，实际投资额 465 万美元。

截至本募集说明书签署之日，士兰 B.V.I 持有 3 家公司的股权：Op Art Technologise,Inc.（简称 OP Art 公司）、Sicomm Technology Limited（简称士康科技）、士兰光电。另外，士兰 B.V.I 还持有 Cadrado,Inc（简称 Cadrado 公司）发行的可转换债券。

OP Art 公司是一家专业从事 DVD 伺服芯片开发的设计公司，士兰 B.V.I 对 OP Art 公司投资 185 万美元持有其 30.09%的股权。报告期内 OP Art 公司尚处于产品研发阶段，未有产品销售收入。

士康科技是一家专业从事对讲机芯片等产品开发的设计公司，士兰 B.V.I 对士康科技投资 2,669,903 美元，目前持有其 6.19%的股权。受金融危机影响，士康科技的财务状况出现恶化，资金缺乏。经历了自身积极地调整，2010 年士康科技经营情况已逐步好转，资金压力已得到缓解。

Cadrado 公司是一家专业从事 DVD 后端解码芯片开发的设计公司，士兰 B.V.I 对 Cadrado 公司出资 100 万美元认购其发行的 100 万美元可转换债券（帐列其他应收款）。报告期内 Cadrado 公司尚处于产品研发阶段，未有产品销售收入。

2011 年 1-3 月、2010 年度、2009 年度、2008 年度，Silan Electronics,Ltd 分别实现净利润-2.64 万元、-1.45 万元、-1,163.72 万元、-1,874.12 万元。

⑩上海士虹电子科技有限公司

上海士虹系公司全资子公司，于 2004 年 12 月在上海注册成立，注册资本 1000 万元人民币。

上海士虹实际从事的主要经营业务为：集成电路设计。2011 年 1-3 月、2010 年度、2009 年度、2008 年度，上海士虹分别实现净利润-0.77 万元、-2.17 万元、-5.59 万元、-170.04 万元。

2008 年年初公司将上海士虹的技术、产品划入数字音视频产品线。根据公司于 2010 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司为进一步整合现有资源，提高管理效率，拟注销上海士虹。目前上海士虹的注销手续正在办理过程之中。

⑪ 成都士兰半导体制造有限公司

成都士兰于 2010 年 11 月 18 日在成都市金堂工商行政管理局登记注册，取得注册号为 510121000020586 的《企业法人营业执照》。成都士兰注册资本 20,000 万元，发行人持股 90%，士兰明芯持股 10%。

成都士兰实际从事的主要经营业务为：集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售（经向环保部门排污申报后方可经营）；

货物进出口。成都士兰的 2010 年度财务报表经天健会计师事务所有限公司审计，并出具了天健审（2011）2101 号审计报告。2010 年度实现净利润-37.78 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润-33.17 万元。

发行人上述控股子公司中，士兰集成、士兰明芯均拥有独立的厂房和经营设备，已形成成熟的产品、市场和技术；成都士兰系 2010 年新成立公司尚在建设期末正式投产运营；深兰微和士港科技系贸易型公司，其中士港科技注册在香港，主要负责海外销售；士兰光电、博脉科技、士景电子、上海士虹系发行人为了开发某种技术或产品，同时实现对其核心管理、技术团队激励而成立的科技型公司。由于技术、产品、市场变化较快，博脉科技、士景电子、上海士虹在报告期内出现过较大亏损。士兰美国是发行人为了吸引硅谷人才开发相关产品而设在美国的研发中心；士兰 B.V.I 系发行人在海外的投资平台，主要选择一些技术型公司进行风险投资。上述投资模式是发行人作为研发型公司的主要特点。是发行人为了实现技术、产品创新所必须的，一旦投资获得成功，发行人将获得较大的回报。

由于上海士虹、士景电子、博脉科技、士兰美国、士兰 BVI 近几年产生较大的经营性亏损，存在资产组组合的可收回金额低于其账面价值的减值情况，因此发行人已经对其全部或部分投资计提了资产减值准备。

2) 联营公司投资情况

①杭州友旺电子有限公司

友旺电子系经杭州市西湖区对外经济贸易区西外经贸资（1993）第 101 号文批准，由台湾友顺科技股份有限公司投资设立的外商独资企业，于 1994 年 4 月 27 日取得国家工商行政管理局核发的企独浙杭字第 01809 号的《企业法人营业执照》。1997 年 10 月，经杭州市西湖区对外经济贸易局西外经贸资（1997）第 88 号文批准，该公司变更为由台湾友顺科技股份有限公司和发行人共同投资的中外合资企业，并取得变更后由杭州市工商行政管理局核发的企合浙杭总字第 001809 号《企业法人营业执照》。友旺电子现有投资总额 360 万美元，注册资本为 300 万美元，其中发行人持股 40%，经营期 20 年。

天健会计师事务所有限公司对友旺电子 2010 年度、2009 年度、2008 年度的财务报表进行了审计，并分别出具了天健审（2011）1245 号、天健审（2010）491 号、浙天会审（2009）1427 号审计报告。2010 年度、2009 年度、2008 年度，

友旺电子分别实现净利润 2,415.58 万元、1,256.67 万元、837.69 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润 1,884.22 万元。

②杭州友旺科技有限公司

友旺科技系经杭州市高新技术产业开发区管委会杭高新（2006）27 号文批准，由台湾友顺科技股份有限公司、发行人和杭州友旺电子有限公司投资设立的中外合资企业，于 2006 年 6 月 20 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙杭总字第 260114 号的《企业法人营业执照》，投资总额 625 万美元，注册资本 437.5 万美元，其中发行人持股 32%。经营期 10 年。

友旺科技的 2010 年度、2009 年度、2008 年度财务报表经浙江天健会计师事务所审计，并分别出具天健审（2011）1246 号、天健审（2010）613 号、浙天会审（2009）1428 号审计报告。2010 年度、2009 年度、2008 年度，友旺科技分别实现净利润-205.50 万元、28.54 万元、-747.20 万元；2011 年 1-3 月份实现净利润-5.65 万元。

3) 参股公司投资情况

①杭州国家集成电路设计产业基地有限公司

杭州国家集成电路设计产业基地有限公司系由发行人和杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司、杭州市高科技企业孵化器有限公司、严晓浪投资设立，于 2004 年 7 月 21 日在杭州市工商行政管理局高新分局登记注册，取得注册号为 3301081100013 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 1,000 万元，其中发行人持股 15%。

杭州国家集成电路设计产业基地有限公司 2010 年度、2009 年度、2008 年度，分别实现净利润-1.10 万元、-2.8 万元、-0.9 万元。2011 年 1-3 月实现净利润-17.95 万元。

②杭州士腾科技有限公司

士腾科技于 2003 年 4 月 16 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301082101139 的《企业法人营业执照》。士腾科技现有注册资本 1,000 万元。士腾科技实际从事的主要经营业务为：与微控制器、微处理器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件的开发和服务，销售与微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件。

2010年12月28日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，会议同意公司将所持有的士腾科技73.50%股权转让给士兰控股公司，本次股权转让合计转让价格为831.28万元，该价格以截至2009年12月31日士腾科技经审计的净资产为基础，经双方协商确定。公司独立董事对此发表了意见，认为，此次关联交易符合本公司整体战略规划，目的在于对公司主营业务进行精简，有助于公司集中资源，提升主营业务经济效益，有利于公司的可持续发展。董事会审议该项议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定，没有损害本公司利益，没有损害公司非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

转让后杭州士兰微电子股份有限公司的股权比例为10%，自然人李文杰、刘建江、陈浩、杨海峰的股权比例分别为8%、4.5%、2%和2%。2010年度、2009年度、2008年度，士腾科技分别实现净利润-103.50万元、-185.04万元、-172.83万元。2011年1-3月份实现净利润-184.07万元。

最近三年一期，对可合理预计的损失，发行人计提了投资减值准备；发行人在基础资料确实的前提下核算投资收益；被纳入合并报表范围内控股子公司，注册会计师均审计并对主要控股子公司出具了标准无保留意见的审计报告。最近三年一期，发行人无委托理财。

最近三年一期，本公司固定资产余额分别为8,931.71万元、8,004.15万元、7,602.57万元和7,487.76万元，分别占当期总资产的6.34%、5.59%、3.97%和3.93%。母公司固定资产包括房屋建筑物及测试设备等，母公司主要从事集成电路及器件的设计和制造，故固定资产主要是办公楼、厂房及测试设备为主，最近三年一期随着折旧的计提，固定资产余额逐年降低。

最近三年一期，本公司无形资产3,307.99万元、2,547.29万元、3,680.75万元和3,916.14万元，分别占当期总资产的比例为2.35%、1.78%、1.92%和2.06%。公司近三年一期的无形资产除土地使用权外，主要为外购的软件、技术、IP，其入账的价格为实际支付的价格及费用。截至2011年3月31日，发行人无形资产会计处理合理，摊销年限及确定依据合理。

从资产构成来看，本公司的资产结构较为稳定；从金额来看呈逐年增长趋势。长期股权投资占比较大且呈逐年增长的趋势。2010年货币资金占比较高主要系非公开发行募集资金到账所致。固定资产较为稳定主要系办公楼，随计提折旧的

影响固定资产余额逐年下降。扣除长期股权投资影响外，本公司流动资产较高，主要和母公司定位为技术密集型轻资产设计企业的特点相符合。

(2) 负债分析

项目	2011.3.31		2010.12.31		2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：	39,169.37	95.00%	40,743.46	95.77%	57,852.30	91.09%	61,992.37	91.75%
短期借款	16,000.00	38.81%	19,700.00	46.31%	35,967.95	56.64%	41,123.07	60.86%
应付票据	6,800.00	16.49%	4,000.00	9.40%	11,550.00	18.19%	9,400.00	13.91%
应付账款	10,964.76	26.59%	10,707.12	25.17%	8,095.02	12.75%	6,005.96	8.89%
一年内到期的非流动负债	4,000.00	9.70%	4,000.00	9.40%				
非流动负债：	2,059.80	5.00%	1,800.37	4.23%	5,655.36	8.91%	5,576.19	8.25%
长期借款	-	0.00%	0.00		4,000.00	6.30%	4,000.00	5.92%
长期应付款	268.57	0.65%	268.57	0.63%	268.57	0.42%	268.57	0.40%
专项应付款	255.10	0.62%	255.10	0.60%	255.10	0.40%	255.10	0.38%
其他非流动负债	1,528.11	3.73%	1,276.70	3.00%	952.71	1.50%	429.66	0.64%
负债总计	41,229.17	100.00%	42,543.82	100.00%	63,507.66	100.00%	67,568.57	100.00%

最近三年一期，本公司总负债分别为 67,568.57 万元、63,507.66 万元、42,543.82 万元和 41,229.17 万元，最近三年总负债呈逐年下降的态势。流动负债的减少主要是由于短期借款规模下降所致；由于子公司业绩增长较好，故最近三年及一期从母公司拆借资金呈逐年下降趋势，因而母公司短期借款随之降低。非流动负债的减少主要系长期借款到期转入一年内到期的非流动负债所致；其他非流动负债的增加主要系政府补助对应的递延收益科目增加所致。

最近三年一期，本公司短期借款呈降低趋势，主要是下属子公司随资产规模的扩大、业绩的提升以及自身融资能力的增强，从母公司拆借资金的需求降低，导致母公司融资需求降低所致。发行人的应付账款增加较大系随发行人业务的发展，相应的材料采购规模扩大，其在供应商的商业信用也逐步增加，也说明了本公司财务管理能力较强，利用商业信用融资，降低财务费用。

最近三年一期，本公司长期银行借款系 2008 年向华夏银行高新支行借入一笔 4,000.00 万长期借款于 2011 年到期，2010 年开始转入一年内到期的长期借款。其他非流动负债主要系政府补贴对应的递延收益。

从负债结构来看，发行人最近三年一期的负债结构较为稳定。在发行人的全部负债中，流动负债占比一直较大，占总负债的比重基本为 90%以上，长期负债占总负债比重基本在 10%以下。相对而言，流动负债比例相对过高，有调整负债

结构的内在需求。

2、现金流量分析

最近三年一期，本公司现金流量情况如下表所示：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	3,026.99	-520.32	2,211.25	-2,205.07
投资活动产生的现金流量净额	2,060.74	-17,893.90	11,021.36	-11,054.05
筹资活动产生的现金流量净额	-4,019.31	38,210.24	-10,629.10	11,834.95
汇率变动的影响	-61.82	-246.13	-276.15	-70.67
现金及现金等价物净增加额	1,006.60	19,549.88	2,327.36	-1,494.83

(1) 经营活动产生的现金流量分析

最近三年一期，本公司经营活动产生的现金净流量分别为-2,205.07 万元、2,211.25 万元、-520.32 万元和 3,026.99 万元。2008 年经营性现金流量较低主要系出口退税款延缓至 2009 年到账；2010 年经营性现金流入较高，但公司出于压缩负债规模、节约财务费用的考虑，在当年经营现金流入较为充沛的情况下主动减少应付票据的开立和结算业务，应付票据余额从 2010 年年初的 11,550.00 万元降至 4,000.00 万元，从而导致 2010 年经营活动产生的现金流量净额偏低。由于公司定位为设计与制造一体化的芯片制造商，母公司主要从事集成电路与分立器件芯片业务的设计与销售，前三年经营性活动产生的现金流量净额较小主要系研发费用较大，计入经营性现金流量支出所致。随着公司对产品线的调整逐步到位，未来毛利较高电路和分立器件新产品将逐步上量，母公司利润水平将进一步提升，从而使得母公司经营性现金流量今后会趋于增长。

(2) 投资活动产生的现金流量分析

最近三年一期，本公司投资活动产生的现金净流量分别为-11,054.05 万元、11,021.36 万元、-17,893.90 万元和 2,060.74 万元。2010 年投资活动产生的现金流量净额为-17,893.90 万元，主要系向子公司士兰明芯增资 20,000.00 万元以及向成都士兰投资 5,400.00 万元导致；2009 年投资活动产生的现金流量金额为 11,021.36，较 2008 年提升主要系收回子公司暂借款导致收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量分析

最近三年一期，本公司筹资活动产生的现金净流量分别为 11,834.95 万元、-10,629.10 万元、38,210.24 万元和-4,019.31 万元，2009 年较低主要系由于业绩

提升公司偿还借款所致；2010 年增加主要系非公开发行募集资金约 5.75 亿元所致。

本公司现金管理较好，针对本公司最近几年积极调整债务结构，降低融资成本和财务风险；同时本公司将进一步加强资金管理，合理利用既有资金，加速资金周转，提高经济效益。

3、偿债能力分析

(1) 从公司主要偿债指标分析公司偿债能力

最近三年及一期的偿债指标（母公司报表）

财务指标	2011 年 1-3 月/末	2010 年末/度	2009 年末/度	2008 年末/度
流动比率	1.59	1.55	0.91	1.06
速动比率	1.28	1.29	0.72	0.86
应收账款周转率	1.18	5.50	5.41	5.38
存货周转率	1.39	6.47	4.31	3.75
资产负债率	21.64%	22.20%	44.37%	47.95%
利息保障倍数	6.03	9.00	5.87	1.00
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

上述指标计算公式：

- 1、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息支出
- 2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 3、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

根据母公司报表数据分析，最近三年一期，本公司流动比率和速动比率绝对数额相对较小，存在一定的短期偿债压力。流动比率和速动比率数额较小主要原因是由于本公司负债结构不合理，流动负债占比较高。最近三年一期，流动负债占总负债的比重均在 90%以上。若本次公司债券顺利发行，将改善公司的债务结构，流动负债占总负债的比重将明显降低，公司流动比率和速动比率将进一步提高，从而将较好的改善本公司短期偿债能力。2009 年度流动比率和速动比率较低，主要系母公司 2009 年经营业绩增长现金流增加后，出于节约财务费用的考虑主动减少部分短期借款所致；2010 年及 2011 年 1-3 月流动比率和速动比率较高主要系非公开发行募集资金到账导致货币资金增长所致。

从资产负债率来看，2008 年与 2009 年资产负债率较为一致，2010 年及 2011

年 1-3 月份较低主要系非公开发行募集资金到账增加流动资产，同时短期借款减少所致。

从资产运营效率来看，最近三年一期，本公司应收账款周转率分别为 5.38、5.41、5.50 和 **1.18**，存货周转率分别为 3.75、4.31、6.47 和 **1.39**，明显处于相对较高的水平，资产周转速度快，变现能力强，为公司的偿债能力提供了保证。

从利息保障倍数来看，最近三年一期的利息保障倍数分别为 1.00、5.87、9.00 和 6.03，公司的息税前净利润完全可以覆盖公司的利息费用支出。

从贷款偿还率来看，本公司自成立以来，始终按期偿还有关债务。公司经营状况良好，且具有较好的发展前景，在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。公司的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有良好的资信水平。基于公司良好的经营状况和资信状况，公司具有较好的间接与直接融资能力，这有助于公司在必要时可通过银行贷款补充流动资金，从而更有力地为本次债券的偿付提供保障。

（2）从银行授信额度分析公司偿债能力

公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期的合作伙伴关系，获得各银行的授信额度，间接债务融资能力较强，可以为本期公司债券的及时偿付提供相应的保障性支持。

（3）从现金流情况分析公司偿债能力

最近三年一期，本公司现金流量情况如下表所示：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	3,026.99	-520.32	2,211.25	-2,205.07
投资活动产生的现金流量净额	2,060.74	-17,893.90	11,021.36	-11,054.05
筹资活动产生的现金流量净额	-4,019.31	38,210.24	-10,629.10	11,834.95
汇率变动的影响	-61.82	-246.13	-276.15	-70.67
现金及现金等价物净增加额	1,006.60	19,549.88	2,327.36	-1,494.83

最近三年一期，本公司经营活动产生的现金净流量分别为-2,205.07 万元、2,211.25 万元、-520.32 万元和 3,026.99 万元，扣除 2010 公司主动减少续开立应付票据导致现金流降低的因素外，整体现金流情况良好，且能为公司债务的偿还提供保障。

最近三年一期，公司的直接融资渠道和间接融资渠道均非常畅通，除一直保持良好的银行合作关系且较充足的银行授信额度外，2010 年非公开发行股票共

筹资约 5.75 亿元。本公司良好的筹资能力为公司债务的偿付提供了更多的保障。

(4) 从资本市场直接融资能力分析公司偿债能力

作为经营稳定、业绩良好的上市公司，在资本市场的融资渠道畅通，2010 年通过非公开发行股票顺利进行了股权融资募集资金约 5.75 亿元。目前，无未及及时还本付息的情况。因而必要时，公司可以通过直接融资手段在资本市场筹集资金以满足公司资金需要，这也为公司按期偿还本期债券提供有力支持。

(5) 其它偿债措施

本期债券由士兰控股提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，可以有效降低本期债券的到期偿付风险。

4、盈利能力分析

最近三年一期，本公司主要经营情况如下：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
营业收入	18,786.29	83,157.56	58,983.92	53,008.37
营业成本	15,782.21	69,736.85	50,301.43	45,322.12
销售费用	324.57	1,216.61	898.16	978.91
管理费用	1,934.71	8,588.68	6,753.68	7,037.46
财务费用	231.24	1,396.47	1,102.49	1,746.87
营业利润	1,308.48	9,334.47	5,166.35	-545.29
利润总额	1,447.09	10,264.74	5,329.91	444.25
净利润	1,278.27	10,011.43	4,862.44	834.29

(1) 主营业务分析

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
营业收入	18,786.29	83,157.56	58,983.92	53,008.37
营业成本	15,782.21	69,736.85	50,301.43	45,322.12
营业毛利	3,004.08	13,420.71	8,682.50	7,686.25
营业毛利率	15.99%	16.14%	14.72%	14.50%

最近三年一期，本公司营业收入分别为 53,008.37 万元、58,983.92 万元、83,157.56 万元和 18,786.29 万元，呈持续增长趋势。营业毛利分别为 7,686.25 万元、8,682.50 万元、13,420.71 万元和 3,004.08 万元。随着集成电路和分立器件芯片设计业务的日趋成熟，产品附加值逐年提高，带来营业收入、营业毛利率的逐年增长。公司经过多年在集成电路与分立器件芯片领域的积累与探索，产品已被市场接受及认可，品质的提升、附加值的增加带动其营业收入的增长，且营业收入的增长将继续保持上升趋势。

（2）期间费用分析

本公司最近三年一期的期间费用情况如下：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
营业费用	324.57	1,216.61	898.16	978.91
管理费用	1,934.71	8,588.68	6,753.68	7,037.46
财务费用	231.24	1,396.47	1,102.49	1,746.87

2010 年营业费用和管理费用较高主要系当年度收入增长幅度较高，业绩规模扩大导致；2010 年财务费用较高，虽然 2010 年公司出于节约财务费用考虑已开始逐步减少贷款，但由于基准利率以及存款准备金率的上调，市场利率逐步攀升，导致企业承担的财务费用提高。

（3）其他

本公司最近三年一期的利润表其他项目情况如下：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
资产减值损失	98.45	51.42	994.21	6,867.28
投资收益	864.35	7,442.82	6,412.83	8,734.65
营业外收入	158.73	1,075.45	335.56	1,196.71
营业外支出	20.11	145.18	172.00	207.16

2008 年资产减值损失较多主要系计提长期股权投资的减值准备所致；营业外收入较高主要系政府补贴所致。

（二）以合并报表口径分析

1、资产负债结构分析

（1）资产分析

项目	2011.3.31		2010.12.31		2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：	138,853.44	52.55%	148,750.47	57.99%	86,453.52	48.04%	77,227.35	43.80%

货币资金	55,861.03	21.14%	66,768.49	26.03%	21,368.59	11.88%	20,213.98	11.47%
应收票据	7,262.79	2.75%	8,713.75	3.40%	6,682.31	3.71%	3,230.75	1.83%
应收账款	30,865.83	11.68%	31,958.48	12.46%	26,743.92	14.86%	19,394.97	11.00%
其他应收款	779.33	0.29%	887.23	0.35%	851.72	0.47%	2,642.71	1.50%
存货	37,235.70	14.09%	31,390.90	12.24%	29,153.79	16.20%	30,931.62	17.54%
非流动资产：	125,389.70	47.45%	107,744.41	42.01%	93,491.49	51.96%	99,072.77	56.20%
长期股权投资	16,549.48	6.26%	16,730.58	6.52%	12,861.85	7.15%	9,164.32	5.20%
固定资产	70,593.64	26.72%	69,099.91	26.94%	68,175.23	37.89%	74,975.16	42.53%
在建工程	29,730.76	11.25%	13,466.98	5.25%	2,837.92	1.58%	746.56	0.42%
无形资产	7,171.81	2.71%	6,986.66	2.72%	6,241.35	3.47%	7,746.24	4.39%
资产总计	264,243.13	100.00%	256,494.87	100.00%	179,945.01	100.00%	176,300.12	100.00%

最近三年一期，本公司总资产分别为 176,300.12 万元、179,945.01 万元、256,494.87 万元和 264,243.13 万元。公司业务规模的整体增长和销售业绩的持续上升带动了资产规模的持续快速增长。2010 年资产的大规模增长主要系非公开发行募集资金约 5.75 亿元所致，募集资金到账后对应流动资产中货币资金项目的增加，以及公司募投项目、芯片生产线技改项目的投入对应非流动资产中在建工程项目的增加。报告期内发行人的主营业务产品主要为集成电路产品、半导体分立器件芯片和 LED 芯片。经过产业结构调整，公司已完成从中低端量大面广的电路产品向中高端的 SoC 芯片、以高压、高功率、高频工艺开发的模拟集成电路、以特殊工艺开发的半导体分立器件以及高亮度 LED 蓝绿光芯片为主要产品的转型过程，整体盈利能力逐步提高，带动销售收入的增长，导致应收账款和存货都有一定比例的增加。

公司主要从事电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造和销售；进出口业务。主要产品包括集成电路、器件、发光二极管等。最近三年一期发行人主营业务持续发展，盈利能力逐步增强，资产规模也同步增长。

最近三年一期，本公司的货币资金余额分别为 20,213.98 万元、21,368.59 万元、66,768.49 万元和 55,861.03 万元，分别占当期总资产比例为 11.47%、11.88%、26.03%和 21.14%。2010 年底公司货币资金数额较高系 2010 年度本公司非公开发行募集资金约 5.75 亿元所致。发行人现金管理得当，大额货币资金的流出和流入存在合理的业务背景，风险可控。截至到 2011 年 3 月 31 日，发行人无金额重大的未达账项。

最近三年一期，本公司的应收票据余额分别 3,230.75 万元、6,682.31 万元、

8,713.75 万元和 7,262.79 万元，占当期总资产的比例分别为 1.83%、3.71%、3.40% 和 2.75%。本公司的应收票据到期后均能按期收回，收款风险极小。

最近三年一期，本公司的应收账款余额分别 19,394.97 万元、26,743.92 万元、31,985.48 万元和 30,865.83 万元，占当期总资产的比例分别为 11.00%、14.86%、12.46%和 11.68%。最近三年一期，发行人应收账款系因销售产品所形成。公司的销售政策为：内销发货后月底统一结算，给客户的收账期为 30-90 天，应收账款的周转天数一般在 60-90 天之间；出口销售主要采用 T/T、L/C 结算。总体来看，应收账款的回款情况良好。

在信用政策及货款管理上，本公司对零售小规模客户实行现款现货的销售政策，对经销商一般给予 1-2 个月的信用期间、对直接厂商一般给予不超过 3 个月的信用期间，对外销客户则主要采用 T/T、L/C 结算方式。同时，本公司制定有完善的对销售人员和应收账款的管理制度并由专人监督执行，最近三年一期本公司销售回款情况一直较好。应收账款期末余额的增加主要是随公司业务发展，直接大厂客户增多，信用余额随之增加。

销售规模的增长带动相应应收账款余额增长。但公司最近三年一期一年以内的应收账款占比仍均保持在 95%以上，存在坏账的可能性较小。2010 年、2009 年、2008 年发行人实际核销的应收账款分别为 88.96 万元、181.90 万元、59.56 万元，分别占当期应收账款余额的 0.26%、0.64%、0.29%。

最近三年一期，本公司的应收账款周转率分别为 4.38、4.16、5.17、**1.03**，应收账款周转效率较高，资产管理能力较好。与同行业上市公司对比分析如下：

应收账款周转率	2011 年 1-3 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
三安光电	1.44	5.72	3.63	-
乾照光电	0.48	2.68	2.17	2.41
长电科技	2.24	8.74	6.67	0.63
华微电子	1.07	4.50	3.63	2.93
华天科技	1.20	5.50	4.74	5.46
通富微电	1.30	6.43	5.48	5.47
国星光电	1.27	6.25	7.45	5.64

注：三安光电、乾照光电系 LED 芯片制造企业，长电科技、通富微电、华天科技系集成电路半导体封装企业，华微电子系半导体制造企业，国星光电系 LED 封装企业。

本公司应收账款周转率略低于国星光电与通富微电，主要系该两家公司以代

工制造模式为主，本公司坚持 IDM 即设计与制造一体化，故 IDM 公司在存货和应收账款周转率方面会低于代工制造企业。但总体来看公司的应收账款周转率仍然处在可观的水平，仅略低于上述两家公司。

最近三年一期，本公司的存货余额分别为 30,931.62 万元、29,153.79 万元、31,390.90 万元和 37,235.70 万元，占当期总资产的比例分别为 17.54%、16.20%、12.24%和 14.09%。从变动趋势上看，2008 年-2009 年存货余额较为稳定，波动幅度不大。2010 年随着本公司业务的增长，和产品品种的增多，相应的增加存货储备，故余额随之增长。2011 年 1 季度存货余额较大，主要系公司为扩大生产，增加了原材料采购和生产投入，产成品储备也相应增加。

存货分类明细表

项 目	2011.03.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
原材料	13,195.48	8,202.50	5,939.84	6,871.00
在产品	10,873.95	12,034.38	12,092.76	10,655.33
库存商品	14,049.53	12,230.94	13,040.88	15,074.64
委托加工物资	1,530.62	1,329.28	1,000.88	284.46
包装物	16.70	11.95	25.63	22.86
低值易耗品	109.64	110.41	140.84	143.53
小计	39,775.92	33,919.46	32,240.84	33,051.81
减：存货跌价准备	2,542.79	2,528.56	3,087.04	2,120.19
存货净值	37,233.13	31,390.90	29,153.79	30,931.62

最近三年一期，发行人维持相对较高的存货，主要原因系：A、公司采用 IDM 模式，拥有从芯片设计、制造、委托封装、测试合格到产品销售等完整的产业链，产业链的延长导致公司期末存货增加；B、公司在近几年来加大固定资产投资，产能随之增加，产品品种规格、工艺门类较多，导致期末存货增加；C、公司 LED 产品主要定位于户内外彩屏市场，产品参数指标需要达到较高的一致性的要求，从而造成 LED 芯片的档位划分较细，产成品储备相应增加。

公司在产品在公司存货余额中所占比重均较大，主要系公司产品的生产特点所致。公司主营业务为集成电路、分立器件和 LED 芯片的生产销售，生产环节包括设计、生产、委托封装、测试等，产品生产周期一般达 2-3 月，生产周期较长，导致了在产品金额较大。

最近三年一期，发行人存货跌价准备计提情况如下表所示：

时间	存货种类	期初余额	跌价准备计提金额	转销金额	期末余额
----	------	------	----------	------	------

2011 年 1-3 月	原材料	207.84		21.44	186.40
	在产品	508.43	155.40	194.29	469.54
	库存商品	1,812.29	74.56		1,886.85
	低值易耗品	-			
	合 计	2,528.56	229.96	215.73	2,542.79
2010 年	原材料	264.53	29.71	86.40	207.84
	在产品	448.04	508.52	448.13	508.43
	库存商品	2,374.47	571.96	1,134.15	1,812.29
	低值易耗品	-	-	-	-
	合 计	3,087.04	1,110.20	1,668.68	2,528.56
2009 年	原材料	243.81	79.04	58.32	264.53
	在产品	241.42	2,262.47	2,055.86	448.04
	库存商品	1,634.96	1,375.88	636.36	2,374.47
	低值易耗品	-	-	-	-
	合 计	2,120.19	3,717.39	2,750.54	3,087.04
2008 年	原材料	50.57	193.24	-	243.81
	在产品	1,714.51	141.5	1,614.59	241.42
	库存商品	1,933.44	508.4	806.88	1,634.96
	低值易耗品	30.8	-	30.8	-
	合 计	3,729.33	843.14	2,452.27	2,120.19

发行人 2008 年上半年士兰集成的经营情况出现好转，产量快速上升，在产品陆续制造完工并售出，发行人同时转销 2007 年年末计提的存货跌价准备。

发行人 2009 年初受金融危机的影响需求严重不足，导致士兰集成 2009 年一季度产能利用率较低，单位产品分摊固定成本较高；因此，发行人在 2009 年一季度末对士兰集成在产品计提了较高金额的存货跌价准备。从 2009 年 4 月份开始销售陆续好转，并于三、四季度进入销售旺季，发行人根据产品销售情况转销了大部分存货跌价准备。此外，2009 年士兰明芯对部分库存商品计提了存货跌价准备。

2010 年公司产品总体处于供不应求的局面，以前年度已经计提存货跌价准备的部分存货在 2010 年实现销售，发行人根据产品销售情况转销 1,668.68 万元存货跌价准备。同时，由于公司产销规模的扩大，存货金额也相应增加，发行人根据存货变动情况新计提了 1,110.2 万元存货跌价准备。其中：母公司新计提存货跌价准备 600.63 万元，转销 953.66 万元；士兰集成新计提了存货跌价准备 254.66 万元，转销 487.40 万元；士兰明芯新计提了存货跌价准备 227.78 万元，转销 174.72 万；其它子公司新计提了 27.13 万元；转销 52.90 万元。

最近三年一期，发行人期末对部分积压时间较长的原材料、低值易耗品、库存商品和期末单价较高的在产品等可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

中国证监会浙江监管局于 2009 年 6 月 8 日至 6 月 12 日对发行人进行了巡检，并下发了浙证监上市字【2009】70 号《关于要求杭州士兰微电子股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》。对存货的核算提出以下问题：发行人控股子公司士兰集成 2007 年对在制品计提减值准备 1,614 万元，该在制品于 2008 年 1-4 月陆续投料加工并销售，发行人在上述产品销售完毕后，于 2008 年 6 月一次性结转上述存货跌价准备并冲减当期的主营业务成本，根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，已售存货，应当按期成本结转为当期损益，相应的存货跌价也应当予以结转。发行人未按规定在在制品进行加工销售的同时结转相应的跌价准备，而将 1,614 万元一次性计入 6 月份的损益，导致发行人 2008 年 1 季度多计营业成本，不符合收入成本的配比原则。

经调查，士兰集成二厂 2007 年处于工艺优化、产品开发阶段，其产能利用率和产品合格率均较低，而生产线的固定成本较高，导致单位产品的生产成本明显高于售价，故发行人对士兰集成二厂 2007 年年末在产品计提 1,614 万元的存货跌价准备。

针对浙江证监局提出的上述问题，经调查，发行人做出了如下解释：2008 年一季度士兰集成二厂由于工艺的改进、芯片产量逐步上升，产能利用率逐步提高，发行人管理层出于谨慎性的考虑，在不确定工艺是否持续稳定、产量是否持续上升的基础上，暂未结转已售存货相应的跌价准备，直至 2008 年二季度末在确定工艺已持续稳定、产量明显上升的基础上，将 1,614 万元一次性计入 6 月份的损益。

上述会计处理方式虽然导致 2008 年一季报多计营业成本，但出于当时管理层对产品工艺成熟、产量上升的不确定性的谨慎性考虑，因而符合会计处理的谨慎性原则，且从全年的数据来看，对全年的营业成本金额并无太大影响。截至 2009 年末，发行人已规范有关存货跌价准备的计提及核算，按照企业会计准则的有关规定以及企业实际情况制定《存货跌价准备计提及核算的管理规定》，并提交董事会审批通过。

最近三年一期，本公司长期股权投资余额分别为 9,164.32 万元、12,861.85 万元、16,730.58 万元和 16,549.48 万元，分别占当期总资产的比例为 5.20%、7.15%、6.52%和 6.26%。2008 年度士康科技持续亏损，其资产组合的可收回金额低于长期股权投资的账面价值，故对其计提 1,500 万元的减值准备；2009 年士康科技继续出现了较大的经营性亏损，账面净资产实际上已经出现负数，故再对其计提 400 万元的减值准备。

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司长期股权投资明细如下：

被投资单位	投资成本	2011.03.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31	最新持股比例
友旺电子	324.05	14,613.62	14,776.41	10,869.43	6,542.79	40.00%
友旺科技	1,098.10	715.08	733.40	802.40	793.27	32.00%
开曼 Op Art 公司	1,299.34	908.10	908.10	929.62		30.09%
杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	15.00%
士康科技	2,010.38	2,010.38	2,010.38	2,010.38		6.19%
士腾科技	52.29	52.29	52.29		312.50	10.00%
长期股权投资合计	4,934.16	18,449.48	18,630.58	14,761.83	7,798.56	
减值准备		1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,500.00	
长期股权投资净值		16,549.48	16,730.58	12,861.83	6,298.56	

最近三年一期，本公司固定资产余额分别为 74,975.16 万元、68,175.23 万元、69,099.91 万元和 70,593.64 万元，分别占当期总资产的 42.53%、37.89%、26.94%和 26.72%。公司固定资产中，房屋建筑物主要为发行人本部、士兰集成、士兰明芯的生产、办公用房及部分住宅。公司专用设备也主要为士兰集成和士兰明芯的生产设备。公司于每年的 12 月末盘点固定资产，对符合计提资产减值准备条件的固定资产计提减值准备，截至 2010 年末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。发行人主要固定资产使用状态良好，固定资产折旧政策符合稳健性原则，最近三年一期发行人固定资产折旧计提数额符合发行人会计准则。

截至 2010 年末，发行人期末固定资产中已有账面价值为 17,068.74 万元的房屋建筑物用于抵押担保。

固定资产分类明细如下：

单位：万元

	2010 年 12 月 31 日	比重	2011 年 3 月 31 日	比重
账面原值合计	126,013.26		130,321.69	
其中：房屋及建筑物	21,621.43	17.16%	21,621.43	16.59%
通用设备	3,601.61	2.86%	3,690.13	2.83%
专用设备	98,606.84	78.25%	102,724.95	78.82%
运输工具	2,082.52	1.65%	2,156.55	1.66%
其他设备	100.86	0.08%	128.63	0.10%
账面净值合计	69,099.91		70,593.64	
其中：房屋及建筑物	17,416.78	25.21%	17,269.01	24.46%
通用设备	1,386.24	2.01%	1,402.05	1.99%
专用设备	49,365.95	71.44%	50,983.61	72.22%
运输工具	909.11	1.32%	914.53	1.30%
其他设备	21.83	0.03%	24.44	0.03%

最近三年一期，本公司在建工程 746.56 万元、2,837.92 万元、13,466.98 万元和 29,730.76 万元，分别占当期总资产的比例为 0.42%、1.58%、5.25%和 11.25%。2010 年末在建工程增长幅度较大的原因是：随着最近几年公司产品、技术开发能力有较大幅度的提高，产品品质得到较大的改善和提升，公司获取市场订单能力也趋于增强，但公司目前的生产能力不能较好的满足市场订单进一步扩大的需求，存在一定的供给瓶颈。因此从 2010 年开始，公司加大了投资力度，主要投向近年来快速发展的 LED 芯片制造行业和以高压、高功率、高频工艺为主要特征的半导体芯片制造行业。今后新投资建设的项目将随公司项目建设不断达到完工使用状态，进而转出为固定资产。

在建工程明细情况如下：

工程名称	2011.3.31	2010.12.31
高亮度 LED 芯片生产线技改项目	7,672.89	
芯片技改项目	13,476.59	11,127.06
模块车间项目	2,864.54	1,219.48
成都一期工程	3,881.71	179.30
零星工程	1,835.03	941.14
合计	29,730.76	13,466.98

高亮度 LED 芯片生产线扩产项目为公司募投项目，公司承诺的总投资额为 49,986.03 万元，截至 2011 年 3 月 31 日，累计已投入 21,949.36 万元。

最近三年一期，公司无形资产账面价值分别为 7,746.24 万元、6,241.35 万元、6,986.66 万元和 7,171.81 万元。其中 2010 年无形资产原值较 2009 年增加 1,609.44 万元，主要系公司实施高清多媒体处理器芯片项目，2010 年外购 IP 许可和版图

制图软件及技术增加无形资产所致。

从资产构成来看，本公司的资产结构较为稳定，流动资产和非流动资产约各占一半的比例，2010 年由于非公开发行募集资金到账，流动资产占比略有上升；流动资产主要为货币资金、存货和应收账款。非流动资产中主要为长期股权投资、固定资产、在建工程，最近三年一期在建工程和长期股权投资增长幅度较大，也反映了公司处于较快的成长期。

（2）负债分析

项目	2011.3.31		2010.12.31		2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：	87,669.33	93.20%	83,705.00	93.52%	88,256.27	90.66%	94,661.47	91.94%
短期借款	49,982.67	53.14%	47,900.00	53.52%	57,617.95	59.19%	61,423.07	59.66%
应付票据	7,100.00	7.55%	3,400.00	3.80%	9,350.00	9.60%	10,300.00	10.00%
应付账款	24,517.69	26.07%	21,639.15	24.18%	16,801.20	17.26%	14,299.57	13.89%
一年内到期的非流动负债	4,000.00	4.25%	4,000.00	4.47%	0.00		3,000.00	
非流动负债：	6,394.18	6.80%	5,802.24	6.48%	9,093.17	9.34%	8,295.28	8.06%
长期借款	700.00	0.74%	700.00		4,000.00	4.11%	4,000.00	3.89%
长期应付款	268.57	0.29%	268.57	0.30%	268.57	0.28%	268.57	0.26%
专项应付款	1,595.70	1.70%	1,595.70	1.78%	1,595.70	1.64%	1,595.70	1.55%
其他非流动负债	3,810.30	4.07%	3,226.39	3.60%	3,038.34	3.12%	1,603.41	1.56%
负债总计	94,063.51	100.00%	89,507.24	100.00%	97,349.44	100.00%	102,956.75	100.00%

最近三年一期，本公司总负债分别为 102,956.75 万元、97,349.44 万元、89,507.24 万元和 94,063.51 万元，最近三年总负债呈现持续下降的态势，2011 年 3 月末稍有增长。最近三年流动负债的下降主要系短期借款减少所致，2011 年 3 月末略有回升；2009 年末非流动负债增加主要系其他非流动负债项目中的递延收益增加所致，2010 年末非流动负债降低主要系长期借款到期转入一年内到期的非流动负债。

最近三年一期，尤其是自 2009 年以来，国家收紧货币政策，存货准备金率及基准利率步步上调，企业承担的利息成本较高，加上销售业绩提升带来的经营状况良好，公司逐步降低短期借款，并于 2010 年通过非公开发行股票募集资金约 5.75 亿元以降低对银行类金融机构的短期间接融资需求额度。发行人的应付账款增加较大系随发行人业务的发展，相应的材料采购规模扩大，其在供应商的商业信用也逐步增加，也说明了本公司财务管理能力较强，善于利用商业信用融资，降低财务费用。其他非流动负债均系与资产相关或者综合性项目的政府补助，

递延至资产使用期限或项目期内分期确认收益。

从负债结构来看，发行人最近三年一期的负债结构较为稳定。在发行人的全部负债中，流动负债占比一直较大，占总负债的比重基本为 90%以上，长期负债占总负债比重基本在 10%以下。相对而言，流动负债比例相对过高，有调整负债结构的内在需求。

2、现金流量分析

最近三年一期，本公司现金流量情况如下表所示：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	5,095.59	30,388.19	12,788.07	3,781.79
投资活动产生的现金流量净额	-18,988.80	-29,008.11	72.75	5,060.09
筹资活动产生的现金流量净额	383.28	44,183.48	-9,560.35	-7,440.18
汇率变动的影响	8.85	-175.74	-240.35	-130.12
现金及现金等价物净增加额	-13,501.08	45,387.82	3,060.11	1,271.58

(1) 经营活动产生的现金流量分析

最近三年一期，本公司经营活动产生的现金净流量分别为 3,781.79 万元、12,788.07 万元、30,388.19 万元和 5,095.59 万元，均为净流入。且最近三年一期增幅较大，充分反应公司经营业绩良好。其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为 107,080.18 万元、90,838.27 万元、158,221.79 万元和 38,710.07 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量分析

最近三年一期，本公司投资活动产生的现金净流量分别为 5,060.09 万元、72.75 万元、-29,008.11 万元和-18,988.80 万元。2009 年投资活动产生的现金流量净额较 2008 年减少 98.56%，主要系 2009 年公司收回投资收到的现金减少，以及购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金增加所致；2010 年及 2011 年 1-3 月份投资活动产生的现金流量净额较低主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅度增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量分析

最近三年一期，本公司筹资活动产生的现金净流量分别为-7,440.18 万元、-9,560.35 万元、44,183.48 万元和 383.28 万元。2009 年筹资活动产生的现金流量净额较 2008 年减少，主要系 2009 年公司借款较上期减少所致。2010 年筹资活动产生现金流大幅度增加主要系非公开发行股票共筹资约 5.75 亿元。

本公司经营活动现金管理较好，最近三年一期均为净流入且大幅度增加，针

对本公司最近几年投资支出较大的情况，公司将积极稳妥的加大融资力度，调整债务结构，降低融资成本和财务风险；同时本公司将进一步加强资金管理，合理利用既有资金，加速资金周转，提高经济效益。最近三年，发行人资产流动性逐渐提高，发行人的盈利能力、偿债能力及抗风险能力也呈现逐步提升的态势。

3、偿债能力分析

(1) 从公司主要偿债指标分析公司偿债能力

最近三年及一期的偿债指标（合并报表）：

财务指标	2011 年 1-3 月/末	2010 年末/度	2009 年末/度	2008 年末/度
流动比率	1.58	1.78	0.98	0.82
速动比率	1.16	1.40	0.65	0.49
应收账款周转率	1.03	5.17	4.16	4.38
存货周转率	0.65	4.20	2.30	2.38
资产负债率	35.60%	34.90%	54.10%	58.40%
利息保障倍数	6.67	9.99	3.00	1.45
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

最近三年及一期的偿债指标（母公司报表）

财务指标	2011 年 1-3 月/末	2010 年末/度	2009 年末/度	2008 年末/度
流动比率	1.59	1.55	0.91	1.06
速动比率	1.28	1.29	0.72	0.86
应收账款周转率	1.18	5.50	5.41	5.38
存货周转率	1.39	6.47	4.31	3.75
资产负债率	21.64%	22.20%	44.37%	47.95%
利息保障倍数	6.03	9.00	5.87	1.00
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

其中：

- 1、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息支出
- 2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 3、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

根据合并报表数据分析，最近三年一期，营业收入的稳定、利润的增长以及经营性活动产生的净现金流量的大幅增加，改善了公司的现金流状况，发行人资产负债结构正逐步趋向合理。2011 年 1-3 月、2010 年、2009 年、2008 年公司营业收入分别为 32,400.59 万元、151,882.70 万元、95,986.54 万元、93,309.58 万元，2008-2009 年保持了基本稳定增长，2010 年受全球半导体行业景气度大幅

度提升的带动，公司产销规模快速扩大，随着公司业务向附加值较高的集成电路芯片、分立器件芯片、LED 芯片转型，营业收入取得了较大幅度的增长。2011 年 1-3 月、2010 年、2009 年、2008 年公司毛利率分别为 31.17%，35.48%，28.13%，24.02%，提高幅度较大；2011 年 1-3 月、2010 年、2009 年、2008 年公司经营活动产生的净现金流量分别为 5,095.59 万元、30,388.19 万元、12,788.07 万元、3,781.79 万元，增长幅度较大，缓解了公司资金周转的紧张，支撑和提高了公司短期偿债能力。受以上因素的影响，最近三年一期公司的流动比率和速动比率逐年提高，也反映了公司生产经营情况得到改善。

但总体来说，扣除 2010 年非公开发行募集资金约 5.75 亿元的影响，流动比率和速动比率不高，存在一定的短期偿债压力，主要原因是由于本公司负债结构不合理，流动负债占比较高。另一方面这也表明公司资产运营能力较好，营运资本周转快，应收账款周转率和存货周转率较好，因此维持正常生产经营所需的营运资本水平较低。随着本公司投资建设的项目投入生产，固定资产投资将逐步产生效益，未来公司盈利能力将不断提高，短期偿债能力亦将逐步增强。若本次公司债券顺利发行，将改善公司的债务结构，流动负债占总负债的比重将明显降低，公司流动比率和速动比率将进一步提高，从而将较好的改善本公司短期偿债能力。

和同行业上市公司比较：

流动比率指标	2011 年 1-3 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
三安光电	-23.73	15.82	11.12	1.56
乾照光电	53.52	31.26	2.49	1.83
长电科技	1.03	1.22	0.62	6.73
华微电子	1.13	1.14	1.08	1.24
华天科技	1.13	1.52	1.95	2.20
通富微电	1.75	1.70	1.21	1.18
国星光电	10.09	8.90	2.10	1.67

速动比率指标	2011 年 1-3 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
三安光电	-19.41	13.93	10.42	1.15
乾照光电	51.53	30.42	2.26	1.60
长电科技	0.77	0.89	0.5	0.52
华微电子	0.94	0.96	0.85	0.79
华天科技	0.92	1.29	1.68	1.96
通富微电	1.55	1.55	1.00	0.99

国星光电	8.72	7.77	1.54	1.13
------	------	------	------	------

公司的流动和速度比率和同行业上市公司相比较低，一方面主要系三安光电近年来进行过两次大规模增发，乾照光电于 2010 年在创业板上市等因素影响，国星光电于 2010 年首发上市，扣除以上因素的影响，和同行业上市公司差异并不显著。

从资产负债率来看，最近三年一期公司资产负债率分别为 58.40%、54.10%、34.90%、35.60%，2010 年非公开发行募集资金约 5.75 亿元大大降低了资产负债率，偿债能力良好，有保障。

从资产运营效率来看，最近三年一期，本公司应收账款周转率分别为 4.38、4.16、5.17 和 **1.03**，存货周转率分别为 2.38、2.30、4.20 和 **0.65**。公司目前的销售政策为：内销发货后月底对账结算，对目前三大主营业务产品的收帐政策有部分差异，集成电路产品主要通过经销商模式，账期通常为 1-2 个月；分立器件产品主要通过直供厂商的模式销售，账期通常为 2-3 个月；发光二极管产品主要通过直供厂商的模式销售，账期也通常为 3 个月。出口销售主要采用 T/T 或 L/C 结算。2009 年公司集成电路产品收入占比略有下降，器件和发光二极管收入占比略有上升，在不同销售政策的影响下，应收账款账龄较之前有所增长，相应 2009 年总体应收账款周转率有所下降。2010 年随着集成电路、分立器件芯片和发光二极管产品总体销售幅度都有较大幅度的增长，且市场出现供不应求的情况下，当年的应收账款周转率和存货周转率皆对应有所增长。2011 年 1-3 月份存货周转率较低主要系 2011 年 3 月末出于备货的考虑原材料增加导致期末存货余额较大所致。总体来看，应收账款质量良好，销售回款正常。公司营运能力逐步增强，存货管理与应收账款管理的能力持续提高，公司经营风险可控，具备持续经营能力。

和同行业上市公司的对比分析：

存货周转率	2011 年 1-3 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
三安光电	0.40	2.31	2.75	-
乾照光电	0.53	4.13	3.91	3.34
长电科技	1.72	7.07	5.79	6.31
华微电子	0.68	3.12	2.34	2.15
华天科技	1.85	8.29	7.59	9.12
通富微电	1.51	7.95	6.96	8.81
国星光电	0.73	3.44	3.66	3.21

公司的存货周转率明显高于三安光电、乾照光电等 LED 芯片制造企业，但低于华天科技、通富微电类以代工制造为主的集成电路封装企业。

从利息保障倍数来看，最近三年一期的利息保障倍数分别为 1.45、3.00、9.99 和 6.67，公司的息税前净利润完全可以覆盖公司的利息费用支出。但随着公司三年一期利润总额的大幅增长，利息保障倍数同比提高幅度较大，总体来看，公司偿债能力逐步增强。

从贷款偿还率来看，本公司自成立以来，始终按期偿还有关债务。公司经营状况良好，且具有较好的发展前景，在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。公司的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有良好的资信水平。基于公司良好的经营状况和资信状况，公司具有较好的间接与直接融资能力，这有助于公司在必要时可通过银行贷款补充流动资金，从而更有力地为本次债券的偿付提供保障。

（2）从银行授信额度分析公司偿债能力

公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期的合作伙伴关系，获得各银行的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至 2011 年 3 月 31 日，公司拥有的银行授信总额为 194,370 万元人民币，其中已使用银行贷款授信额度 52,000 万元、银行承兑汇票授信额度 4,510 万元，未使用授信余额 137,860 万元。未使用授信余额可以为本期公司债券的及时偿付提供相应的保障性支持。

（3）从现金流情况分析公司偿债能力

最近三年一期，本公司现金流量情况如下表所示：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	5,095.59	30,388.19	12,788.07	3,781.79
投资活动产生的现金流量净额	-18,988.80	-29,008.11	72.75	5,060.09
筹资活动产生的现金流量净额	383.28	44,183.48	-9,560.35	-7,440.18
汇率变动的影响	8.85	-175.74	-240.35	-130.12
现金及现金等价物净增加额	-13,501.08	45,387.82	3,060.11	1,271.58

最近三年一期，本公司经营活动产生的现金净流量分别为 3,781.79 万元、12,788.07 万元、30,388.19 万元和 5,095.59 万元，公司现金流情况良好。营业收入的稳定、利润的增长带动经营性活动产生的净现金流量的大幅增加，改善了公司的现金流状况，其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为 107,080.18 万元、

90,838.27 万元、158,221.79 万元和 38,710.07 万元。稳定的现金流为公司债务的偿还提供较有力的保障。

生产经营之外，作为上市公司，公司的间接融资渠道和直接融资渠道均非常畅通。最近三年一期，本公司筹资活动产生的现金净流量分别为-7,440.18 万元、-9,560.35 万元、44,183.48 万元和 383.28 万元，其中取得借款收到的现金分别为 76,760.36 万元、82,867.95 万元、55,504.33 万元和 24,137.54 万元，此外，2010 年非公开发行股票共筹资约 5.75 亿元。本公司良好的筹资能力为公司债务的偿付提供了更多的保障。

本公司经营活动现金管理较好，最近三年一期均为净流入。针对本公司最近几年投资支出较大的情况，公司将积极稳妥的加大融资力度，调整债务结构，降低融资成本和财务风险；同时本公司将进一步加强资金管理，合理利用既有资金，加速资金周转，提高经济效益，为本期债券的本息支付提供坚强保障。

(4) 从资本市场直接融资能力分析公司偿债能力

作为上市公司，本公司经营稳定、业绩良好，在资本市场的融资渠道畅通，2010 年通过非公开发行股票顺利进行了股权融资募集资金约 5.75 亿元。必要时，公司可以通过直接融资手段在资本市场筹集资金以满足公司资金需要，这也为公司按期偿还本期债券提供有力支持。

(5) 其它偿债措施

本期债券由士兰控股提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，可以有效降低本期债券的到期偿付风险。

4、盈利能力分析

最近三年一期，本公司主要经营情况如下：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
营业收入	32,400.59	151,882.70	95,986.54	93,309.58
营业成本	22,302.14	97,995.50	68,988.72	70,892.40
销售费用	978.32	3,549.16	2,347.81	2,625.65
管理费用	4,567.03	19,843.54	15,012.41	16,478.68
财务费用	702.81	3,332.49	3,999.03	5,440.39
营业利润	4,440.89	26,842.96	5,947.39	278.78
利润总额	4,834.94	29,341.06	7,872.09	2,527.14
净利润	4,246.07	25,665.43	7,558.79	1,260.21

归属于母公司所有者的净利润	4,211.62	25,585.86	7,646.75	1,355.94
少数股东损益	34.45	79.56	-87.96	-95.73

(1) 主营业务分析

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
营业收入	32,400.59	151,882.70	95,986.54	93,309.58
营业成本	22,302.14	97,995.50	68,988.72	70,892.40
营业毛利	10,098.45	53,887.2	26,997.82	22,417.18
营业毛利率	31.17%	35.48%	28.13%	24.02%

①本公司最近三年一期主营业务收入构成：

产品（或行业）名称	2011 年 1-3 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
集成电路	13,592.61	42.05%	60,766.38	40.03%	44,371.71	46.32%	46,936.88	50.38%
器件	10,751.86	33.26%	51,317.10	33.81%	30,651.73	32.00%	26,768.58	28.73%
发光二极管	7,897.26	24.43%	39,214.77	25.83%	20,192.32	21.08%	18,277.40	19.62%
其他	81.33	0.25%	501.72	0.33%	568.82	0.59%	1,186.98	1.27%
合计	32,323.06	100.00%	151,799.97	100.00%	95,784.58	100.00%	93,169.84	100.00%

最近三年一期，发行人主营业务收入的产品构成变化，体现了发行人完成产业升级的过程，发行人维持集成电路和半导体器件芯片设计和制造商战略，并持续在 LED 芯片领域投入，增加产能，巩固士兰明芯品牌。

针对各产品明细分类如下：

I、集成电路与分立器件

从公司三年一期的业绩来看，集成电路业务 2009 年销售额略有下降，主要系 2009 年发行人集成电路业务尚处于产品结构调整阶段，并且受到自 2008 年 10 月份爆发的全球性金融危机的影响，市场需求大幅度萎缩，影响了产品产出。2009 年 3 月份开始，全球半导体市场开始反弹，发行人集成电路产销量亦呈现触底反弹。经过公司积极地调整产品结构、产品附加值得到提升，并随着生产工艺的不断改善，产品合格率得到提高，产能得到有效释放。三年一期的集成电路产销量稳步提升。随着整体行业在 2010 年的进一步复苏，2010 年公司集成电路业务营业收入获得了 36.95% 的增长。今后随着公司电路新品出货量的持续增长，公司预计集成电路业务的营业收入将继续保持增长态势。

分立器件业务在最近三年一期保持强劲增长，主要系公司分立器件业务在品种规格、质量参数控制、制造规模等方面已经位居国内同行前列。目前公司分立

器件产品已经被许多国内外知名厂商所认可，已陆续通过欧司朗、飞利浦、索尼、松下、LG、三星、EXAR、台湾强茂、香港米切尔、美国凯虹、汕尾德昌、东莞中之等国内外知名厂商的产品认证，随着公司芯片生产线产能的进一步释放，公司预计今后几年分立器件芯片的产销量会进一步扩大。

II、发光二极管

随着 LED 产品市场需求的不断增加，公司发光二极管业务近三年一期保持高速增长。2010 年士兰明芯已将蓝绿光 LED 芯片的生产能力提升到 6.5 亿只（每月），新订购 8 台大型 MOCVD 设备，预计 2011 年士兰明芯蓝绿光 LED 芯片的生产能力将提升至 11 亿只（每月）以上。目前市场上订单已达到供不应求的局面，公司将进一步扩大产能，提升销售。

②本公司主营业务毛利率分析

产品名称	2011 年 1-3 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
集成电路	27.98%	29.17%	24.23%	21.37%
器件	28.61%	32.86%	25.62%	16.34%
发光二极管	39.08%	48.06%	40.45%	42.76%
其他	72.03%	73.55%	28.60%	15.32%
综合毛利率	31.01%	35.44%	28.12%	24.04%

最近三年一期，发行人毛利率呈上升趋势，主要原因系（1）士兰集成生产工艺的不断改善，提高了芯片合格率，并且产能得到有效释放，单位产品分摊的固定成本得到显著降低；（2）士兰明芯发光二极管芯片定位于户内外彩屏市场，产品品质较高，售价较高，导致毛利率较高；（3）公司不断推出集成电路新品，新产品的附加值较高，弥补了老产品的价格下跌。故虽然最近三年产品售价不断下降，但单位产品的成本的下降幅度大于单位售价的下降幅度。总体来看，发行人近三年的毛利率呈现上升态势。

（2）期间费用分析

本公司最近三年一期的期间费用情况如下：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
销售费用	978.32	3,549.16	2,347.81	2,625.65
管理费用	4,567.03	19,843.54	15,012.41	16,478.68
财务费用	702.81	3,332.49	3,999.03	5,440.39

公司管理费用较高主要系研发费用通过管理费用列支所致，由于产品开发的不确定性，发行人出于谨慎性考虑，报告期内未将研发费用资本化形成无形资产，

而在发生时直接计入当期损益。

公司最近三年一期财务费用情况如下：

项目	2011 年 1-3 月	2010 年	2009 年	2008 年
利息净支出	646.33	2,973.63	3,622.38	5,311.59
汇兑净损失	-8.85	118.06	129.43	-119.95
银行手续费	65.32	240.80	247.22	248.75
合计	702.8	3,332.49	3,999.03	5,440.39

发行人利息支出与银行借款规模基本匹配。

(3) 最近三年及一期非经常性损益

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	12.04	13.05	-11.52	-14.3
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	115.08	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	421.87	2,533.54	2,083.02	2,522.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53.49	1,278.65	5,915.20	5,855.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-13.06	-	-5.58
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.64	-	-25.73	-143.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小 计	485.76	3,927.27	7,960.98	8,215.30
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	65.06	590.12	972.8	1,113.49
少数股东权益影响额（税后）	2.31	24.5	38.36	38.15
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	418.39	3,312.64	6,949.82	7,063.66

最近三年，发行人的非经常性损益主要由计入当期的政府补助和处置可供出售金融资产取得的投资收益构成。

5、盈利能力的可持续性分析

（1）国内集成电路行业和 LED 行业发展概况

受国际金融危机影响，全球半导体产业自 2008 年 10 月份开始出现大幅下滑，但在世界各国采取了刺激经济的政策和积极“救市”措施的影响下，全球半导体产业在 2009 年第二季度开始回升，并于 2010 年进入了强劲复苏阶段。2010 年，全球半导体市场规模 2,983.2 亿美元，市场增速高达 31.8%，是继 2000 年以来市场增速最快的一年，在经历了 2009 年的下滑之后，市场大幅反弹，结束了连续多年来的低迷发展态势。据市场调研机构 iSuppli 发布的资料显示，其在 2011 年 3 月 30 日汇总的全球半导体市场最新预测中，预计 2011 年的全球半导体市场规

模将达到 3,252 亿美元（文章来自电子元件技术网）。2010 年，国内半导体行业也有较大幅度增长。根据中国半导体行业协会统计，2010 年国内集成电路产业销售额为 1,440.15 亿元，同比增长 29.9%。其中，设计业销售额为 363.85 亿元，同比增长 34.8%；芯片制造业销售额为 447.12 亿元，同比增长 31.1%；封测业销售额为 629.18 亿元，同比增长 26.3%。2011 年国内半导体行业的增速将高于全球市场，预计在 10%-15%之间。

根据市场研究机构拓璞产业研究所的研究，受惠于液晶平板电视 LED 背光应用需求大幅度成长，2010 年全球 LED 产值高达 99.83 亿美元，年增长率为 42%。在手机中小尺寸背光、TV 中大尺寸背光、普通照明应用等 3 大应用需求驱动下，预估 2011 年全球 LED 产业年成长率将维持 42%高水准，年产值上冲 142.17 亿美元。2010 年国内 LED 行业也获得了较快的发展，根据产业联盟发布的 2010 年中国半导体照明产业数据，2010 年，我国芯片产值达到 50 亿元，较 2009 年的 23 亿元实现倍增；我国 LED 封装产值达到 250 亿元，较 2009 年的 204 亿元增长 23%；半导体照明应用整体规模达到 900 亿元，增长率达到 50%。预计“十二五”国内 LED 产业规模将达到 5,000 亿元以上。

（2）公司业务发展概况及预计

最近三年一期公司集成电路芯片设计、硅芯片制造、LED 芯片制造三大业务均取得了较快的发展。以下分三个方面描述：

在集成电路芯片设计业务方面，公司电源管理和功率驱动产品线、混合信号及射频产品线、数字音视频产品线、MCU 产品线等均完成了重点新产品的开发计划。公司已初步完成了对产品线的调整和布局，从跟踪产业发展的方向、技术积累等多方面来说，公司目前的产品线布局是基本合理的。公司在 2009 年 4 季度启动了高清多媒体处理器芯片的预研工作，并在 2010 年年初正式立项开发高清多媒体处理器芯片，计划投资 3,000 万元。2010 年，公司已对该项目投资 2,035 万元，预计 2011 年年底前将完成高清多媒体处理器芯片的开发。

在硅芯片制造业务方面，公司子公司杭州士兰集成电路有限公司的芯片制造规模、质量控制水平已达到一个新的台阶。2010 年 12 月，士兰集成月产出芯片数量已经达到 12.5 万片，预计 2011 年士兰集成的芯片生产能力将提高至 18 万片/月。经过 10 年的发展，士兰集成已经具备了较强的成本控制能力和较强的工

艺技术开发能力、建立了达到国际大厂认可标准的质量管理体系，初步完成了我们 IDM 模式中最为关键的一步跳跃。2010 年，士兰集成还完成了对功率模块封装线的第一期投资约 2,500 万人民币。该封装生产线建成后，将主要生产高速低功耗 600V 以上多芯片功率模块，其主要应用于家用设备中变频电机的驱动、电器设备的高效低待机功耗电源、LED 照明和节能灯的高效供电驱动等领域，具有良好的市场发展前景。公司生产的功率模块将全部采用自行开发的芯片，包括高压集成电路、IGBT、快恢复二极管等高压功率器件芯片。功率模块封装线的建设是公司走设计与制造一体的产业化模式的重要举措之一，今后公司将进一步加大在该领域的投资规模。

在 LED 芯片制造业务方面，公司子公司杭州士兰明芯科技有限公司在品牌建设、生产规模的扩充上已走在了国内同行的前列。2010 年，士兰明芯已将蓝绿光 LED 芯片的生产能力提升至 6.5 亿只（每月），新订购了 8 台大型 MOCVD 设备（预计该部分设备将在 2011 年一季度陆续抵达），预计 2011 年士兰明芯蓝绿光 LED 芯片的生产能力将提升至 11 亿只（每月）以上。2010 年，士兰明芯子公司杭州美卡乐光电有限公司的 LED 芯片封装业务也取得了进展，关键技术取得突破。2010 年 8 月，在北京天安门广场纪念碑北侧新竖起了两块巨型 LED 彩色显示屏，这两块巨型 LED 彩色显示屏的灯管是由美卡乐公司封装的（芯片均采用了士兰明芯的产品）。2011 年 1 月，士兰明芯完成了对美卡乐公司的增资约 3,000 万元人民币。今后，公司将进一步加大对美卡乐公司的投入，目标是将美卡乐做成国内质量最好、可以进入全球高端市场的 LED 成品品牌。

经过近三年的调整，公司前些年投入的各项业务已经趋于成熟，公司将进入一个新的发展阶段。

公司近三年一期继续保持了财务稳健，应收账款、库存等经营指标得到有效控制，经营活动所产生的净现金流与利润同步增长。公司在扩大投资规模的同时，适度减少了银行负债规模。2010 年，公司顺利完成了定向增发，资本结构得到优化，为公司下一步发展打下了扎实的基础。

6、未来业务发展目标

公司的发展战略是成为国内最大的自有品牌的半导体产品制造商。经过近三年的调整，公司前期投入的各项业务已经趋于成熟、产业线布局基本合理。未来，

公司将进入一个新的发展阶段。根据公司的战略规划，公司将继续围绕七大产品线进行规划、管理和运行：

- 在高压 BCD 工艺、高压分立器件的研发上继续加大投入，争取在 AC-DC 电源、LED 照明驱动、功率模块等产品领域取得较大的进展，树立品牌，大幅度拓展市场。
- 继续在数字音视频（含安防监控、光盘伺服系统）领域投入，加快高清解码芯片的研发，进一步巩固并拓展应用市场。
- 继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展，在特殊工艺领域坚持走 IDM（设计与制造一体）的模式。继续扩充现有芯片生产线的产能，加快西部半导体生产基地的建设。
- 加快推进功率模块的封装业务，充分发挥公司在高压电路与器件芯片研发、芯片制造、应用系统开发的综合优势，追随高压、高功率产品应用市场的快速发展。
- 继续加大分立器件芯片的技术和产品研发投入，增加器件芯片的技术附加值。
- 持续在 LED 芯片领域投入，在 RGB LED 已取得较好优势的产业基础上，加快发展照明 LED 芯片业务。继续保持在国内 LED 芯片制造领域质量、规模、品牌、研发能力的领先地位。
- 打造士兰“美卡乐”高端 LED 成品品牌，积极拓展海内外高端客户，提升产品价值。

四、本次发行公司债券对发行人资产负债结构的影响

本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设条件的基础上产生变动：

- 1、相关财务数据的基准日为 2011 年 3 月 31 日；
- 2、假设本期债券的募集资金净额为 6 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
- 3、假设本期债券募集资金净额 6 亿元计入 2011 年 3 月 31 日的资产负债表；
- 4、假设本期债券募集资金 6 亿元中，约 3 亿元用于偿还债务，优化公司债务结构；剩余约 3 亿元用于补充公司营运资金；
- 5、假设财务数据基准日与本期公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债权益变化。

基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构的影响如下表：

（一）本期债券发行对发行人资产负债结构（合并报表）的影响如下：

项目	2011.3.31	发行 6 亿元后	归还 3 亿短期借款后
货币资金	55,861.03	115,861.03	85,861.03
流动资产合计	138,853.44	198,853.44	168,853.44
资产总计	264,243.13	324,243.13	294,243.13
流动负债合计	87,669.33	87,669.33	57,669.33
应付债券	-	60,000.00	60,000.00
非流动负债合计	6,394.18	66,394.18	66,394.18
负债总计	94,063.51	154,063.51	124,063.51
所有者权益合计	170,179.62	170,179.62	170,179.62
负债和所有者权益总计	264,243.13	324,243.13	294,243.13
资产负债率	35.60%	47.51%	42.16%
流动比率	1.58	2.27	2.93
流动负债占比	93.20%	56.90%	46.48%

（二）本期债券发行对发行人资产负债结构（母公司报表）的影响如下：

项目	2011.3.31	发行 6 亿元后	归还 3 亿短期借款后
货币资金	29,844.45	89,844.45	59,844.45
流动资产合计	62,342.89	122,342.89	106,342.89
资产总计	190,531.83	250,531.83	234,531.83
流动负债合计	39,169.37	39,169.37	23,169.37
应付债券	-	60,000.00	60,000.00
非流动负债合计	2,059.80	62,059.80	62,059.80
负债总计	41,229.17	101,229.17	85,229.17
所有者权益合计	149,302.66	149,302.66	149,302.66
负债和所有者权益总计	190,531.83	250,531.83	234,531.83
资产负债率	21.64%	40.41%	36.34%
流动比率	1.59	3.12	4.59
流动负债占比	95.00%	38.69%	27.18%

第十节 募集资金运用

一、公司债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第四届董事会十九次会议审议通过，并经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请发行不超过 6 亿元的公司债券。

二、本次募集资金运用计划

经本公司第四届董事会十九次会议审议通过，并经 2011 年度公司第一次临时股东大会审议通过：本次发行的公司债券拟用于偿还借款、调整债务结构和用于补充公司流动资金。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

本次发行公司债券所募资金，公司拟安排其中的约 3 亿元偿还银行借款（包括偿还控股子公司的借款），优化公司债务结构；剩余募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。具体使用计划如下：

1、偿还银行借款

单位：万元

拟使用募集资金公司	拟用募集资金投入					合计
	中行高新支行	华夏高新支行	交行东新支行	农行下沙支行	汇丰杭州分行	
士兰微	6,000	4,000	6,000	-	-	16,000
士兰集成	4,000	-	2,000	4,000	4,000	14,000
小计	10,000	4,000	8,000	4,000	4,000	30,000

因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行完毕，募集资金到账后，本公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。

2、补充公司流动资金

单位：万元

拟使用募集资金公司	拟用募集资金投入	合计
士兰微	24,000	24,000
士兰集成	6,000	6,000
小计	30,000	30,000

与单纯从事芯片设计的公司不同，发行人同时拥有芯片设计、芯片制造、芯

片及电路测试等多项业务。公司产品种类较多，日常经营对资金需求较高，需要持有大量现金储备用于主营业务的发展。随着发行人不断提高产能、产量，不断加大技改、研发力度，公司对流动资金的需求越来越大，公司本次发行债券并拟用募集资金补充流动资金，有助于公司更快的实现扩大产销规模，降低经营风险。

其中，士兰微补充流动资金主要系（1）公司完成重点新产品开发计划、即将投放市场，从而增加对流动资金的需求；（2）公司电路产品从备货到销售周期较长、品种规格较多、分立器件产销规模扩大而相应增加对周转资金的需求。士兰集成补充流动资金主要系因士兰集成扩充产能规模和原材料价格上涨，公司因此加大原材料采购、扩大材料备货，抵抗原材料价格上涨带来的经营风险，从而增加对流动资金的需求。

三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）有利于优化公司债务结构

本次发行前，公司负债结构较为单一，基本为流动负债。截至 2011 年 3 月 31 日，从合并报表口径来看，公司流动负债占负债总额的比例为 93.20%，非流动负债占负债总额的比例为 6.80%。

从发行人合并报表口径来看，截至 2011 年 3 月 31 日，发行人银行借款总额为 54,682.67 万元，其中短期银行借款和一年到期的长期银行借款合计为 53,982.67 万元，占银行借款总额的比例为 98.72%；长期银行借款余额为 700.00 万元，占银行借款总额的比例为 1.28%。

不考虑发行费用，假设本期公司债券足额发行 6 亿元，并假设募集资金中 3 亿元偿还短期银行贷款、剩余资金用于补充流动资金后，公司流动负债占负债总额的比例将下降为 46.48%，下降 46.72 个百分点。由于长期债务融资比例有较大幅度的提高，公司债务结构将得到一定的改善。

（二）提升公司短期偿债能力

以 2011 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中约 3 亿元用于偿还债务、剩余资金用于补充流动资金，在不考虑融资过

程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的 1.58 增加至发行后的 2.93。公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

（三）有利于提高公司经营稳定性

本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

（四）满足公司流动资金需求，有利于公司业务发展目标的实现

报告期内，公司主营业务保持了快速增长。2008 年、2009 年和 2010 年，公司主营业务收入分别为 93,169.84 万元、95,784.58 万元和 151,799.97 万元。根据公司的业务发展规划，预计 2011 年将实现营业总收入 20 亿元左右，较 2010 年增加约 5 亿元，其中根据 2010 年集成电路和分立器件产品收入占比（约 74%）情况测算，集成电路和分立器件增加收入约 3.7 亿元。经过前几年产业结构的调整，2010 年公司步入稳定发展阶段，因此以 2010 年公司资产周转率（应收账款周转率为 5.17 次/年、存货周转率为 4.2 次/年、应付账款周转率为 5.1 次/年），并根据 2010 年集成电路和分立器件综合毛利率（约 30%）初步测算，公司因产能、产量提高，增加集成电路和分立器件营业收入约 3.7 亿元，所需补充的流动资金金额约为 8,245 万元/年 [12]，5 年约 4.12 亿元。考虑到未来五年公司业务发展需要，流动资金需求将更大。为适应公司业务发展需要，计划通过本次发行 5 年期债券募集资金解决约 3 亿元的流动资金需求。

综上所述，本次发行公司债券，将有效地优化公司债务结构，增强公司的短期偿债能力，锁定公司的财务成本并促进公司的健康发展。

^[12] 计算公式：补充流动资金=应收账款占用发行人资金+存货占用发行人资金-发行人应付账款占用供应商资金=3.7 亿元÷5.17+3.7 亿元×（1-30%）÷4.2-3.7 亿元×（1-30%）÷5.1=0.8245 亿元。

第十一节 其他重要事项

一、最近一期末对外担保情况

截至 2011 年 3 月 31 日，发行人对外担保明细情况如下：

单位：人民币万元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型	是否履行完毕	是否为关联方担保
士兰集成	1,500.00	6 个月	连带责任保证	否	子公司
士兰集成	1,000.00	6 个月	连带责任保证	否	子公司
士兰集成	1,500.00	6 个月	连带责任保证	否	子公司
士兰集成	2,000.00	1 年	连带责任保证	否	子公司
士兰集成	2,000.00	1 年	连带责任保证	否	子公司
士兰集成	2,000.00	1 年	连带责任保证	否	子公司
士兰明芯	1,000.00	1 年	连带责任保证	否	子公司
士兰明芯	1,000.00	1 年	连带责任保证	否	子公司
士兰明芯	2,000.00	6 个月	连带责任保证	否	子公司
士兰明芯	2,300.00	1 年	连带责任保证	否	子公司
深兰微	700.00	2 年	抵押担保	否	子公司
深兰微	300.00	6 个月	抵押担保	否	子公司
合计	17,300.00				

截至 2011 年 3 月 31 日，发行人累计对外担保余额（包括对子公司的担保）合计为人民币 17,300 万元，均为对控股子公司的担保，占发行人最近一期经审计的净资产的比例为 11.61%。

在目前仍持续的担保中，被担保人的生产经营情况正常，财务状况良好，未出现过逾期债务不能偿还的情形，未出现目前可预见的不能偿还债务的情形，发生被迫承担担保责任风险的可能性较小。

二、发行人未决诉讼或仲裁事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

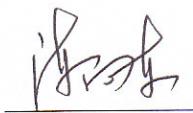
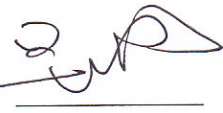
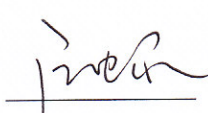
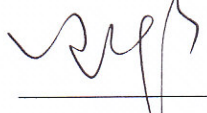
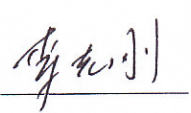
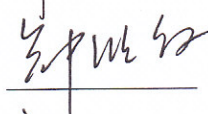
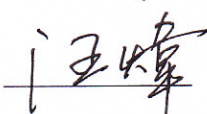
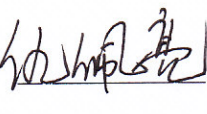
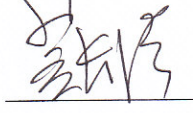
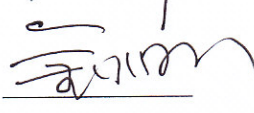
第十二节 董事及有关中介机构声明

发行人全体董事、监事及高管人员声明

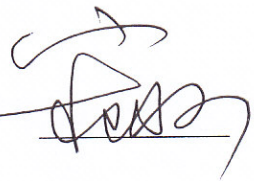
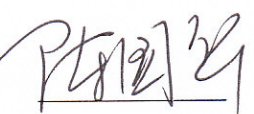
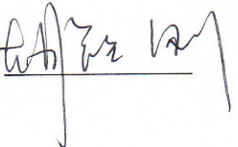
本公司全体董事、监事及高管人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为发行人全体董事、监事及高管人员声明之签署页)

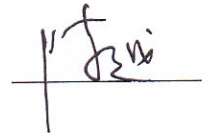
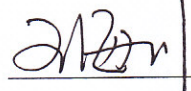
董事：

陈向东		范伟宏		郑少波	
江忠永		罗华兵		李志刚	
钟晓敏		汪 炜		仇佩亮	
裴长洪		金小刚			

监事：

宋卫权		陈国华		胡铁刚	
-----	---	-----	--	-----	---

高级管理人员：

陈 越		王海川	
-----	---	-----	---

杭州士兰微电子股份有限公司



保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目主办人（签名）：胡刘斌 陈晖
胡刘斌 陈晖

法定代表人（签名）：潘鑫军
潘鑫军



发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签名）：徐旭青 金春燕
徐旭青 金春燕

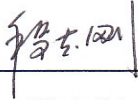
律师事务所负责人（签名）：吕秉虹
吕秉虹

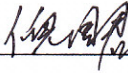


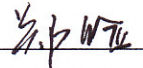
会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读杭州士兰微电子股份有限公司募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

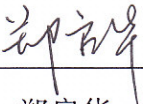
经办注册会计师（签名）：


程志刚


倪国君


郑俭

会计师事务所负责人（签名）：


郑启华



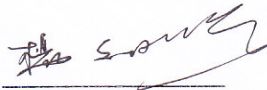
天健会计师事务所有限公司

2011年6月7日

资信评级机构声明

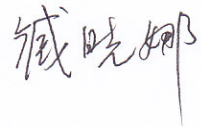
本机构及签字的资信评级人员（或资产评估人员）已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员（或资产评估人员）对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资信评级人员（签名）：

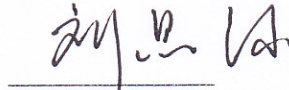


杨文鹏

臧晓娜



资信评级机构负责人（签名）：



刘思源



鹏元资信评估有限公司

2011年4月

第十三节 备查文件

本募集说明书的备查文件如下：

- 1、杭州士兰微电子股份有限公司最近三年的财务报告及审计报告和已披露的 2011 年第一季度报告；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书；
- 3、法律意见书；
- 4、资信评级报告；
- 5、中国证监会核准本次发行的文件；
- 6、杭州士兰微电子股份有限公司公司债券债券持有人会议规则；
- 7、杭州士兰微电子股份有限公司公司债券受托管理协议；
- 8、担保合同和担保函。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐机构（主承销商）处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书及摘要。